

簡式公開說明書

一、本公開說明書編印目的：發行一〇一一年度第三期無擔保普通公司債。

二、本次發行公司債之種類、金額、利率及發行條件：

(一) 種類：無擔保普通公司債。

(二) 金額：新台幣肆拾肆億元整。

(三) 利率：詳見發行條件 4.。

(四) 發行條件：

1. 名稱：台灣積體電路製造股份有限公司一〇一一年度第三期無擔保普通公司債
(以下簡稱本公司債)。

2. 發行總額及面額：發行總額為新臺幣肆拾肆億元整，票面金額為新臺幣壹仟萬元整。

3. 發行期間及方式：十年期，發行期間如下：

自民國 101 年 10 月 9 日開始發行，至民國 111 年 10 月 9 日到期。

本公司債於發行日依票面金額十足發行。

4. 票面利率：年利率 1.53%。

5. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

6. 還本方式：到期一次還本。

7. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

8. 債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

(五) 公開承銷比例：不適用。

(六) 承銷及配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：詳見本說明書第 43 頁。

四、本次發行之相關費用：

(一) 承銷費用：不適用。

(二) 其他費用：約新台幣 2,000 仟元。

五、有價證券之生效不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項（詳見公開說明書第 4 頁）。

八、投資人查詢本公開說明書電子檔案之網址：公開資訊觀測站(<http://mops.tse.com.tw>)。

台灣積體電路製造股份有限公司 編製

中華民國一〇一年十月一日 刊印

一、本次發行前實收資本額來源：詳本公開說明書第 20 頁

二、公開說明書之分送計畫

(一)陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構。

(二)分送及索取方式：請附小包裏郵資及信封袋向本公司索取或請透過網路取閱 (<http://newmops.twse.com.tw>)。

三、公司債承銷商：不適用。

四、公司債保證機構：不適用。

五、公司債受託機構：

名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司

地址：台北市仁愛路四段169號

電話：(02) 2771-6699

網址：<http://www.fubon.com>

六、公司債簽證機構：不適用

七、辦理公司債過戶機構：

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市中正區博愛路35號4樓

電話：(02)2361-0262

網址：<http://www.kgi.com.tw>

八、公司債信用評等機構：

名稱：中華信用評等股份有限公司

地址：台北市信義路五段7號49樓

電話：(02)8722-5800

網址：<http://www.taiwanratings.com>

九、公司債簽證律師：

律師事務所名稱：現代法律事務所

簽證律師：郭惠吉

地址：台北市大安區新生南路二段82號3樓之一

電話：(02)2392-0628

網址：<http://modernlaw.myweb.hinet.net>

十、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林鴻鵬、黃樹傑

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市民生東路三段156號12樓

電話：(02)2545-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

十一、複核律師：不適用

十二、本公司發言人及代理發言人

發言人：何麗梅

職稱：資深副總經理暨財務長

電子郵件：invest@tsmc.com

電話：(03)563-6688

代理發言人：孫又文

職稱：企業訊息處處長

電子郵件：invest@tsmc.com

電話：(03)563-6688

十三、本公司網址：www.tsmc.com

台灣積體電路製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 259,207 百萬元		公司地址：新竹科學工業園區力行六路 8 號		電話：(03)5636688	
設立日期：76 年 2 月 21 日			網址：www. tsmc. com		
上市日期：83 年 9 月 5 日		上櫃日期：不適用		公開發行日期：81 年 10 月 30 日	
管理股票日期：不適用		負責人：董事長 張忠謀		發言人：何麗梅	
職稱：資深副總經理暨財務長		代理發言人：孫又文		職稱：企業訊息處處長	
公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司		電話：(02) 2361-0262		網址：http://www. kgi. com. tw	
地址：台北市中正區博愛路 35 號 4 樓					
公司債承銷機構：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
最近年度簽證會計師：林鴻鵬、黃樹傑		電話：(02)2545-9988		網址： http://www. deloitte. com. tw	
地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓					
複核律師：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司		電話：(02) 8722-5800		網址： http://www. taiwanratings. com	
地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓					
最近一次經信用評等日期： 101 年 9 月 4 日		評等標的： 本公司一〇一年度第三期無擔保普通公司債		評等結果：twAAA	
董事選任日期：101年6月，任期：3年			監察人選任日期：不適用		
全體董事持股比例：7.12%（101 年 6 月 30 日）			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例：(101 年 6 月 30 日)					
職 稱		姓 名		持 股 比 例	
備 註					
董事長		張忠謀		0.48%	
副董事長		曾繁城		0.13%	
董事		李鍾熙		6.38%	
董事		蔡力行		0.13%	
獨立董事		彼得·邦菲爵士		-	
獨立董事		施振榮		0.01%	
獨立董事		湯馬斯·廷吉布斯		-	
獨立董事		鄧至莊		-	
獨立董事		陳國慈		-	
工廠地址：					
(二廠、五廠)		新竹科學工業園區園區三路121號		電話：(03)5636688	
(三廠)		新竹科學工業園區研新一路9號		電話：(03)5636688	
(六廠)		台南科學工業園區南科北路1號		電話：(06)5056688	
(八廠)		新竹科學工業園區力行路25號		電話：(03)5636688	
(十二廠)		新竹科學工業園區力行六路8號		電話：(03)5636688	
(十四廠)		台南科學工業園區南科北路1號之1		電話：(06)5056688	
(十五廠)		台中市大雅區科雅六路1號		電話：(04)27026688	
主要產品：積體電路及其他晶圓半導體裝置之製造與銷售				市場結構：內銷 12.7% 外銷 87.3%	
參閱本文之頁次				25 頁	
風 險 事 項 請參閱本公開說明書之公司概況二				4 頁	

去(100)年度	營業收入：新台幣418,245佰萬元 買賣業：- 佰萬元 加工業：- 佰萬元 製造業：新台幣418,245佰萬元 稅前純益：新台幣144,708佰萬元	每股盈餘：5.18元(稅後基本) 47 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	一〇一年度第三期無擔保普通公司債新台幣肆拾肆億元整	
發行條件	見公開說明書封面	
募集資金用途及預計產生效益概述	購置機器設備，效益請參閱公開說明書第43頁	
本次公開說明書刊印日期：101年10月1日		刊印目的：發行一〇一年度第三期無擔保普通公司債
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄		

台灣積體電路製造股份有限公司
公開說明書目錄

目錄

壹、 公司概况.....	1
一、 公司簡介.....	1
(一) 設立日期.....	1
(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話.....	1
(三) 公司沿革.....	2
二、 風險事項.....	4
(一) 風險因素.....	4
(二) 訴訟或非訟事件.....	9
(三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事.....	10
(四) 其他重要事項.....	11
三、 公司組織.....	12
(一) 關係企業圖.....	12
(二) 董事及監察人.....	15
四、 資本及股份.....	20
(一) 股本形成經過.....	20
(二) 主要股東名單.....	22
(三) 最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形.....	22
(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	23
(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞.....	23
貳、 營運概況.....	24
一、 公司經營.....	24
(一) 業務內容.....	24
(二) 市場及產銷概況.....	34
二、 轉投資事業.....	37
(一) 轉投資事業概況.....	37
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形.....	38
三、 重要契約.....	39

一、 本次發行公司債資金運用計畫分析.....	40
(一) 資金來源.....	40
(二) 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法.....	40
(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每股盈餘稀釋影響.....	42
(四) 本次發行價格之訂定方式.....	43
(五) 資金運用概算及可能產生之效益.....	43
二、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項.....	44
三、 本次併購發行新股應記載事項.....	44
肆、 財務概況.....	44
一、 財務分析.....	44
二、 財務報表應記載事項.....	46
(一) 最近二年度經會計師查核簽證之財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表).....	46
(二) 最近一年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表).....	46
(三) 截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表.....	46
三、 財務概況應記載事項.....	46
四、 財務狀況及經營結果檢討分析.....	46
(一) 財務狀況.....	46
(二) 經營結果.....	47
(三) 現金流量.....	48
(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	48
(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃.....	48
(六) 其他重要事項.....	48
伍、 特別記載事項.....	49
一、 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形.....	49
二、 委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告.....	49
三、 證券承銷商評估總結意見.....	49
四、 律師法律意見書.....	49
五、 由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見.....	49
六、 本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項.....	49

七、 最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者	49
八、 公司治理運作情形	49
(一) 董事會運作情形	49
(二) 審計委員會運作情形	50
(三) 薪酬委員會運作情形	51
(四) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	53
(五) 履行社會責任情形	56
(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施	64
(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式	65
(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總	65
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊	65

壹、公司概況

一、公司簡介

(一) 設立日期

民國76年2月21日

(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

公司總部及晶圓十二廠

300-78新竹科學工業園區力行六路8號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5637000

晶圓二廠、五廠

300-77新竹科學工業園區園區三路121號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781546

晶圓三廠

300-77新竹科學工業園區研新一路9號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781548

晶圓六廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號

電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5052057

晶圓八廠

300-78新竹科學工業園區力行路25號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5662051

晶圓十四廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號之1

電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5051262

晶圓十五廠

428-81台中市大雅區科雅六路1號

電話：886-4-27026688 傳真：886-4-25607548

北美子公司

2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.

電話：408-3828000 傳真：408-3828008

歐洲子公司

World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam

The Netherlands

電話：31-20-3059900 傳真：31-20-3059911

日本子公司

21F, Queen' s Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku

Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan

電話：81-45-6820670 傳真：81-45-6820673

台積電（中國）有限公司

上海市松江區文翔路4000號

郵政編碼：201616

電話：86-21-57768000 傳真：86-21-57762525

台積電韓國有限會社

15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu

Seoul 135-080, Korea

電話：82-2-20511688 傳真：82-2-20511669

印度聯絡處

1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business Park

Bangalore-560071, India

電話：91-80-41768615 傳真：91-80-41764568

加拿大子公司

535 Legget Dr, Suite 600, Kanata, ON K2K 3B8, Canada

電話：1-613-576-1990 傳真：1-613-576-1999

固態照明子公司

300-78新竹科學工業園區力行四路9號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5679610

太陽能子公司

428-82台中市大雅區科雅西路5號

電話：886-4-27036699 傳真：886-4-25693884

(三) 公司沿革

台積公司成立於民國七十六年二月二十一日，總部設立於台灣新竹科學工業園區，是全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。

台積公司的客戶遍布全球，為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。民國一百年，台積公司所擁有及管理的產能達到1,322萬片八吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有三座先進的十二吋晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有二家海外子公司WaferTech(美國)、台積電(中國)有限公司及其他轉投資公司之八吋晶圓廠產能支援。台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。

1、歷史沿革

民國七十六年公司初創之時，向工研院租用一六吋晶圓廠，成為當初台積公司晶圓一廠；民國七十七年，台積公司於美國成立北美子公司；民國七十九年，台積公司晶圓二廠落成啟用；民國八十二年，於荷蘭成立歐洲子公司；民國八十三年，台積公司股票於台灣證券交易所掛牌上市；民國八十四年，首座八吋晶圓廠一晶圓三廠落成啟用，同年於美國設立Wafertech公司及晶圓廠；民國八十六年，美國存託憑證於紐約證券交易所掛牌上市，同年晶圓四廠、五廠落成啟用，亦設立日本子公司；民國八十七年，於新加坡與荷商飛利浦公司(Philips)合資設立SSMC公司與晶圓廠；民國八十九年，首座位於台南科學園區的晶圓六廠落成啟用；民國九十年，完成合併德基公司並命名為晶圓七廠、完成合併世大公司並命名為晶圓八廠，同年首座十二吋晶圓廠一晶圓十二廠落成啟用；民國九十一年，晶圓三、四廠重組並統稱為晶圓三廠；民國九十二年，於上海設立上海子公司及晶圓廠；民國九十三年，第二座十二吋晶圓廠一晶圓十四廠於南科落成啟用，同年上海晶圓廠亦落成啟用。民國一百年，第三座十二吋晶圓廠一晶圓十五廠於中科落成啟用。截至公開說明書刊印日止，台積公司之三座十二吋晶圓廠均持續擴建中。

民國九十九年，台積公司投資固態照明及太陽能相關的二項新事業。民國一百年六月，台積公司股東會決議，核准將太陽能業務及固態照明業務分別分割讓與兩家新設且由本公司百分之百持有之台積太陽能股份有限公司及台積固態照明股份有限公司，並以民國一百年八月一日為分割基準日。截至民國一〇一年六月三十日，本公司分別持有台積太陽能股份有限公司 99% 股份，以及台積固態照明股份有限公司 95% 股份。

2、最近五年度及截至公開說明書刊印日止重要廠房之擴充及新技術之推出

最近五年台積公司持續擴建位於新竹的晶圓十二廠及位於台南的晶圓十四廠的廠房及產能。台積公司座落於中部科學園區的第三座十二吋超大晶圓廠—晶圓十五廠，也於民國一百年第二季開始進行裝機，並持續擴建中。民國一百年，這三座超大晶圓廠的總產能已達到 326 萬 1,000 片十二吋晶圓，目前提供 0.13 微米、90 奈米、65 奈米、40 奈米、28 奈米全世代以及其半世代設計的生產，並保留部分產能作為研發用途，以支援 20 奈米、14 奈米及更先進製程的技術發展。

民國九十六年，台積公司開發及推出新製程技術如下：32 奈米先進製程與通過功能驗證的靜態隨機存取記憶體 (SRAM) 技術、45 奈米先進製程、由 65 奈米製程直接微縮 90% 的 55 奈米先進製程、65 奈米混合信號及射頻 (MS/RF) 先進製程、65 奈米嵌入式動態隨機存取記憶體 (Embedded DRAM) 先進製程、0.13 微米嵌入式快閃記憶體 (Embedded Flash) 製程、用於小面板單一驅動晶片的 0.16 微米高壓製程、用於大面板源極驅動晶片 (Source Drivers) 的 0.20 微米製程、0.25 微米雙載子互補元件 (Bipolar Complementary Device; BCD) 製程、1.00 微米超高壓製程。

民國九十七年，台積公司成為全球第一家將 40 奈米先進製程技術導入量產的專業積體電路製造服務業者。同時，領先專業積體電路製造服務領域，成功示範第一個能同時支援類比及數位積體電路的 32/28 奈米高介電層／金屬開製程技術。此外，台積公司持續領先專業積體電路製造服務領域推出高效能 (N40G) 和低耗電 (N40LP) 的 40 奈米製程技術，並通過產品驗證。

民國九十八年，繼先前宣佈 28 奈米全世代高效能高介電層／金屬開 (簡稱 28HP) 以及低耗電氮氧化矽 (簡稱 28LP) 製程技術的推出時程計劃之後，台積公司新增 28 奈米低耗電高介電層／金屬開 (簡稱 28HPL) 製程，提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。民國九十八年十二月，台積公司於中國大陸宣佈汽車業界第一個車用電子製程驗證規格 (Automotive Process Qualification Specification) 及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務 (Automotive Service Package)。台積公司位於台灣的多個晶圓廠以及在上海的晶圓十廠皆已具備生產車用電子等級的積體電路產品的能力。

民國九十九年，台積公司宣佈提供 28 奈米全世代製程技術，包括支援高效能表現的 28 奈米高效能高介電層／金屬開 (簡稱 28HP) 以及 28 奈米高效能行動運算製程技術 (簡稱 28HPM) 製程外，亦提供支援低耗電表現的 28 奈米低耗電氮氧化矽 (簡稱 28LP) 製程技術及 28 奈米低耗電高介電層／金屬開 (簡稱 28HPL) 技術，提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。

民國一百年及截至公開說明書刊印日止，台積公司持續提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。同時，亦在民國一百年年底進入 20 奈米製程投片

生產。除了一般邏輯製程技術，台積公司也針對客戶需求提供廣泛的製程技術，例如：嵌入式非揮發性記憶體（Embedded Non-volatile Memory）製程、嵌入式動態隨機存取記憶體（Embedded DRAM）製程、混合訊號／射頻（Mixed Signal/RF）製程、高壓（High Voltage）製程、互補金屬氧化物半導體影像感測器（CMOS Image Sensor）、彩色濾光片（Color Filter）、微機電系統（MEMS）、矽鍺（Silicon Germanium）製程以及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務（Automotive Service Packages）等。

3、最近五年度及截至公開說明書刊印日止經營權之改變

民國九十八年六月十二日，張忠謀董事長重新兼任總執行長一職。

4、最近五年度及截至公開說明書刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換

民國九十六年三月九日台積公司和飛利浦公司共同宣佈雙方就飛利浦公司逐步有秩序地釋出台積公司持股事宜，規劃出多階段釋股方案，包括：飛利浦公司將在台灣證券集中交易市場透過一次或多次的鉅額交易釋出股份、將台積普通股轉換發行美國存託憑證出售、並於民國九十六年至九十九年間，於台積公司執行公司股份買回時參與應賣。

此釋股方案的第一階段於民國九十六年三月十二日執行完成，飛利浦公司於台灣證券交易市場透過鉅額交易之方式，將市值約 17 億 5,000 萬美元的台積公司普通股股份售予國內數家法人機構。第二階段於民國九十六年五月十八日執行完成，飛利浦公司將所持有市值約 25 億 6,000 萬美元之本公司普通股，轉換發行為美國存託憑證出售。

第三階段於民國九十六年十一月十四日至民國九十六年十二月三十一日執行完成，台積公司總計在集中交易市場買回 8 億股之普通股股票，總金額約美金 15 億元，隨後並將買回之股份辦理註銷。飛利浦公司亦於台積公司執行買回公司股份期間，同時在集中交易市場上出售 8 億股台積公司普通股股票。

第四階段於民國九十七年五月十四日至六月三十日之期間及民國九十七年八月十四日執行完畢，飛利浦公司透過集中市場出售及鉅額交易的方式將剩餘的 5.1% 持股售出，完成釋股。

二、風險事項

（一）風險因素

1、利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

■ 利率變動

台積公司的利率風險，主要來自為支應營運活動所產生之負債。為降低利率風險，台積公司主要以營運現金收入，及偶而發行固定利率的長期負債來滿足資金上的需求。在資產方面，台積公司主要投資於高流動性之短期固定收益債券，以保障本金安全及維持流動性。

■ 匯率變動

台積公司超過一半以上的資本支出及製造成本以非新台幣貨幣，如美元、日圓及歐元支付。此外，台積公司超過 90% 之營收來自美元及其他貨幣。

因此，任何顯著而不利的國際匯率變動對台積公司財務狀況均可能會有不利影響，例如，民國九十九年九月一日至民國九十九年十二月三十一日期間，新台幣對美元升值達8.97%，即對台積公司帶來負面的影響。新台幣對美元每升值1%，即會使台積公司的營業利益率下降0.4個百分點。台積公司主要使用外幣短期借款，換匯換利交易及遠期外匯合約，從事外匯避險。以降低由資產與負債所產生的匯率風險。

此外，新台幣對美元的匯率變化也可能會對台積公司普通股股價轉換成以美元表示後之數值、美國存託憑證之股價及現金股利轉換成美元後之數值產生影響。

■ 通貨膨脹及通貨緊縮

台積公司不認為通貨膨脹或通貨緊縮對本公司、客戶及供應商自民國一百年初至公開說明書刊印日為止之營運結果有重大之衝擊。但面對全球經濟展望之不確定性，本公司無法保證未來通貨膨脹或通貨緊縮不會有重大變化，而對本公司之營運結果產生重大不利之影響。

2、從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

自民國一百年初至公開說明書刊印日為止，台積公司並未從事高風險／高槓桿的財務投資，也未為他人提供背書保證。本公司與海外子公司及本公司之子公司間之資金貸與均符合相關法令，並依相關規定辦理。

台積公司所從事的衍生性金融商品交易均是以避險為目的，而不是交易或投機性之操作。有關交易細節，請參考本公司民國一百年年報及民國一〇一年上半年度財務報表。

以交易為目的及備供出售的金融投資，其公平市價會因市場狀況等因素改變而與取得成本不同，進而影響相關的報酬率。

為了控管財務交易風險，台積公司已依據證期局的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。

3、未來研發計畫及預計投入之研發費用

基於民國一百年在先進技術上締造的優異成果，台積公司未來將繼續擴展其研發投資，並增加一條十二吋晶圓研發試產線，以加速 20 奈米、16 奈米和 10 奈米技術的開發。台積公司計劃進一步強化前瞻性技術研究，繼續研發新的電晶體及製程技術，例如 3D 結構、應變層互補金屬氧化物半導體（Strained-layer CMOS）、高載子移動率材料，以及創新的 3D 技術平台等。目前，奈米級互補金屬氧化半導體電晶體的基本物理和其特性的研究，是台積公司研發的重點工作之一，以作為了解及引導未來先進製程元件的設計方向。台積公司已經運用相關的研發成果，確保我們繼續在 28 奈米和 20 奈米製程技術世代的領先地位。台積公司的目標之一，是藉由內部的創新來延伸摩爾定律，同時也與產業領導者及學術界共同合作，尋求具成本效益的製程技術及製造解決方案。

台積公司將繼續與國際聯盟組織及光學微影設備供應商合作，確保能夠即時進行 193 奈米波長高數值孔障（NA）掃描機技術、極紫外線（EUV）微影

技術和多重電子束投影技術的開發，以支援 16 奈米和 10 奈米及更先進製程技術的製程研發工作。

台積公司將繼續與光罩檢測設備供應商合作，共同開發先進的光罩檢測技術，以維持在光罩品質及交貨週期上的領導地位，並滿足研發、產品試製及生產的高標準要求。

台積公司擁有優異、高度專注的研發團隊，加上對創新的承諾，我們深信一定能提供客戶最具競爭優勢且最具成本效益的系統單晶片製程技術，來支援台積公司的營運成長及獲利能力。

計劃名稱	計劃內容	預計生產時程
20 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的下一代製程技術	民國一〇一年
16 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的前瞻性製程技術	民國一〇三年
3D-IC	因應系統級封裝技術，開發更具成本效益以及更具尺寸、效能優勢的 3D 晶片	民國一〇一年至民國一〇二年
下一代微影技術	發展極紫外光微影技術和多重電子束技術，以延續摩爾定律	民國一〇三年至民國一〇五年
長期研發	特殊系統單晶片技術，包括新非揮發性記憶體、微機電、射頻及類比晶片	民國一〇一年至民國一〇三年
以上計劃之研發經費約佔民國一〇一年全年營收之 8%。		

4、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

台積公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令，並訂定相關的風險管理程序。民國一〇一年及至公開說明書刊印日止與本公司營運有關之重要法令變動如下：

行政院金融監督管理委員會要求上市公司自民國一〇二年一月一日起，須依國際會計準則（IFRS）編製財務報告，台積公司已成立專案小組負責推動，訂定採用 IFRS 之因應計劃暨預計執行進度，並定期將執行情形提報公司董事會控管。採用 IFRS 的潛在影響可能包括改變部分交易的會計處理以及財務報告的表達方式，台積公司將持續注意 IFRS 之增修及國內相關配套法令調整對公司之影響，並依規定於民國一百年度合併財務報告以及一〇一年期中及年度合併財務報告中，說明採用 IFRS 計劃之重要內容及執行情形，以及 IFRS 與現行會計政策之重大差異。

民國一百零一年一月二十六日修訂公布之全民健康保險法，修訂相關條文擴大保費費基，增加「補充保費」制。台積公司未來發給員工分紅及非經常性給付之獎金時，需另負擔 2% 費率的補充保費。本法尚未經行政院公告施行日。台積公司已充分考量此變動對經營成果之影響，並將做好各項相關財務控管。

民國一〇一年八月八日修訂公布之所得基本稅額條例規定，自民國一〇二年一月一日起，營利事業基本稅額（即最低稅負）稅率由 10%至 12%調高到 12%至 15%。由於台積電公司已於一〇〇年度營利事業所得稅結算申報時開始適用最低稅負制，上述法律之變動，將增加台積電公司一〇二年度起之所得稅負，台積電公司已評估此項法律修訂對於財務報表之影響，並將遵循法令規定辦理。

民國九十九年五月二十六日修訂公布之個人資料保護法(即原電腦處理個人資料保護法)，經行政院公告，將於民國一〇一年十月一日施行部分條文，其適用範圍將擴及所有蒐集、處理、利用個人資料的自然人、法人或團體；受保護之個人資料型態包括電磁紀錄或書面資料，並須有適當安全措施防止個人資料受侵害。台積電公司一向有妥適處理及保管個人資料之措施，未來將持續依相關法令規定進行必要調整，以確保符合相關法令之規定。

此外，立法機關正在研議環保相關法令（例如：溫室氣體減量法及能源稅）及勞工安全衛生法等，由於法令內容尚不確定，目前無法判斷相關法令通過後的具體影響，但有可能會增加公司營運成本。

5、科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

■ 產業發展

半導體市場與微電子產業一向深受景氣循環、產品需求快速變化的影響，這樣的市場特性也對台積電公司的積體電路製造服務業產生衝擊。台積電公司的多數客戶均隸屬於上述產業，因此台積電公司的營收與獲利，也受到客戶下單波動的影響。

半導體產業與微電子產業不時面臨重大且持續不景氣及產能過剩的情況，台積電公司目前及未來業務需求皆來自這些產業客戶，上述產業不景氣及產能過剩的情況將導致整體半導體製造服務業及台積電公司的業務需求下降，如果台積電公司不能透過降低成本或其他措施來有效抵銷需求下降的影響，營收、利潤與獲利率均會受到衝擊。

■ 技術變革

因應半導體產業與其技術的不斷變化，台積電公司的競爭利器為持續開發先進製程，以製造功能更多、更先進的產品。倘若台積電公司無法洞察技術提升的需要並迅速發展創新技術，或遇到競爭者無預期地取得更先進技術，台積電公司便可能無法以具競爭力的條件贏得先進積體電路製造服務的訂單。雖然台積電公司致力維持研發優勢，但若不能在技術或製程上繼續領先，或是未能取得由他人所發展的技術或製程之移轉或授權，台積電公司的競爭力將有所影響。

6、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

台積電公司堅實的核心價值、完善的公司治理、優異的營運績效，以及所秉持之「共創永續發展、公平正義、安居樂業的社會」的社會願景，早已在國內外建立了良好的企業形象。自民國九十年起即連續十一年獲選道瓊永續發展指數的組成企業，多年來並陸續獲得包括行政院國家永續發展獎—企業永續發展獎、經濟部卓越創新成就獎、行政院勞委會國家工安獎、環保署全國企業環保獎、經濟部國家產業創新獎、經濟部綠色典範獎、天下

雜誌之全國最佳聲望標竿企業第一名、天下雜誌企業公民調查大型企業第一名、遠見雜誌企業社會責任獎、華爾街日報台灣十大最受尊崇企業第一名、快樂工作人雜誌新世代最嚮往企業第一名、以及投資人關係雜誌—台灣及香港地區最佳公司治理和台灣地區最佳投資人關係獎等，就是最好的證明。

此外，公司設有品牌管理、客戶服務、公共關係、員工關係、投資人關係、風險管理、內部控制及文教基金會等各樣專責部門，統合全公司力量，力求在既有的良好企業形象基礎上再上層樓，同時做好各項因應準備，以杜絕、控制可能面臨的潛在危機。

7、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

自民國一百年初至公開說明書刊印日為止，台積公司並未進行任何併購。

8、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

為滿足客戶需求，台積公司自民國九十三年起持續擴充在新竹科學園區及台南科學園區以及最新的中部科學工業園區十二吋晶圓廠的產能，其每月總產能已從民國九十九年十二月三十一日的 24 萬 4,600 片增加至民國一百零一年十二月三十一日的 29 萬 100 片十二吋晶圓。總體來說，台積公司在民國一百零一年度之產能較前一年度增加約 190 萬片八吋晶圓約當量，全年平均整體晶圓出貨產能利用率為 91%。產能的擴充及生產技術的提升會增加營運成本，例如：需要添購機器設備、人事的訓練或擴充。如果本公司無法相對增加營收來支付前述公司成本的增加，這將對本公司的財務造成負面的影響。

台積公司針對未來市場需求，建立一套預測和評量系統，來評估擴充或減少產能的效益，而截至公開說明書刊印日止，台積公司的產能擴充效益尚符合台積公司預期。

9、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

■ 採購集中的風險

➢ 原物料

台積公司需要適時取得生產晶圓所需的原物料，例如矽晶片、製程用氣體、化學原料、光阻等。由於台積公司採購的原物料中，有一些是由單一廠商所供應，在未及時找到替代供貨來源的狀況下，可能有供貨無法滿足需求的風險。台積公司有許多供應商來自日本，日本若發生嚴重天然災害，如地震，即可能衝擊供應鏈並影響台積公司及時取得充足原物料供應的能力。過去曾發生部分供應商或半導體業的原物料短缺，導致暫時性的價格調整和交期延誤。如果台積公司無法適時取得所需的原物料，或者原物料價格顯著上漲，而增加的成本無法轉嫁給客戶，則台積公司的營收和獲利將可能下滑。為降低供應鏈風險與有效地管理成本，台積公司除致力開發新供應商外，亦鼓勵供應商推動分散生產廠區，並將生產廠區自高成本地區移至台灣，以提高成本競爭力，這是供應商與台積公司的雙贏。此外，台積公司亦將持續改善庫存計劃及每日庫存監控系統，以確保供應鏈維持合理之庫存水位與供應價格。

➢ 設備

設備供應商的市場經常是供給有限且交貨時間冗長，因此台積公司的營運成長以及產能的持續擴充，皆仰賴於我們是否能夠從有限的供應商中得到足量的設備及相關服務。半導體相關產業中，機台的採購前置期可能長達六個月或更久，為了減低這樣的風險，台積公司提供供應商機台需求預測來安排機台的生產計劃，並與廠商共同討論及訂定雙方認可的商業模式，以提前準備前置期較長的零組件來達到縮短購買機台的採購前置期。同時，台積公司亦持續尋找取得相關二手機台的機會。台積公司如果不能以合理的價格即時取得到所需設備，將可能無法滿足客戶的訂單，並對財務及營運上造成負面的影響。

■ 銷售集中之可能風險

雖然台積公司在全球各地擁有數百位客戶，來自前十大客戶的淨銷貨收入總和，在民國九十九年與一百年，約佔公司當年淨銷貨收入的54%與56%，其中最大客戶則約佔9%與14%。若其中一位或多位主要客戶，因持續的競爭壓力、產業整併、設計或委外製造的策略或做法改變、客戶或經銷商存貨調節時間的影響，而停止或顯著縮減採購規模，將可能對台積公司的營運與財務表現產生負面影響。

10、董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司影響、風險及因應措施：

台積公司現有股東所持有股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。台積公司現有的股東可能會不定時地大量出售本公司之普通股或美國存託憑證（ADS）。例如：台積公司主要股東之一的行政院國家發展基金管理會，自民國八十六年起至民國九十四年間，即以美國存託憑證形式多次出售台積公司股份。

截至民國一〇一年六月三十日，行政院國家發展基金管理會仍持有本公司約 6.4%的股權。

截至本公開說明書刊印日為止，台積公司無持股超過 10%之股東。

無。

11、經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施

無。

12、其他重要風險及因應措施：

無。

（二）訴訟或非訟事件

台積公司有時會接獲第三人的通知，主張台積公司所研發、或由台積公司所提供給同屬半導體產業之客戶使用的技術、設計或製程，有侵害他人專利或其他智財權之虞。某些情況下，這些爭議可能會導致雙方間的訴訟（台積公司或為原告或為被告），有時，支付和解金亦為雙方解決爭議的方式之一。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少已造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。

台積公司於九十五年八月，在美國加州阿拉米達高等法院對中芯國際集成電路製造有限公司、中芯國際集成電路製造（上海）有限公司以及中芯國

際美國子公司（合稱「中芯公司」）提起訴訟，主張中芯公司違反雙方於九十四年所簽訂，針對中芯公司不當使用台積公司之營業秘密及專利侵權所達成之和解協議，並於不當使用營業秘密之部分請求禁制令與金錢賠償。中芯公司於九十五年九月對台積公司於同一法院提起反訴，主張違反和解協議及默示承諾之善意及公平原則。中芯公司並於九十五年十一月於北京市高級人民法院提起民事訴訟，主張商業詆毀及違反誠信原則。九十八年六月十日，北京市高級人民法院做出對台積公司有利的判決並駁回中芯公司之訴訟。九十八年十一月四日，在歷經兩個月的審判後，美國加州阿拉米達高等法院的陪審團判決中芯公司違反與台積公司於九十四年簽訂之和解協議，且有不當使用台積公司營業秘密之情形。台積公司與中芯公司立即就上述之判決結果達成和解。根據新的和解協議，雙方均同意請求美國加州法院依據此一和解條件，對此項訴訟做出有利台積公司的合意判決；而中芯公司因北京市高級人民法院做出對台積公司有利判決所提出之上訴，也由中芯公司撤回。根據這份和解協議及合意判決，中芯公司同意除依先前九十四年和解協議下已支付台積公司的美金 135,000 仟元之外，再分期支付台積公司美金 200,000 仟元，以及在相關政府法規許可下，無償授予台積公司中芯國際集成電路製造有限公司 1,789,493,218 股普通股股份，及可以每股約 1.30 港元（依合約規定予以調整）認購中芯國際集成電路製造有限公司約 695,914,030 股（依合約規定予以調整）普通股股份之三年期認股權證。台積公司業經經濟部投資審議委員會核准並已於九十九年七月取得上述普通股股份，帳列備供出售金融資產，並陸續依約取得上述現金賠償收入。

附屬於美國新墨西哥大學的技術移轉單位 STC. UNM，於九十九年六月向美國國際貿易委員會對台積公司及另一公司提出對一篇專利的專利權侵害訴訟。美國國際貿易委員會已於九十九年七月啟動調查程序。台積公司與美國新墨西哥大學的技術移轉單位隨後達成和解協議，且於九十九年十一月十五日就此和解協議提出終止調查之申請。負責本調查程序的行政法官已做出終止本調查案的初步裁決，美國國際貿易委員會已決定不再審閱行政法官的初步裁決，因此正式終止本調查。

Keranos 公司於民國九十九年六月，在美國東德州地方法院對台積公司、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。民國九十九年十一月，台積公司、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理，台積公司尚無法預知上述訟案之訴訟結果。

Ziptronix 公司於民國九十九年十二月，在美國北加州地方法院對台積公司、TSMC North America 以及另一公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟。本公司尚無法預知訴訟結果。

除前述訴訟案件之外，台積公司在最近兩年度及截至公開說明書刊印日止並無涉入其他重大訴訟案件。

- (三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事

無。

(四) 其他重要事項

無。

(一) 關係企業圖

關係企業組織圖

截至民國一百零一年六月三十日止



與關係企業之關係及相互持股情形

截至民國一〇一一年六月三十日止

單位：新台幣仟元

關係企業名稱	與本公司關係	本公司投資情形			投資本公司情形：無		
		持股比例	股數（仟股）	原始投資金額（外幣為仟元）	持股比例	股數（仟股）	原始投資金額
TSMC Global Ltd. (TSMC Global)	子公司	100.0	1	\$42,327,245	-	-	-
TSMC Partners, Ltd. (TSMC Partners)	子公司	100.0	988,268	31,456,130	-	-	-
台積電（中國）有限公司（台積電中國子公司）	子公司	100.0	-	18,939,667	-	-	-
TSMC North America	子公司	100.0	11,000	333,718	-	-	-
VentureTech Alliance Fund III, L.P. (VTAF III)	子公司	98.9	-	3,834,968	-	-	-
精材科技股份有限公司（精材公司）	具控制力之被投資公司	40.2	94,011	1,357,890	-	-	-
VentureTech Alliance Fund II, L.P. (VTAF II)	子公司	98.0	-	865,237	-	-	-
Emerging Alliance Fund, L.P. (Emerging Alliance)	子公司	99.5	-	865,075	-	-	-
TSMC Europe B.V. (TSMC Europe)	子公司	100.0	-	15,749	-	-	-
TSMC Japan Limited (TSMC Japan)	子公司	100.0	6	83,760	-	-	-
TSMC Korea Limited (TSMC Korea)	子公司	100.0	80	13,656	-	-	-
台積電太陽能股份有限公司	子公司	98.9	1,121,836	11,218,362	-	-	-

台積固態照明股份有限公司	子公司	96.1	435,160	4,351,624	-	-	-
台積光能投資有限公司(台積光能公司)	子公司	100.0	-	100,000	-	-	-
TSMC Solar Europe B.V. (TSMC Solar Europe)	子公司	100.0	-	411,032	-	-	-
TSMC Solar North America, Inc. (TSMC Solar NA)	子公司	100.0	1	147,686	-	-	-
TSMC Lighting North America, Inc. (TSMC Lighting NA)	子公司	100.0	1	3,133	-	-	-
TSMC Development Inc. (TSMC Development)	子公司	100.0	1	USD 0.001	-	-	-
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (ISDF)	子公司	97.1	787	USD 787	-	-	-
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (II) LDC. (ISDF II)	子公司	97.1	14,153	USD 14,153	-	-	-
TSMC Technology, Inc. (TSMC Technology)	子公司	100.0	1	USD 0.001	-	-	-
TSMC Design Technology Canada Inc. (TSMC Canada)	子公司	100.0	2,300	USD 2,300	-	-	-
相豐科技股份有限公司(相豐公司)	子公司	58.3	14,168	USD 4,718	-	-	-
Growth Fund Limited (Growth Fund)	子公司	100.0	-	USD 1,830	-	-	-
VentureTech Alliance Holdings, LLC (VTA Holdings)	子公司	100.0	-	-	-	-	-
TSMC Solar Europe GmbH	子公司	100.0	1	EUR 9,900	-	-	-
WaferTech, LLC (WaferTech)	子公司	100.0	293,640	USD 280,000	-	-	-

(二) 董事及監察人

1、董事會成員簡介

截至民國一〇一年六月三十日止

職稱 姓名	選(就) 任日期 (註一)	任期至 (註一)	初次選任 日期 (註一)	遞任時持有股份		現在持有股數(註二)		配偶、未成年子女 現在持有股份 (註二)		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		
董事長 張忠謀	101/6/12	104/6/11	75/12/10	123,137,914	0.48%	123,137,914	0.48%	135,217	0.00%	美國麻省理工學院機械工程學士及碩士 美國史丹福大學電機工程博士 前美國德州儀器公司總公司副總裁 前美國通用儀器公司總裁暨營運長 前工業技術研究院董事長 美國麻省理工學院終身榮譽理事 美國國家工程學院院士	台積公司執行長
副董事長 曾繁城	101/6/12	104/6/11	86/5/13	34,662,675	0.13%	34,662,675	0.13%	132,855	0.00%	國立成功大學電機工程博士 前世界先進積體電路(股)公司總經理 前台積公司總經理 前台積公司副總經理	台積電(中國)有限公司董事長 創意電子(股)公司董事長 台積太陽能(股)公司董事 台積固態照明(股)公司董事 太極影音科技(股)公司董事 宏基(股)公司獨立董事
董事 行政院國家發展 基金管理會 代表人：李鍾熙 (註三)	101/6/12	104/6/11	75/12/10	1,653,709,980	6.38%	1,653,709,980	6.38%	-	-	美國伊利諾理工學院化學工程博士 美國芝加哥大學企業管理碩士 美國哈佛大學進階企管班結業 前美國阿岡國家實驗室計劃主持人 前美國強生美西公司資深經理 前工業技術研究院院長 財團法人生物技術開發中心董事長 中華民國生物產業發展協會理事長	聯聚太陽能(股)公司獨立董事 綠鼎科技控股(股)公司獨立董事 遠東新世紀(股)公司獨立董事
董事 蔡力行	101/6/12	104/6/11	92/6/3	33,665,046	0.13%	33,535,046	0.13%	-	-	美國康乃爾大學材料工程博士 前世界先進積體電路(股)公司總經理 前台積公司全球行銷暨業務執行副總經理 前台積公司營運長 前台積公司總經理暨總執行長 前台積公司新事業總經理	台積太陽能(股)公司董事長暨執行 長 台積固態照明(股)公司董事長暨執 行長 台積公司所屬子公司董事 台積公司所屬子公司總經理

獨立董事 彼得·邦菲 爵士	101/6/12	104/6/11	91/5/7	-	-	-	-	-	-	-	英國 Loughborough 大學工程榮譽學位 倫敦皇家工程院會員 前 ICL Plc 董事長暨執行長 前英國電信公司執行長及 Executive Committee 主席	恩智浦半導體公司董事長 新力公司 (日本) 董事 L. M. Ericsson (瑞典) 董事 Mentor Graphics Corporation Inc. (美國奧勒岡) 董事 Actis Capital LLP (英國倫敦) 董事 The Longreach Group 諮詢委員會委員 新力公司諮詢委員會委員 New Venture Partners LLP 諮詢委員會委員 Apax Partners LLP 顧問 Board Mentor, CMI Rothschild 資深顧問 (英國倫敦)
獨立董事 施振榮	101/6/12	104/6/11	89/4/14	1,480,286	0.01%	1,480,286	0.01%	16,116	0.00%	國立交通大學電子工程學士及碩士 國立交通大學名譽工程學博士 香港理工大學榮譽科技博士 英國威爾斯大學榮譽院士 美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士 宏基集團創辦人、前董事長暨執行長 財團法人國家文化藝術基金會董事長	智融集團董事長 宏基 (股) 公司董事 佳世達科技 (股) 公司董事 緯創資通 (股) 公司董事 南山人壽保險 (股) 公司董事	
獨立董事 湯瑪斯·廷吉布斯	101/6/12	104/6/11	98/6/10	-	-	-	-	-	-	-	美國 J. C. Penney 公司董事長	

獨立董事 鄒至莊	101/6/12	104/6/11	100/6/9	-	-	-	-	-	-	康乃爾大學經濟學系學士 芝加哥大學經濟學碩士及博士 中央研究院院士 美國哲學會院士 美國統計學協會院士 美國統計學經濟學會院士 前動態經濟及控制學學會主席 中山大學榮譽博士 嶺南大學法學博士 香港科技大學企業管理榮譽博士 中國大陸復旦大學、廣西大學、海南大學、 南開大學、山東大學、人民大學、華中科技大學、中國科學院研究生院管理學院、 中山大學及香港城市大學榮譽教授 麻省理工學院史隆學院助理教授， 1955-1959 康乃爾大學助理教授，1959-1962 IBM Thomas Watson 研究中心研究員及經濟研究經理 (Staff Member, Manager of Economics Research) , 1962-1970 哥倫比亞大學兼任教授，1965-1970 普林斯頓大學經濟學教授，1970-2001 普林斯頓大學計量經濟學研究計劃主任 (2001 年，為了向他表示敬意，普林斯頓大學將該研究計劃更名為鄒至莊計量經濟研究計劃「the Gregory C. Chow Econometric Research Program」)， 1970-1997 普林斯頓大學 1913 年級政治經濟學教授， 1997-2001 中美經濟學教育交流委員會美方委員會主席，1981-1994 中國大陸經濟學教育和研究之美方委員會主席，1985-1994 1960 年代中期至 1980 年代初期為中華民國政府就經濟政策提供諮詢 1985 年至 1989 年間為中國大陸總理及國家經濟體制改革委員會就經濟轉型提供諮詢 普林斯頓大學經濟學教授及 1913 年級政治經濟學榮譽教授 普林斯頓大學—Lecturer with the Rank of Professor
-------------	----------	----------	---------	---	---	---	---	---	---	--

獨立董事 陳國忠	101/6/12	104/6/11	100/6/9	-	-	-	-	5.120	0.00%	英國 Inns of Court School of Law 英國大律師資格 新加坡律師資格 美國加州律師資格 台積公司資深副總經理暨法務長， 1997-2001 國家文化藝術基金會執行長，1995-1997 漢聲出版社副總經理，1992-1995 國振法律事務所合夥人，1988-1992 聯鼎法律事務所合夥人，1975-1988 美國舊金山 Heller, Erhman, White & McAuliffe 法律事務所律師，1974-1975 美國紐約 Sullivan & Cromwell 法律事務所律師，1971-1974 新加坡陳財清法律事務所律師，1969-1970 東吳大學教授，2001-2008 國立政治大學教授，2001-2004 國立清華大學客座教授，1999-2002 東吳大學副教授，1981-1998 新加坡南洋大學講師，1970-1971 「台北故事館」創辦人／總監 「撫臺街洋樓」創辦人／總監 中華民國行政院政務顧問 台北市政府市政顧問 財團法人台積電文教基金會董事 財團法人國家文化藝術基金會董事 財團法人中華民國增進基金會董事	-
-------------	----------	----------	---------	---	---	---	---	-------	-------	--	---

附註：

1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無
2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事：無

註一：民國年／月／日。

註二：截至民國一〇一年六月三十日實際持有股數。

註三：該法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東（股權比例佔前十名之股東名稱）
行政院國家發展基金管理會	不適用

該法人股東其為法人者：不適用。

2、董事所具專業資格及獨立性情形

依金融監督管理委員會所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列：

截至民國一〇一年六月三十日止

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註一）										兼任其他台灣 公開發行公司 獨立董事家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董事長 張忠謀				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
副董事長 曾繁城				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
董事 李鍾熙	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
董事 蘇力行				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事 彼得·邦菲				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事 施振榮				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事 湯馬斯·延吉布斯				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事 鄭至莊	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事 陳國慈	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註一：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「✓」。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者，不在此限）。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

四、資本及股份

(一) 股本形成經過

1、股本形成

民國 年/月	發行價格 (每股面額)	核定股本		實收股本		備註		核准日期與文號(註)
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產補充股本者	
95/03	10	27,050,000,000	270,500,000,000	24,730,024,647	247,300,246,470	員工認股權行使：26,770,100元	無	95/03/21 國商字第0950005792號
95/07	10	27,050,000,000	270,500,000,000	24,733,052,975	247,330,529,750	員工認股權行使：30,283,280元	無	95/07/19 國商字第0950018690號
95/07	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,818,166,583	258,181,665,830	盈餘轉增：7,141,032,380元 資本公積轉增：3,709,503,700元	無	95/07/20 國商字第0950018884號
95/09	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,823,356,941	258,233,569,410	員工認股權行使：51,903,580元	無	95/09/26 國商字第0950025820號
95/12	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,825,839,775	258,258,397,750	員工認股權行使：24,828,340元	無	95/12/07 國商字第0950031905號
96/03	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,829,687,846	258,296,878,460	員工認股權行使：38,480,710元	無	96/03/07 國商字第0960005253號
96/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,832,959,219	258,329,592,190	員工認股權行使：32,713,730元	無	96/06/07 國商字第0960014355號
96/07	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,419,387,460	264,193,874,600	盈餘轉增：5,089,391,770元 資本公積轉增：774,890,640元	無	96/07/06 國商字第0960017514號
96/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,423,516,808	264,235,168,080	員工認股權行使：41,293,480元	無	96/09/12 國商字第0960024269號
96/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,426,201,794	264,262,017,940	員工認股權行使：26,849,860元	無	96/12/26 國商字第0960035468號
97/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,627,103,715	256,271,037,150	員工認股權行使：9,019,210元 買回股份註銷：8,000,000,000元	無	97/03/20 國商字第0970006741號
97/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,629,241,609	256,292,416,090	員工認股權行使：21,378,940元	無	97/06/04 國商字第0970014822號
97/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,151,365,437	261,513,654,370	盈餘轉增：4,452,425,160元 資本公積轉增：768,813,120元	無	97/08/06 國商字第0970021495號
97/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,936,820,778	259,368,207,780	員工認股權行使：21,293,410元 買回股份註銷：2,168,740,000元	無	97/09/10 國商字第0970024882號
97/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,902,552,963	259,025,529,630	合併剩餘股份：342,678,150元	無	97/09/23 國商字第0970027199號
97/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,625,290,957	256,252,909,570	員工認股權行使：16,129,940元 買回股份註銷：2,788,750,000元	無	97/12/17 國商字第0970035975號
98/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,625,437,256	256,254,372,560	員工認股權行使：1,462,990元	無	98/03/09 國商字第0980055952號
98/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,626,012,160	256,260,121,600	員工認股權行使：5,749,040元	無	98/08/17 國商字第0980023001號
98/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,896,009,261	258,960,092,610	盈餘轉增：1,931,207,890元 資本公積轉增：768,763,120元	無	98/08/18 國商字第0980023041號

98/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,896,353,344	258,963,533,440	員工認股權行使：3,440,830元	無	98/09/16 國商字 第0980026364號
98/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,900,662,339	259,006,623,390	員工認股權行使：43,089,950元	無	98/12/02 國商字 第0980034205號
99/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,902,706,622	259,027,066,220	員工認股權行使：20,442,830元	無	99/03/11 國商字 第0990005852號
99/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,903,769,184	259,037,691,840	員工認股權行使：10,625,620元	無	99/06/01 國商字 第0990015685號
99/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,905,017,151	259,050,171,150	員工認股權行使：12,479,670元	無	99/09/02 國商字 第0990025771號
99/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,907,343,943	259,073,439,430	員工認股權行使：23,267,920元	無	99/12/02 國商字 第0990035818號
100/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,910,078,664	259,100,786,640	員工認股權行使：27,347,210元	無	100/03/11 國商字 第1000007213號
100/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,193,297	259,141,932,970	員工認股權行使：41,146,330元	無	100/06/07 國商字 第1000015848號
100/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,283,114	259,142,831,140	員工認股權行使：898,170元	無	100/08/26 國商字 第1000025518號
100/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,149,208	259,141,492,080	員工認股權行使：8,660,600元 註銷庫藏股：9,999,660元	無	100/12/14 國商字 第1000037707號
101/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,916,222,575	259,162,225,750	員工認股權行使：20,733,670元	無	101/03/22 國商字 第1010008872號
101/07	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,920,604,605	259,206,046,050	員工認股權行使：43,820,300元	無	101/07/09 國商字 第1010020130號
101/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,920,709,359	259,207,093,590	員工認股權行使：1,047,540元	無	101/09/04 國商字 第1010027766號

註：民國年／月／日。

2、最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股執行情形：

無。

(二) 主要股東名單

持股基準日：民國一〇一年七月十日

主要股東名稱	持有股數	持有比率%
花旗託管台積電存託憑證專戶	5,485,510,828	21.06%
行政院國家發展基金管理會	1,653,709,980	6.38%
摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	813,105,396	3.14%
花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	496,005,919	1.91%
大通託管歐洲太平洋成長基金大衛費雪等專戶	413,565,136	1.60%
美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶	271,795,529	1.05%
國泰人壽保險股份有限公司	255,515,235	0.99%
寶來台灣卓越50基金專戶	237,011,423	0.91%
渣打託管 iShares MSCI 新興市場指數基金投資專戶	229,265,000	0.88%
德商德意志銀行台北分行受託保管蘇格蘭皇家銀行託管F S 太平洋領導基金投資專戶	226,137,807	0.87%

(三) 最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

不適用。

(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

項目	民國 99 年	民國 100 年	民國 101 年 1 月 1 日 至 101 年 6 月 30 日
每股市價 (註一)			
最高	72.90	78.00	88.90
最低	57.20	63.30	75.00
平均	62.01	72.09	81.01
每股淨值			
分配前	22.16	24.30	24.21
分配後	19.16	21.30	-
每股盈餘			
加權平均股數 (仟股)	25,919,814	25,924,682	25,926,504
稀釋每股盈餘	6.23	5.18	2.90
每股股利			
現金股利	3.00	3.00	-
累積未付股利	-	-	-
投資報酬分析			
本益比 (註二)	9.95	13.92	-
本利比 (註三)	20.67	24.03	-
現金股利殖利率 (註四)	5%	4%	-

註一：資料來源為台灣證交所網站。

註二：本益比=當年度每股平均收盤價 / 稀釋每股盈餘。

註三：本利比=當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利。

註四：現金股利殖利率=每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價。

(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1、公司章程所載員工分紅及董事酬勞之有關資訊

依本公司章程規定，公司分派每一營業年度盈餘時，應於依法提撥公積後，提撥所餘盈餘不高於 0.3% 作為董事酬勞，及不低於 1% 作為員工紅利。

2、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：實際配發情形與估列數無重大差異。

3、盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：不適用。

4、盈餘分配議案業經股東會決議者：

本公司於一百年度所認列之員工獎金與紅利及董事酬勞如下：

— 已發放之員工現金獎金新台幣 8,990,026,475 元

— 民國一〇一年股東常會通過後配發之員工現金紅利新台幣 8,990,026,475 元

— 董事酬勞新台幣 62,323,764 元

- 5、前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

民國一百零一年度董事酬勞及員工紅利如下，其實際配發金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

	董事會決議	實際發放數
	金額	金額
	(新台幣元)	(新台幣元)
董事酬勞（現金）	62,323,764	62,323,764
員工現金紅利	8,990,026,475	8,990,026,475
合計	9,052,350,239	9,052,350,239

貳、營運概況

一、公司經營

（一）業務內容

1、業務範圍

身為專業積體電路製造服務的創始者和領導者，台積公司的成就源自於提供客戶先進的製程技術、「超越摩爾定律」（More-than-Moore）的製程技術，以及優異的生產效率。台積公司致力於提供客戶最高的整體價值，視客戶的成功為台積公司的成功。

台積公司提供了全面整合的積體電路製造服務，滿足客戶日益多樣化的需求，也因為與客戶建立的夥伴關係而獲致極大的成長。台積公司藉由優異的最先進製程技術、領先設計服務、量產能力和產品品質，滿足客戶生產需求，並贏得來自全球客戶的信任。

民國九十八年五月，台積公司設立新事業組織，以開拓專業積體電路製造服務領域以外的相關市場機會。民國一百零一年八月，新事業組織正式獨立為台積固態照明與台積太陽能兩家子公司，持續推動固態照明及太陽能相關的二項新事業。

過去二十五年來，全球已有超過600家客戶透過台積公司生產應用於個人電腦與其週邊產品、資訊應用產品、有線與無線通訊系統產品、汽車與工業用設備，以及包括數位影音光碟機、數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子與其他應用產品的晶片。

未來終端電子產品的日新月異，將促使客戶更加廣泛地採用台積公司創新的技術與服務，同時也更促進台積公司自身的技術發展，台積公司深信成功將屬於產業的領導者而非追隨者。

■ 最近二年度銷售量值表

單位：銷售量（八吋晶圓約當片數）／銷售值（新台幣仟元）

		民國 100 年		民國 99 年	
		銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
晶圓	內銷	2,077,487	49,039,389	2,132,697	51,312,831
	外銷	10,411,227	340,588,566	9,688,352	340,474,577
包裝元件	內銷	0	0	0	0
	外銷	24,881	1,045,714	23,550	963,427
其他	內銷	19,544	4,499,828	20,278	3,974,831
	外銷	58,682	26,298,590	53,137	21,940,782
合計	內銷	2,097,031	53,539,217	2,152,975	55,287,662
	外銷	10,494,790	367,932,870	9,765,039	363,378,786

2、產業概況

■ 產業未來展望、機會與挑戰

➤ 專業積體電路製造服務市場的需求與供給

積體電路製造服務領域在民國九十九年呈現了 45% 的巨幅成長，於民國一百年僅呈現 5% 的微幅成長。此乃由於全球經濟景氣趨緩，加上日本地震和泰國水災所引起的供應鏈中斷，導致終端需求疲弱和保守謹慎的庫存管理，使得全球半導體市場成長緩慢，亦對積體電路製造服務業造成影響。

民國一〇一年整體半導體產業預計將成長 2%。展望未來，電子產品採用半導體元件的比率提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市佔率，及整合元件製造商擴大委外代工，從民國一百年至民國一〇五年，專業積體電路製造服務領域的成長可望較整體半導體產業 4% 年複合成長率為高。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與通訊、電腦、消費性電子產品等主要終端產品的市場狀況息息相關。

✓ 通訊

民國一百年通訊產業持續成長，尤其在手機方面，達到單位出貨量 10% 的強健成長。擁有較多半導體組成元件的智慧型手機，更是帶動成長的主要力道。

手機由 3G 演進至 4G/LTE 將持續推動市場的成長。民國一〇一年，擁有更高效能、更低耗電及更多智慧型應用的智慧型手機，將更為吸引消費者的購買興趣；同時，較低階的智慧型手機在新興市場國家的普及，亦是持續推動手機市場成長的動力。

低耗電特性的晶片對手機而言是不可缺少的一環。擁有最佳成本、耗電及外型尺寸的系統單晶片，以及對於運算複雜軟體的高效能需求，將加速先進製程技術的推進，而台積公司在先進製程技術方面已居領導地位。

✓ 電腦

相較於民國九十九年電腦相關領域達到兩位數百分比的成長率，民

國一百年，電腦相關領域產品的表現相對疲弱，僅微幅成長1%。主要係因已開發國家的保守支出，以及因平板電腦出現，取代了消費者在電腦上的支出。

展望民國一〇一年，電腦產業將呈現適度成長。雖然受到對未來經濟展望持續悲觀的影響，然因新興國家電腦普及率仍相對較低，依舊可望成為成長的主要動力。創新的產品特性和外型，如輕薄的超極緻筆電（Ultrabook），以及作業系統的更新，亦有助刺激電腦的消費。

隨著對需低耗電、高效能及高整合度的電腦主要半導體元件如中央處理器、繪圖處理器與晶片組等的需求增加，將促使產品設計的需求，朝向先進製程技術發展。

✓ 消費性電子

歷經民國九十九年的強勁成長後，民國一百年消費性電子業成長動能消退，整體單位出貨量與前一年度相比較呈現持平。對經濟景氣的不確定抑制了消費性電子產品的買氣，亦對許多領域產生影響，如數位電視全年均位於高庫存水位。

展望民國一〇一年，新款遊樂器的推出將帶動電視遊樂器的買氣，而數位機上盒的銷售亦將受惠於多國政府從類比轉換為數位電視廣播的政策及補助。同時，新穎的功能及積極的降價策略也將刺激數位電視、藍光DVD播放器與數位單眼相機的市場銷售量。

此外，數位消費電子產品的創新應用已創造了如觸控螢幕、運動感測、高解析度及3D顯示等在新產品上的整合使用模，除將提高對先進製程技術的需求外，也將進一步增加對如互補金屬氧化物影像感測器、高壓製程、嵌入式記憶體及微機電製程等「超越摩爾定律」（More-than-Moore）特殊製程的仰賴。台積公司提供的技術全面且完整，以求在新趨勢下持續獲利。

✓ 新興應用不斷崛起

新興應用如多媒體平板電腦對積體電路製造服務業的貢獻正在逐漸發酵。在蘋果電腦iPad的帶領下，多媒體平板電腦於民國一百年出貨已達7,300萬台，遠高於民國九十九年出貨1,700萬台，強勁的銷售動能將隨著其他廠商推出更多機型而持續成長。預期民國一百年至民國一〇五年間，多媒體平板電腦市場將以36%的年平均複合成長率，推動半導體業和積體電路製造服務業持續強勁成長。

■ 產業供應鏈

電子產品的供應鏈不僅複雜冗長，且各個環節環環相扣。作為產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供及時且充足的產能以因應市場的激烈變化，而積體電路製造服務更是確保產業鏈穩定的重要元素。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者，將持續提供最先進的製程技術及充足的產能，以確保整體產業的穩定與持續創新。

3、技術及研發概況

■ 研發團隊之組織與投資

民國一百年，台積公司持續擴大研發規模，進一步強化技術領先優勢，並新設一個研發製程中心（R&D Process Center）以加速製程進入量產製造。

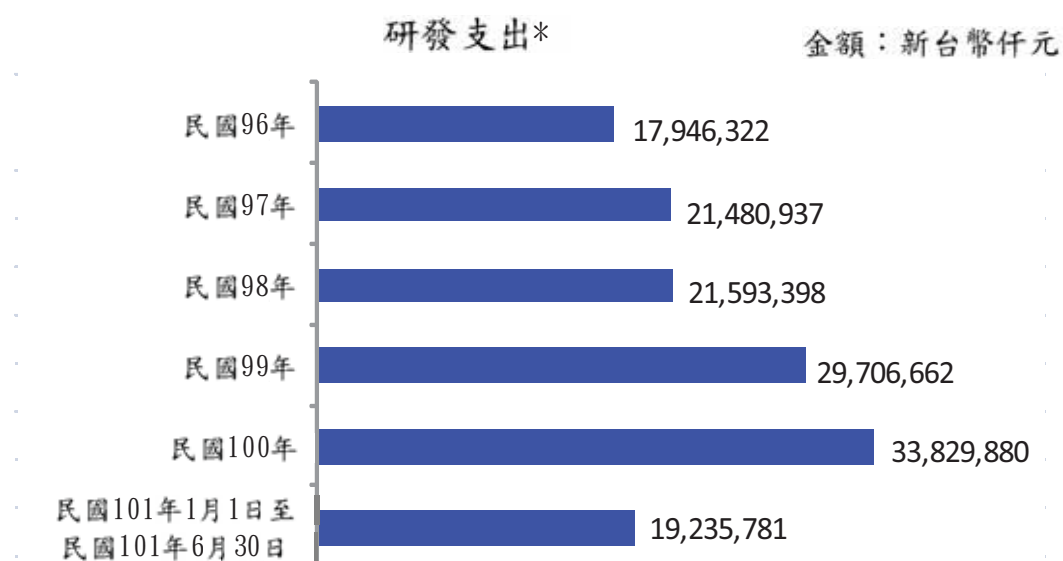
全年研發預算約佔總營收之 7.9%，此一研發投資規模不僅與眾多世界級一流半導體科技公司相當，甚至超越了許多公司的規模。由於研發預算增加，台積公司也同時擴增研發團隊人力，增幅超過 13.3%。

有鑑於驅動互補金屬氧化物半導體（CMOS）製程微縮的摩爾定律是否能繼續延伸，已面臨眾多技術面之困難，在擁有豐富半導體研發經驗的研發副總經理們的領導下，台積公司持續努力提升其研發組織的能力，相信將能克服眾多技術及未來的挑戰。民國一百年，台積公司是第一家 28 奈米製程技術進入量產的專業積體電路製造服務公司，並且已經開始出貨給客戶。透過迅速密集的努力，此一先進製程技術在民國一百年第四季貢獻總營收將近 2%，預計民國一〇一年將會有更顯著的成長。

同時，台積公司亦更進一步加速先進元件技術的發展，除嵌入式記憶體與超低介電層銅導線技術的發展外，也特別在 16 奈米製程導入 3D 立體結構的鰭式場效電晶體（FinFET）先進製程技術。此外，台積公司於民國一百年持續領先專業積體電路製造服務領域，提供 28 奈米高介電層／金屬閘（HKMG）製程服務，成功開發 20 奈米先進製程技術，並領先研發 16 奈米先進元件的創新領域，再次證明了台積公司研發團隊的堅實能力。

台積公司亦致力於擴展與研發夥伴的合作以及與世界級研發機構的聯盟，例如：台積公司是位於比利時的知名半導體技術研發中心 IMEC 和位於美國紐約州 SEMATECH 的核心會員，同時也與矽智財公司策略合作，促成先進製程之矽智財研究發展。此外，台積公司也加強與主要合作夥伴對設計和製程做最佳化的研究開發，並持續贊助國內外主要的大學從事奈米科技研究，以推動創新及先進技術。

上述研發上的努力與投入，讓台積公司屢屢能夠領先專業積體電路製造服務領域，提供客戶最新的量產製程技術與設計解決方案，以協助客戶在複雜且充滿挑戰的市場環境成功且快速地推出產品。



*合併基礎下的研發支出。

■ 民國一百年研究發展成果

➤ 研究發展組織卓越成果

✓ 28 奈米製程技術

台積公司持續以最尖端的 28 奈米製程技術在專業積體電路製造服務領域領先，已經達成包含效能破紀錄的高介電層／金屬閘電晶體、第五代超低介電層銅導線技術及第二代浸潤式曝光技術在 28 奈米製程的量產。

台積公司的 28 奈米製程技術提供高效能(28HP)、高效能低耗電(28HPL)、低耗電(28LP)以及高效能行動運算(28HPM)等製程。在這些製程中，28HP、28HPL 以及 28LP 皆已完成驗證並成功產出場域可程式化閘陣列(FPGA)、繪圖晶片(GPU)、中央處理器(CPU)以及移動式單晶片系統(Mobile SoC)等產品。此外，28HPM 亦在民國一百年底完成驗證。

客戶在 28 奈米投片的數量是 40 奈米同時期的二倍，目前已有超過 80 個客戶產品投入生產線，較之前世代同期更快進入初期量產，並擁有更佳良率，這是我們與客戶更早且更密切合作的成果。

✓ 20 奈米製程技術

民國一百年，台積公司持續專注於研發 20 奈米先進製程，包含制定基礎製程、研擬設計法則、建構 SPICE 模型以及評估製程可靠性。為了提供領先的類比及數位應用產品的晶片製造技術，台積公司採用先進的微影(Lithography)技術，以因應更小尺寸的晶片製造。由於結合了第二世代的高介電層／金屬閘(HKMG)元件結構、更多的矽應力與新元件結構等優勢，純電晶體之執行效能仍然依循摩爾定律而進一步提高。此外，藉由採用一種特別設計的技術，能夠有效地減少與控制外在電阻(External Resistance)；而後段製程(Back-end of Line, BEOL)亦擁有以超低介電層作為金屬間介質材料以及採用創新低電阻銅金屬化製程的優勢。結合上述創新製程之優勢，台積公司 20 奈米邏輯電晶體與靜態隨機存取記憶體單位元(Bit Cell)能夠涵蓋包括高效能與系統單晶片相關產品之應用。

20 奈米技術的發展需要極高的閘級密度與晶片效能，然而隨著製程的日益先進，客戶所要面對的昂貴成本與複雜度也持續增加。民國一百年，台積公司成功產出製程開發載具(TV1R)、缺陷抑制載具(BEYT)及內含先進 ARM 核心區塊的邏輯良率提升載具(PQV)。台積公司利用這些載具進行製程開發，於民國一百年提出 0.1 版製程流程、設計工具(設計法則，SPICE 模型與 PDK 製程設計套件)與矽智財，協助客戶降低製造成本。台積公司如期達成精進電晶體性能目標，並締造領先群倫的靜態隨機存取記憶體單位元的操作良率。台積公司的高性能低漏電 20 奈米先進製程預計於民國一〇一年下半年進行試產。

✓ 16 奈米製程技術

藉由在非平面形電晶體架構—鰭式場效電晶體的先進電晶體發展，台積公司在民國一百年第三季順利邁入 16 奈米製程技術世代，並已在實驗光罩的預備上取得了極佳進展。以搭配高介電層／金屬閘及創新應變矽的鰭式場效電晶體為基礎，16 奈米製程技術的定義正順利進行

中。

✓ 微影技術

台積公司的28奈米微影技術目前已經技術移轉至超大晶圓廠—晶圓十二廠，同時完成史無前例的低k1技術，並且已經通過無數客戶的產品驗證。台積公司的28奈米微影技術包含光罩線寬與配置控制、晶片線寬均勻度（Wafer CDU）與疊對精確度（Overlay Accuracy）、光學近接效應修正（Optical Proximity Correction）、微影成像驗證（Lithography Patterning Checking）以及光阻、曝光機、塗佈機與降低缺陷等技術。

台積公司20奈米世代的微影技術著重在將雙重成像的技術運用在眾多關鍵層上，促使曝光機的運作得以超越本身解析度的極限，成像密度因而可達到28奈米技術的1.9倍。G-rule因雙重成像而存在，但由於雙重成像的要求，光罩製作、微影製程的景窗（Lithography Processing Window）、疊對精確度、圖樣修正、熱點檢測（Hotspot Checking）、光阻以及缺陷多寡皆使20奈米技術的挑戰更甚於28奈米世代。此外，新平台的使用，也為曝光機的可靠度帶來新的挑戰，但這些技術的充分開發正也是SRAM良率改善的重要原因。

台積公司繼續使用浸潤式微影技術來進行16奈米世代的技術開發，EUV微影技術將期望在10奈米世代導入，多重電子束直寫（Multiple E-beam Direct Write）將持續研發並瞄準7奈米世代。

在成熟技術的開發上，研發組織的微影團隊也成功突破以往的技術極限，例如開發一種負成像技術來降低來自晶圓邊緣的金屬污染；成功完成三項eFlash的開發並且已經技術移轉至晶圓廠。民國一百年夏天，台積公司利用荷蘭ASML公司所生產的完整曝光場（Full-field）EUV曝光機，已在晶圓十二廠發展14奈米及以下世代的元件微影技術，而EUV光罩製作與晶片製程的基本程序也皆在開發中。

此外，MAPPER公司的pre-alpha機台也持續於晶圓十二廠製作小曝光區域的測試圖案，而MAPPER公司能夠進行完整曝光及對準並擁有1500電子束的Matrix機台，則預計在民國一〇一年或一〇二年可以完成研發及交貨。另外，我們亦正在模擬KLA-Tencor機台的可行性、性能及改善方案。目前兩家曝光機公司皆在評估多重電子束直寫的微影技術，這項技術不只擁有關鍵層顯像的潛能，更具備降低非關鍵層生產成本與十八吋晶圓成像成本的能力。

✓ 光罩技術

光罩技術是先進曝光顯影技術中極為重要的一環。台積公司擁有最先進的光罩製造技術，並善用此一優勢，開發出最佳化的增強曝光顯影解析度的技術。藉由整合光學近接校正、掃描式曝光機參數優化與先進的光罩技術，台積公司提供193奈米浸潤技術的完整解決方案。民國一百年，台積公司在其十二吋超大晶圓廠—晶圓十二廠啟用了最新的研發光罩設備，包括最先進的電子束光罩寫入器、蝕刻機、檢測、修復、驗證及量測機台，以進行光罩技術的發展，並針對10奈米製程技術以及更先進製程技術，積極投入極紫外光（EUV）微影光罩架構開發。台積公司的光罩技術擁有優異的技術能力，提供客戶最高品質的

光罩、快速的交貨期，以及一站式的服務，為客戶帶來重要且獨特的價值。

➤ 導線與封裝技術整合

導線與封裝技術整合部門 (Integrated Interconnect and Package Development Division, IIPD) 於民國九十七年底成立，負責開發與提供結合先進導線和封裝技術的整合技術解決方案，同時也肩負許多具有挑戰性的任務，包括將超低介電層 (Extreme Low-K Dielectric, ELK) 導入 45/40 奈米製程技術。民國一百年的研發重點在於突破導線與封裝相關技術瓶頸，並確保第一批採用 28 奈米製程技術的客戶產品能夠順利量產。此外，我們增加了先進覆晶封裝技術—銅柱導線直連 (bump-on-trace, BOT) 於後段的技術組合。另外，台積公司發展中的 CoWoS™ (Chip on Wafer on Substrate) 技術為三維積體電路 (3D-IC) 客戶提供精簡的整合服務，其目標是使台積公司成為系統微縮的技術大廠，主要客戶產品涵蓋高性能裝置如：加速處理器 (APU)、繪圖核心晶片 (GPU) 和可編程邏輯開陣列 (FPGA)；與可攜式裝置如：應用處理器 (AP)、基頻 (BB)、射頻收發器 (TRx) / WiFi 等。

✓ 先進導線技術

民國一百年，台積公司持續聚焦在開發最低RC延遲的先進導線技術。針對20奈米製程世代，台積公司已經開發一種金屬層結構 (Metal Scheme) 以達成好的布局微縮密度，同時將電阻／電容RC延遲最小化。

由於製程技術持續推進所引發的尺寸效應，銅導線電阻率也隨之增加。有鑑於此，台積公司針對20奈米及更先進製程技術已開發有效的解決方案，以確保先進導線的RC性能與可靠性目標。20奈米的銅導線有效電阻率深具競爭力且符合國際半導體技術藍圖 (The International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS) 的預估值。

✓ 先進封裝研究發展

為了提供創新和具競爭力的無鉛凸塊／封裝解決方案，在民國一百年，台積公司已開發並合格化具有超精細間距陣列銅凸塊的銅柱導線直連封裝 (BOT) 28 奈米技術以用於可攜式裝置。我們也擴大了 28 奈米無鉛 (SnAg) 封裝技術的範圍，以涵蓋更大的晶粒尺寸 (420mm²)，使其能應用於高效能裝置如繪圖核心晶片／中央處理器／可編程邏輯開陣列。此外，台積公司亦已開發並提供 28 奈米扇入型晶圓級封裝 (Fan-in Wafer Level Package)，以應用於手持式裝置 (高達 50mm² 的晶粒尺寸)，此將進一步提升客戶產品效能、外觀尺寸和整體競爭力。

✓ 三維積體電路 (3D IC)

民國一百年，台積公司發展出符合成本效益的三維積體電路系統整合方案 (3D IC CoWoS™)，也發展出與積體電路製造服務業者相容的晶圓級封裝 (Wafer Level Packaging, WLP) 技術。台積公司的 CoWoS™ 解決方案提供一個精簡的整合製程，以利客戶開發的產品達到成本最

佳化與產品週期最佳化。台積公司首次提供多項技術方案以便客戶作三維晶圓級封裝 (System-in-Package, SiP) 的設計，其中包含三維晶圓級封裝設計、封裝電性分析及參數粹取、時序、訊號完整性、阻抗壓降，以及散熱與物性設計準則查驗(DRC)和布線與布局比對(LVS)。此整合解決方案預計將於民國一〇一年起提供給客戶。

➤ 先進電晶體元件研究發展

前段模組專注於電晶體元件的技術，後段模組則專注於金屬導線的技術。電晶體元件的效能需求依照產品市場而不同，分為高效能應用產品與低耗電應用產品。台積公司以泛用家族 (G-family) 電晶體元件來滿足高效能應用產品的需求，並以低耗電家族 (LP-family) 電晶體元件馳騁低耗電應用產品領域。此外，台積公司提供非常緊密的金屬導線後段技術以達到大幅的微縮密度。新建置的研發製程中心 (R&D Process Center) 以縮短電晶體元件調校時程來大幅加速製程進入量產製造，以確保先進電晶體元件上的領先地位。

➤ 多樣且完備的製程技術

除了上述先進製程的研發成果，台積公司亦持續成功開發出多樣化的新製程技術，並加速了系統單晶片的技術藍圖，以提供更高的整合度及更多的不同選擇。

✓ 混合訊號／射頻技術

在 20 奈米先進製程部分，台積公司利用校準之電磁模擬程式成功開發出 LC-Tank 設計套件，以促成日益高速之串化器 (Serdes) 之電路設計。經由多次製制化經驗之累積，工程專家可迅速針對不同客戶之 LC-Tank 設計布局及金屬層結構 (Metal Schemes)，滿足客戶各自客製化設計流程之需求。針對開發長程演進第四代手機之低功率射頻收發器之需求，已成功發展出第一版全套件之金屬閘極射頻 CMOS 技術平台。在「超越摩爾定律」的應用方面，正在進行 40 奈米射頻技術之精進，以促成更具競爭力之電路設計。

✓ 電源 IC／雙極—互補金屬氧化半導體—雙重擴散金屬氧化半導體 (BCD) 技術

民國一百年，台積公司強化 0.25 微米 BCD 電源管理製程以提供強化的雙載子電晶體 (BJT)；並推出完整的功率元件特性分析及應用手冊，以加速客戶之產品設計。除此之外，台積公司亦推出具業界最佳效能之功率電晶體第二代 0.18 微米 BCD 製程。

✓ 面板驅動技術

在行動元件顯示器驅動技術方面，台積公司正與客戶合作，提供 N80HV 技術以支援高階智慧手機之面板。

在電視顯示器的驅動技術方面，台積公司正發展一個相當具有競爭力的新技術，可以減少 40% 的成本。

✓ 微機電系統技術

台積公司開發出整合一體之加速計技術，與其他競爭品相較，此產品顯示極佳之雜訊及功耗特性。

✓ 快閃記憶體／嵌入式快閃記憶體技術

民國一百年，台積公司繼續在 55 和 65 奈米嵌入式快閃記憶體技術完成數項重要的里程碑。在 65 奈米分離閘 (Split Gate) 技術，商業應用層面已完成產品可靠性的驗證，並且也開始初步量產計劃。這是發展更嚴格品質要求的車用型規格應用製程的前置條件。在混成式 (Hybrid) 製程技術已經在晶片卡驗證成功並且也達到好的良率，車用型規格產品亦將進行驗證程序。

台積公司將持續保持在嵌入式快閃記憶體技術的領導地位，本公司將繼續和先進半導體元件製造公司合作開發下一世代的 40 奈米嵌入式快閃記憶體解決方案。

■ 技術平台

現今積體電路設計者需要一套精緻的設計基礎架構，來達成令人滿意的生產力及生產週期。這其中包括了電子設計自動化 (EDA) 流程、通過矽晶片驗證的資料庫和矽智財、模擬及驗證用的設計套件，如：製程設計套件 (PDK) 及技術檔案。這些都以製程技術為建構的基礎，而每一項製程技術都需要有各自的設計基礎架構，讓設計者容易使用，這就是技術平台的概念。

台積公司的技術平台展現了多年來台積公司與其策略夥伴所合作的最佳成果。自從民國九十七年台積公司推出「開放創新平台」以來，台積公司持續增加了合作的成果以加強技術平台的內容。

民國一百年五月，台積公司經由「開放創新平台」的合作，發表了完整的 28 奈米設計生態系統的成果。台積公司的 28 奈米設計生態系統是以基礎設計組件為主，諸如：設計法則檢查 (DRC)、布局與電路比較 (LVS) 和製程設計套件 (PDK)；基礎矽智財，包括標準元件庫 (Standard Cell)、標準輸出入單元 (Standard I/O)、可編程融絲 (eFuse) 與記憶體編譯器 (Memory Compiler)；以及標準的矽智財介面元件，諸如：通用串列匯流排 (USB)、周邊元件互連介面 (PCI) 和雙倍資料率動態隨機存取記憶體 (DDR)／低功耗雙倍資料率動態隨機存取記憶體 (LPDDR)。客戶能夠很輕易地從台積公司所建置之網站下載這些資料。再者，電子設計自動化工具 (EDA) 也都完成及時的改版與更新，以滿足客戶 28 奈米設計的技術需求。

民國一百年，台積公司針對最關鍵性的設計挑戰，在參考設計流程 12.0 中提出它的解決方案，延續其一貫的傳統推動符合客戶需求的設計方法，以完成台積公司 28 奈米的整體設計架構。參考設計流程 12.0 的多項功能包含了 2.5D/3D 積體電路、28 奈米模擬數據、可製造性設計 (DFM) 速度的改進，以及為了整合台積公司製程技術功率、效能和空間 (PPA) 最佳化到系統設計的電子系統階層 (ESL) 設計方案。除此之外，參考設計流程 12.0 揭露了台積公司 20 奈米雙重曝光設計解決方案，以作為在「開放創新平台計劃」(OIP) 之下持續發展 20 奈米設計能力的一部分計劃。

參考設計流程 12.0 呈現了新的設計能力應用在布局規劃 (Floor-planning)、阻抗壓降 (IR-Drop)、布局與繞線 (Placement and Routing) 和熱傳導分析，以達到多個晶粒同時設計時可分析測試的目的，以及支援 2.5D 的新設計及測試方法。

民國一百年五月，台積公司同時也發表積體電路製造服務領域的類比／混合

訊號參考設計流程第二版 (AMS 2.0)，以及射頻設計參考流程套件第三版 (RF RDK 3.0)。新的 AMS 參考設計流程，是延伸民國九十九年第一代的客製化設計流程，來幫助客戶在 28 奈米客製化設計時，能確保遵守可製造性設計 (DFM) 和限制性設計法則 (RDR)。這提供了客戶在使用台積公司製程套件 (PDK) 和可製造性設計工具時，有正確的設計組態和選項設定。除此之外，台積公司應用多年來在可靠性測試上累積的經驗，和生態系統的策略夥伴針對已知潛在的可靠性測試共同推出創新的解決方案。

這次更新的射頻設計參考套件 (RF RDK) 針對設計者經常會遇到的瓶頸，提供了解決方案。射頻設計參考套件 3.0 包含了先進的、矽相關的 60GHz 毫米微波設計套件，以及創新的方法及解決客戶使用他們用自己的感應器元件在電磁波模擬中所遇到的問題。

在民國九十八年首次推出一系列的共通寄生元件參數萃取程式 (iRCX)、共通設計法則檢查 (iDRC)、共通布局與電路比較 (iLVS)，以及共通製程設計套件 (iPDK) 多項電子設計自動化技術檔案格式之後，台積公司在民國九十九年繼續推出半導體業界第一個 40 奈米的共通設計法則檢查 (iDRC)、共通布局與電路比較 (iLVS)，和從 0.13 微米到 28 奈米等許多製程的設計套件 (iPDK)。民國一百年，台積公司推出由共通格式延伸出的共通金屬層密度填補 (iFill)，以涵蓋製程前端和後端密度填補的需要。同時，台積公司繼續完成 28 奈米在 LP、HP、HPL 和 HPM 的共通布局與電路比較 (iLVS) 以及共通寄生元件參數萃取程式 (iRCX)，以加強在共通技術檔案的內容。

為了確保開放創新平台合作夥伴符合台積公司新製程的要求，台積公司和相關的合作夥伴在 TSMC-Online 上發佈「電子設計自動化工具驗證報告」(EDA Tool Qualification Report)，以提供客戶主動性的維護，包含設計法則檢查 (DRC)、布局與電路比較 (LVS)、寄生元件參數萃取 (RCX) 及布局與繞線工具 (Placement and Routing)。DRC、LVS 與 RCX 的實體驗證工具報告每季更新一次，而且也開始涵蓋 iDRC、iLVS、iRCX 與 iFill。

為了降低客戶採用先進製程的障礙，台積公司先後在民國九十八年提供 65/55 奈米的整合設計流程 (Integrated Sign-Off Flow, ISF)，以及在民國一百年提供 40 奈米整合設計流程兩項設計解決方案。ISF 是一個奠基於台積公司多年設計經驗所誕生的產品驗證設計流程。台積公司在 ISF 所投入的努力，在民國九十九年開花結果，讓多數初次使用 65/55 奈米製程的客戶群自 0.13 微米等成熟製程成功地移轉至先進製程，並大幅降低中國大陸等新興的市場採用先進製程技術的門檻。而 40 奈米整合設計流程的推出更進一步地幫助客戶掌握更多的商機，例如幫助客戶在中國市場上成功地推出 40 奈米的移動裝置應用處理器與第三代／第四代通訊晶片。

Soft IP 聯盟計劃希望能加速 Soft IP 在先進製程準備就緒並提早上市的時程。多年以來，Soft IP 的發展獨立於製程技術之外，因此在晶片的用電、效能與面積等方面並未達到最佳化。基於系統單晶片 (SoC) 等高整合性的晶片設計，對於「首次生產即成功」與「提早產品上市時程」的需求與日俱增，積體電路製造與矽智財業者之間的緊密技術合作將更形重要，才能讓晶片設計達到最佳表現。

民國一百年，台積公司建立一個專注於品質管理的系統以確保 Soft-IP 的最高品質並延續在 Hard-IP 成功實現的高效能品質紀錄。客戶現可經由

(二) 市場及產銷概況

1、市場分析

民國一百年，全球半導體市場的產值估計約為美金3,000億元，較民國九十九年成長0.4%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值約為美金298億元，年成長率為5.1%。民國一百年，專業積體電路製造服務領域的最大市場（依據客戶總部所在地區）為北美地區，佔全球市場的61%；第二大市場為日本以外的亞太地區，佔28%；其次為歐洲市場佔8%；日本市場則佔3%。

即使面對既有競爭者及新進競爭者的挑戰，台積公司在全球半導體業之積體電路製造服務領域，仍以49%的市場佔有率持續保持領先地位。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域保持領先地位的重要關鍵。截至民國一百年第四季，台積公司已有59%的晶圓製造服務營收來自於65奈米及以下更先進製程；同年八月，更成功締造了45/40奈米十二吋晶圓出貨第一百萬片的新里程碑。同時，台積公司也領先專業積體電路製造服務領域，提供客戶最先進的28奈米製程服務。

除了聚焦贏得了客戶信賴外，台積公司於民國一百年亦持續強化「開放創新平台」（Open Innovation Platform®），以提供更多的創新服務。在民國一百年舉辦的台積技術論壇（TSMC Technology Symposium）及IEEE設計自動化會議（Design Automation Conference of IEEE/ACM），台積公司發表了參考設計流程12.0、射頻技術參考設計套件（Radio Frequency Reference Design Kit）第三版、類比混合訊號參考設計流程（Analog Mixed-Signal Reference Flow）第二版，以彰顯透過「開放創新平台」整合設計的成功。於民國一百年十月在美國聖荷西舉行兩天的「開放創新平台生態論壇」（OIP Ecosystem Forum）邀請了客戶及生態產業夥伴共襄盛舉，展示透過「開放創新平台」合作所創造之價值及促進創新之綜效。此外，台積公司之「開放創新平台」的商業模式於民國一百年十二月得到政府所頒發的「國家產業創新獎」之「年度創新領航獎」，更彰顯「開放創新平台」為半導體產業帶來的益處。

台積公司持續提升半導體製程技術，在民國九十九年開發和已提供的製程包括：

- 發展20奈米製程技術，以提供最佳的速度與功耗比支持像中央處理器(CPU)、圖像處理器 (GPU)、加速處理器 (APU) 及場域可程式化開陣列 (FPGA) 性能主導的產品以及行動運算之應用如智慧型手機、平板電腦及高端的系統單晶片 (SoC)。
- 28奈米高性能製程技術(28HP)支援中央處理器、圖像處理器、加速處理器、場域可程式化開陣列及高速網路晶片等性能導向之應用。
- 28奈米高性能行動運算製程技術(28HPM)支援平板電腦、智慧型手機及高端的系統單晶片之應用。
- 28奈米低功耗製程技術(28LP & HPL)及射頻製程技術(28HPL-RF)提供主流智慧型手機、應用處理器 (AP)、平板電腦、家庭娛樂及數位消費性電子產品之應用。
- 40奈米泛用型製程技術(40GP)支援中央處理器、圖像處理器、場域可程式

化開陣列、硬碟控制器 (HDD)、遊戲機 (Game Console) 及千兆位元乙太網路控制器 (GbE) 等性能導向之應用市場。

- 40奈米低耗電及射頻製程技術(40LP & RF)提供手機基頻晶片(Cellular BB)、應用處理器、數位電視(DTV)、機頂盒(STB)、遊戲晶片及無線網路連接產品解決方案。
- 與客戶共同開發40奈米及65奈米非揮發性嵌入式快閃記憶體(eFlash)製程技術以符合高端車用電子應用。
- 55奈米低耗電射頻技術提供無線區域網路(WLAN)、手機基頻晶片、數位電視、機頂盒、藍芽(Bluetooth)、可攜式媒體播放器(PMP)、行動上網裝置(MID)及手持裝置等應用。
- 55奈米及65奈米製程技術以提供無線區域網路、手機基頻晶片、數位電視、機頂盒、藍芽、藍光光碟播放器(Blue-ray DVD)及硬碟控制器等應用。
- 55奈米及85奈米低耗電製程技術支援快閃記憶體控制器(Flash Controller)之應用。
- 80奈米高壓製程支援高畫質(HD720)面板驅動晶片，可讓智慧型手機達到視網膜解析度(RETINA)顯示品質。
- 90奈米嵌入式快閃記憶體技術已通過特定應用積體電路及微控制器晶片應用規格驗證並已量產。
- 0.18微米超低漏電(Extreme Low Leakage，比一般0.18微米製程降低98%漏電電流)的嵌入式快閃記憶體技術已通過對功耗極敏感應用之驗證。
- 0.18微米及0.25微米已通過一次性可程式化快閃記憶體技術驗證，以支援車用電子應用。
- 0.18微米及0.25微米高精度類比製程已經全面釋出給要求性能的類比混合訊號之應用。
- 0.18微米BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)新一代的製程技術已進入提供Beta版給客戶支援數位電源管理晶片之階段，讓客戶設計具有競爭優勢的Rdson性能及擁有最佳化的成本架構。

此外，台積公司在民國一百年持續強化特殊製程技術的開發，包括背面照度互補金屬氧化物影像感測器製程(BSI CIS)、90/65奈米嵌入式快閃記憶體製程、0.5微米超高壓功率IC及0.13微米類比製程。民國一百年，台積公司更開始提供三維微機電系統(3D MEMS)平台、厚達30微米之微機電系統架構及晶圓級封裝技術給第一波的無晶圓廠之設計公司。此第一波客戶採用台積公司微機電系統平台整合客製化的驅動晶片於加速度計(Accelerometer)的應用。台積公司將提供全面整合的互補金屬氧化物三維微機電系統(CMOS 3D MEMS)平台及設計準則於民國一〇一年第一季成為標準支援項目。這些特殊製程技術是台積公司與其他競爭者的重要差異，能提供予客戶更多價值。

■ 台積公司之市場定位、差異化與策略

➤ 台積公司的市場定位

身為專業積體電路製造服務領域的領導者，台積公司在民國一百年的合

併營收約為美金 145 億元，佔積體電路製造服務領域的 49%。依據地區劃分，其中來自北美市場的營收佔台積公司總體營收的 69%、日本與中國大陸以外的亞太市場佔 14%、歐洲市場佔 9%、中國大陸市場佔 4%、日本市場亦佔 4%。依據終端產品市場來區分，電腦相關產品佔台積公司總體營收的 22%、通訊相關產品佔 49%、消費性電子產品佔 10%、工業用等其他產品則佔 19%。

➤ 台積公司的差異化優勢

台積公司在業界的領導地位奠基於「先進技術、卓越製造、客戶信任」三位一體的差異化競爭優勢。身為技術領導者，台積公司一直以來均為首家致力研發下一世代先進技術的專業積體電路製造服務公司；身為製造領導者，台積公司以優良的良率管理著稱，並提供加速產品上市及量產的最佳支援服務；在客戶信任上，台積公司也以與客戶緊密無間的合作來提升設計和製造效率。前瞻未來，台積公司將持續藉由三位一體的競爭優勢，提供客戶最有價值的服務。

➤ 台積公司策略

台積公司深信，差異化優勢將使台積公司更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。因此，台積公司致力於保持與提升上述的三大競爭優勢，例如：積極投入 28 奈米和 20 奈米先進製程以保持技術上的領先。此外，台積公司也不遺餘力地確保製造優勢，例如：不斷提升可製造性設計的支援服務，以提升良率及效率；推出「開放創新平台」，透過設計生態系統介面與由台積公司主動發起或提供支援的設計服務，能有效率地帶動整體半導體業供應鏈每個環節的創新。最後，在客戶關係上，台積公司於民國一百年持續進行客戶評量與調查，以進一步瞭解客戶需要，作為調整服務的參考，以強化與客戶的關係。

為了克服晶圓銷售價格不斷下滑及因應市場上激烈競爭的挑戰，台積公司計劃將繼續強化其核心能力與價值，適切地規劃公司長短期策略，以提高投資報酬率和成長目標。

2、最近二年度主要產品別毛利率重大變化說明

不適用。

二、轉投資事業

(一) 轉投資事業概況

截至民國一百一十二年十二月三十一日止

單位：為新台幣仟元

轉投資事業	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額(仟股)
				股數 (仟股)	股權 比例 %				本期認列 之投資 (損)益 (註一)	分配股利	
TSMC Global	一般投資業務	\$42,327,245	\$44,071,845	1	100	\$44,071,845	-	子公司	\$ 431,368	-	-
TSMC Partners	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務	31,456,130	34,986,964	988,268	100	34,986,964	-	子公司	1,745,799	-	-
世界先進公司	積體電路、大型、超大型積體電路及其零組件之研發、設計、製造、封裝、測試及銷售	13,232,288	8,988,007	628,223	39	7,864,522	\$6,627,758	採權益法評價之被投資公司	(10,337)	376,231	-
台積太陽能公司	可再生能源及節能相關之技術與產品之研究、開發、設計、製造及銷售	11,180,000	10,153,244	1,118,000	100	10,153,244	-	子公司	(982,868)	-	-
台積固態照明公司	固態照明裝置及其相關應用產品與系統之研究、開發、設計、製造及銷售	2,270,000	1,746,893	227,000	100	1,746,893	-	子公司	(523,002)	-	-
SSMC	積體電路之製造及供應	5,120,028	6,289,429	314	39	6,075,445	-	採權益法評價之被投資公司	1,143,147	1,914,392	-
台積電中國子公司	依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路	18,939,667	13,542,181	-	100	13,583,214	-	子公司	2,098,233	-	-
TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務	333,718	2,981,639	11,000	100	2,981,639	-	子公司	197,493	-	-
VTAF III	新創科技事業之投資	3,869,286	2,992,763	-	99	2,971,812	-	子公司	(273,038)	-	-

精材公司	品圓級品方尺寸之封裝業務	1,357,890	1,606,694	94,011	40	1,606,694	-	具控制力之被投資公司	54,449	92,943	-
創意公司	積體電路元件之研究、開發、生產、測試及銷售	386,568	1,157,188	46,688	35	1,157,188	4,645,442	採權益法評價之被投資公司	183,843	139,601	-
VTAF II	新創科技事業之投資	949,267	762,135	-	98	756,125	-	子公司	31,629	-	-
Emerging Alliance	新創科技事業之投資	892,855	213,235	-	99	213,235	-	子公司(註二)	(11,129)	-	-
TSMC Europe	市場行銷業務及工程支援業務	15,749	205,171	-	100	205,171	-	子公司(註二)	34,937	-	-
TSMC Japan	市場行銷業務	83,760	161,601	6	100	161,601	-	子公司(註二)	4,523	-	-
TSMC Korea	客戶服務及技術支援業務	13,656	23,448	80	100	23,448	-	子公司(註二)	3,263	-	-

註一：本期認列之投資(損)益業已考量聯屬公司間未實現銷貨利益之影響數。

註二：本期認列之投資(損)益係依該公司同期間未經會計師查核之財務報表計算。

(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形
無。

三、重要契約

截至民國一〇一六年六月三十日止

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容/限制條款
合資協議書	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司、新加坡經濟發展局（在民國九十五年九月間，飛利浦公司已更名爲恩智浦之飛利浦半導體股份有限公司。台積公司與恩智浦公司在民國九十五年十一月自新加坡經濟發展局購買其所擁有之全數 SSMC 公司股份後，新加坡經濟發展局已不再爲此合資協議書之契約對象。）	於民國八十八年三月三十日生效，得依合約規定終止。	台積公司與飛利浦公司、新加坡經濟發展局同意共同出資於新加坡設立晶圓代工公司 Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)。依約定飛利浦公司（現爲恩智浦公司）與台積公司有義務購買 SSMC 特定比例之產能。
技術合作契約	Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)	民國八十八年三月三十日至民國九十三年三月二十九日，任一方向於到期前一年以書面通知他方期滿終止合約者，本合同自動展延五年。民國九十六年十二月二十日至民國一〇六年十二月三十一日	台積公司應移轉特定製程技術予 SSMC，SSMC 則應按其銷售收入淨額之特定比率支付技術報酬金予台積公司。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十六年十二月三十一日	雙方就特定之半導體專利達成交叉授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
製造、授權及技術移轉契約	世界先進半導體電路股份有限公司	民國九十三年四月一日至民國九十五年三月三十一日，每次合約到期將自動展延一年，直到合約雙方當事人以書面合意決定終止。民國九十一年十一月一日至民國一〇一年十月三十一日	世界先進公司保留其特定產能予台積公司，並依雙方約定之條件爲台積公司製造特定產品。台積公司移轉特定技術予世界先進公司，並向世界先進公司收取權利金作爲報酬。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十一年十一月一日至民國一〇一年十月三十一日	雙方就特定之半導體專利達成交叉授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十年一月一日至民國一百零一年十二月三十一日	雙方就特定之半導體專利達成交叉授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
修訂研究及發展合作契約	恩智浦公司 (NXP B.V.)	民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日，雙方另可每年合意展延之。	雙方就特定之先進半導體技術達成共同開發之協議。

註：除日常的一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂其他重要契約。另本公司於財務報表中亦揭露「重大承諾及或有事項」，請參閱本公司財務報表

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源

- 1、目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
- 2、計畫所需資金總額：新台幣 4,400,000 仟元。
- 3、資金來源：發行一〇一年度第三期無擔保普通公司債新台幣 4,400,000 仟元。
- 4、計畫項目及預定運用進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金金額	預定資金運用進度
			101 年度
			第四季
購置機器設備	101 年第四季	4,400,000	4,400,000

(二) 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法

- 1、公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司。
- 2、公司債總額及債券每張之金額：公司債發行總額為新台幣肆拾肆億元整，每張票面金額新台幣壹仟萬元。

3、公司債之利率及計、付息方式：

本公司債利率為固定年利率，利率 1.53%。自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。以每仟萬元為基準計付利息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

4、公司債發行期限及還本：

本公司債發行期限為十年期，到期一次還本。

5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行股份有限公司，以備兌付到期本息。

6、公司債募得價款之用途及運用計畫：購置機器設備。

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣柒佰伍拾陸億元整。

8、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

截至 101 年 6 月 30 日止，核定股本金額為新台幣貳仟捌佰零伍億元整

(NT\$280,500,000 仟元整)，每股面額新台幣壹拾元(NT\$10)整，已發行普通股新台幣貳仟伍佰玖拾貳億柒佰零玖萬肆仟元整(NT\$259,207,094 仟元整)。

9、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：

截至 101 年 6 月 30 日止，該項餘額為新台幣陸仟貳佰壹拾參億玖仟貳佰零參萬參仟元整(NT\$621,392,033 仟元整)。

10、證券管理機關規定之財務報表：

請參閱本公開說明書「肆、財務概況」。

11、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司為各債權人(以下簡稱債權人)之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並與本公司訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予承認，並同意授與受託契約有關受託事項之全權代理，此授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

13、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用。

14、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

15、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

18、附認股權者，其認購辦法：不適用。

19、董事會之議事錄：請參閱第 113 頁。

20、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

21、信用評等：

(1)信用評等機構：中華信用評等股份有限公司

(2)信用評等日期：101.9.4

(3)信用評等結果：twAAA

22、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

23、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

24、債券形式：

本公司債為記名式，採無實體發行，由台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)登錄。

25、還本付息代理機構：

本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜及製作扣繳憑單，寄發予債權人，並依集保結算所提供之債權人名冊資料，辦理本息款

項劃撥作業。

26、通知方式：

有關本公司債應通知債權人之事項，由受託人依相關法令規定辦理。

(三) 本次計劃之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每股盈餘稀釋影響

1、本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行金額為新台幣 4,400,000 仟元，每張面額為新台幣壹仟萬元，按面額發行。本公司債採未委託證券承銷商對外公開承銷之方式，洽特定人認購，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2、本次發行公司債之必要性評估：

本次發行公司債之資金將用於購置晶圓十五廠之機器設備，以因應公司長期成長所需，故本次發行公司債應屬必要。

3、本次發行公司債之合理性評估：

本次公司債採固定利率發行，十年期利率 1.53%，由於目前國內長期利率水準尚屬低廉，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4、分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權籌資工具，前者有普通公司債、銀行借款及國內外轉換公司債等，後者如現金增資及發行美國存託憑證等。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目		有利因素	不利因素
債權	普通公司債	1. 可取得中、長期穩定之資金。 2. 借貸成本相對低廉。 3. 每股盈餘無被稀釋之顧慮。 4. 債息列為費用，具節稅效果。 5. 運用財務槓桿，提高股東權益。	1. 相較於股權籌資，將形成利息負擔。 2. 將使負債比率增加。
	銀行借款	1. 資金調度運用彈性較大。 2. 每股盈餘無被稀釋之顧慮。 3. 債息列為費用，具節稅效果。 4. 運用財務槓桿，提高股東權益。	1. 較不利於長期資金之取得 2. 相較於股權籌資，將形成利息負擔。 3. 將使負債比率增加。
	可轉換公司債	1. 因附有轉換權利，票面利率較公司債低。 2. 相較於股權籌資，可延緩或不造成每股盈餘及股權稀釋。	1. 轉換前將使負債比率增加。 2. 轉換後將稀釋每股盈餘及股權。
	現金增資	1. 無利息支出。 2. 無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1. 稀釋每股盈餘及股權。 2. 無節稅效果。

股 權	美國存託憑證(ADR)	1. 無利息支出。 2. 無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 3. 募資對象以國外法人為主，可免增資新股釋出，致國內流通股數膨脹，對股價產生不利影響。	1. 稀釋每股盈餘及股權。 2. 無節稅效果。 3. 發行成本較高，為達成規模經濟效益，募資額度不宜過低。
--------	-------------	---	---

(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘及股權稀釋。由於目前市場利率處於低點，故利息負擔尚屬合理，對每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：依票面金額十足發行。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

1、如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者

(1) 資金運用概算：

單位：新臺幣佰萬元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預 定 資 金 運 用 進 度							
			101 年度				102 年度			
			第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季
購置機器設備	101 年第四季	4,400	-	-	-	4,400	-	-	-	-

(2) 預計可增加之產銷量、值、毛利、營業淨利及資金回收年限(表列資料以計畫之預計可能產生效益年度起至預計可收回資金年限止)

單位：千片；新台幣億元

年 度	項 目	生 產 量	銷 售 量	銷 售 值	毛 利	營 業 淨 利
102	晶圓十五廠	10	10	11	5	3
103	晶圓十五廠	17	17	20	8	5
104	晶圓十五廠	17	17	20	8	5
105	晶圓十五廠	17	17	20	8	5
106	晶圓十五廠	17	17	20	8	5

預估資金回收年限：5 年

2、如為轉投資其他公司者

(1) 轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

(2) 如轉投資特許事業者，應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3、如為充實營運資金、償還債務者

(1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報(請)年度及未來一年度各月份之現金收支預測表

A. 債務逐年到期金額及償債計畫：不適用。

- B. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形：不適用。
- C. 目前營運資金狀況：不適用。
- D. 所需之資金額度及運用情形：不適用。
- E. 現金收支預測表：不適用。

(2)申報(請)年度及預計未來一年度應收帳款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因

- A. 應收帳款政策及應付帳款政策：不適用。
- B. 資本支出計畫：不適用。
- C. 財務槓桿及負債比率：不適用。
- D. 充實營運資金原因：不適用。

(3)增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成之情形：不適用。

(4)如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。

(5)如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、財務概況

一、財務分析

年 度 分析項目(註1)		最近五年度財務分析					當年度截至 民國 101 年 6 月 30 日 財務分析 (註3)
		民國 96 年	民國 97 年	民國 98 年	民國 99 年	民國 100 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	11.72	11.87	14.26	18.12	17.31	28.16
	長期資金占固定資產比率	213.63	219.72	196.27	157.73	142.52	128.85
償債能力 %	流動比率	397.94	338.70	256.07	162.88	144.79	99.83
	速動比率	348.53	312.83	228.94	140.07	122.41	85.22
	利息保障倍數	207.51	312.95	669.76	789.71	325.54	227.05
經營能力	應收款項週轉率(次)	8.82	11.08	11.17	10.93	10.40	9.86
	平均收現日數	41.40	32.93	32.66	33.40	35.09	37.01
	存貨週轉率(次)	8.78	10.86	10.06	9.44	9.61	9.51
	平均銷貨日數	41.57	33.59	36.29	38.67	37.97	38.38
	應付款項週轉率(次)	16.05	20.40	18.46	16.89	18.17	16.83
	固定資產週轉率(次)	1.34	1.47	1.12	1.11	0.92	0.90
	總資產週轉率(次)	0.57	0.60	0.49	0.58	0.55	0.53
獲	資產報酬率(%)	19.49	18.35	15.98	25.31	18.40	18.50

利 能 力	股東權益報酬率(%)	21.94	20.74	18.37	30.23	22.30	23.96
	占實收資本比率(%)	42.48	41.48	36.49	59.76	53.60	62.31
	營業利益						
	稅前純益	45.69	43.22	36.67	65.34	55.84	64.67
	純益率(%)	34.81	31.06	31.22	39.71	32.09	32.63
	基本每股盈餘(元)(註2)	4.04	3.84	3.45	6.24	5.18	2.90
現 金 流 量	稀釋每股盈餘(元)(註2)	4.04	3.81	3.44	6.23	5.18	2.90
	現金流量比率(%)	397.52	399.16	214.83	188.12	217.99	118.54
	現金流量允當比率(%)	139.35	134.79	122.02	109.98	99.13	93.71
槓 桿 度	現金再投資比率(%)	9.73	12.95	6.99	11.20	11.07	10.97
	營運槓桿度	2.23	2.50	2.46	2.17	2.54	2.38
	財務槓桿度	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20%者可免分析)

1. 利息保障倍數減少：主要係稅前利益減少及利息費用增加所致。
2. 資產報酬率減少：主要係稅後純益減少及平均資產總額增加所致。
3. 股東權益報酬率減少：主要係稅後純益減少及平均股東權益淨額增加所致。

註1：財務比率計算公式如下：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註2：按盈餘及資本公積轉增資比率(九十六年至九十七年盈餘年度)及員工紅利配股比率(至九十六年盈餘年度)追溯調整後之每股盈餘。

註3：相關分析項目若為期間損益業已推估為全年度損益後計算。

二、財務報表應記載事項

(一) 最近二年度經會計師查核簽證之財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表)

請參閱第66頁。

(二) 最近一年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表)

請參閱第92頁。

(三) 截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表

請參閱第84頁。

三、財務概況應記載事項

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第185條情事者：

截至公開說明書刊印日止無此情事。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一) 財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	民國100年	民國99年	增減金額	增減比率(%)
流動資產	158,563,352	192,234,282	(33,670,930)	-18%
固定資產	454,373,533	366,854,299	87,519,234	24%
其他資產	19,070,145	24,237,329	(5,167,184)	-21%
資產總額	761,407,874	701,239,666	60,168,208	9%
流動負債	109,514,430	118,022,260	(8,507,830)	-7%
長期負債	22,299,930	9,072,488	13,227,442	146%
負債總額	131,814,360	127,094,748	4,719,612	4%
股本	259,162,226	259,100,787	61,439	0%
資本公積	55,846,357	55,698,434	147,923	0%
保留盈餘	322,191,155	265,779,571	56,411,584	21%
股東權益總額	629,593,514	574,144,918	55,448,596	10%

■ 增減比例超過20%之變動分析：

固定資產增加：主要係先進製程設備相關之資本支出所致。

其他資產減少：主要係存出保證金收回及遞延借項減少所致。

長期負債增加：主要係一百年度發行公司債180億元所致。

保留盈餘增加：主要係一百年度淨利，部分因盈餘分配而抵銷。

■ 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

■ 未來因應計劃：不適用。

(二) 經營結果

單位：新台幣仟元

項目	民國100年	民國99年	增減金額	變動比例(%)
銷貨收入總額	421,472,087	418,666,448	2,805,639	1%
銷貨退回及折讓	(3,226,594)	(11,703,136)	8,476,542	-72%
銷貨收入淨額	418,245,493	406,963,312	11,282,181	3%
銷貨成本	233,083,068	209,921,268	23,161,800	11%
銷貨毛利	185,162,425	197,042,044	(11,879,619)	-6%
聯屬公司間已(未)實現銷貨	398,440	(52,742)	451,182	-855%
已實現銷貨毛利	185,560,865	196,989,302	(11,428,437)	-6%
營業費用	46,655,102	42,142,794	4,512,308	11%
營業利益	138,905,763	154,846,508	(15,940,745)	-10%
營業外收入及利益	7,287,046	15,907,968	(8,620,922)	-54%
營業外費用及損失	1,484,965	1,464,272	20,693	1%
稅前利益	144,707,844	169,290,204	(24,582,360)	-15%
所得稅費用	(10,506,565)	(7,685,195)	(2,821,370)	37%
本年度淨利	134,201,279	161,605,009	(27,403,730)	-17%

■ 增減比例超過20%的變動分析

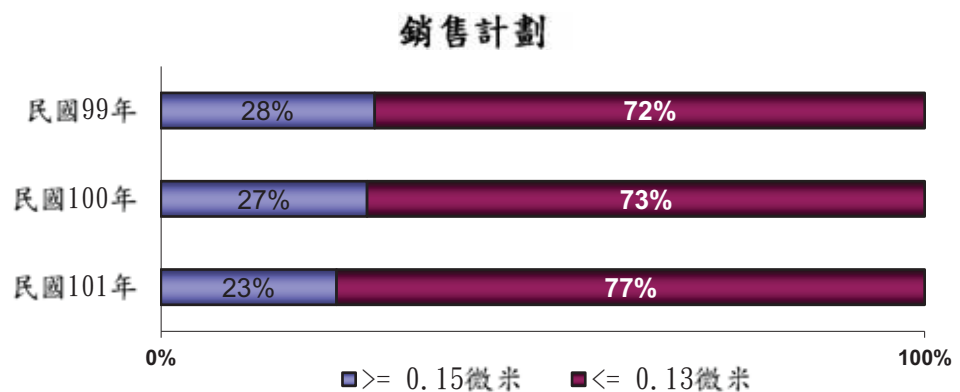
銷貨退回及折讓減少：主要係銷售獎勵減少及產品持續改善所致。

聯屬公司間已實現銷貨毛利增加：主要係一百年度第四季銷售予被投資公司之金額減少所致。

營業外收入及利益減少：主要係和解賠償收入及採權益法認列之投資淨益減少所致。

所得稅費用增加：主要係因10%未分配盈餘稅增加所致。

■ 預期未來一年銷售數量及其依據



民國101年晶圓銷售量預期約一千三百萬片約當八吋晶圓

(三) 現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (民國99年12月31日)	全年來自營業活動 淨現金流量(民國100年)	全年因投資及融資活動 淨現金流量(民國100年)	現金剩餘數額 (民國100年12月31日)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
109,511,130	238,734,696	(262,983,305)	85,262,521	-	-

■ 民國一百年度現金流量變動分析

營業活動之現金流入約 2,387 億；主要係因營業純益及加回無現金支出之折舊及攤銷。

投資活動之現金流出約 1,981 億；主要係用於資本支出。

理財活動之現金流出約 649 億；主要係發放現金股利，部分因發行公司債而抵銷。

■ 現金不足額的補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

■ 未來一年現金流動性分析：不適用。

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形及其資金來源

單位：新台幣仟元

計劃	實際或預計之資金來源	實際或預計之資金運用情形
		民國100年
生產及廠務設備	自有資金	196,936,605
研發設備	自有資金	15,909,970
其他	自有資金	1,115,946
合計	自有資金	213,962,521

預期可能產生效益

台積公司在民國一百年度之產能較前一年度增加約 190 萬片八吋晶圓約當量。

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃

本公司轉投資皆為長期策略性投資；本公司民國一百年度採權益法之轉投資獲利為新台幣 3,778,083 仟元（合併基礎之下為新台幣 897,611 仟元），低於民國九十九年獲利，主要因為全球景氣放緩與終端市場需求疲弱所帶來的影響。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃。

(六) 其他重要事項

■ 本公司持有備供出售金融資產之國外上市公司股票，於一〇一年上半年度因其公平價值大幅下跌，而認列減損損失 2,677,529 仟元。

■ 本公司於一〇一年八月五日加入荷蘭艾司摩爾公司（ASML）「客戶聯合投資專案」並簽訂股權投資協議，依據該協議將透過子公司 TSMC Global 投資 ASML 歐元 837,816 仟元取得該公司約 5% 普通股股權，該股權於未來兩年內受有轉讓限制，此協議尚待 ASML 臨時股東會決議及相關主管機關核准；同時雙方另簽訂研究發展投資協議，本公司將於一〇二年至一〇六年間陸續支付歐元 277,000 仟元參與 ASML 之研發計畫。

伍、特別記載事項

- 一、委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形

本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

- 二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告

請參照第108頁。

- 三、證券承銷商評估總結意見

不適用。

- 四、律師法律意見書

不適用。

- 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見

請參照第114頁。

- 六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項
無。

- 七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者

無。

- 八、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

本公司董事會由九位擁有豐富的世界級公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，其中五位為獨立董事，分別為：前英國電信公司執行長彼得·邦菲爵士、前宏基集團董事長施振榮先生、前德州儀器公司董事長湯馬斯·延吉布斯先生、普林斯頓大學教授鄒至莊先生，以及現為中華民國行政院政務顧問及台北市政府市政顧問陳國慈女士。台積公司獨立董事的人數已經超過全體董事席次二分之一。在張忠謀董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

依張董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，台積公司董事會已建立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核、內部檢舉系統等。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊做調整。

董事會的第三個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會運作情形資訊

張忠謀董事長於民國一百年共召開四次董事常會以及兩次臨時董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	張忠謀	6	0	100%	無
副董事長	曾繁城	6	0	100%	無
董事	行政院國家發展基金管理會代表人：李鍾熙	6	0	100%	無
董事	蔡力行	6	0	100%	無
獨立董事	彼得·邦菲爵士	4	2	67%	彼得·邦菲爵士於其中一次委託出席之臨時董事會亦經由電話參與會議討論。
獨立董事	施振榮	6	0	100%	無
獨立董事	湯馬斯·延吉布斯	4	2	67%	無
獨立董事	鄒至莊	2	0	100%	新任(100年6月9日增選)
獨立董事	陳國慈	2	0	100%	新任(100年6月9日增選)
其它應記載事項： 一、 證券交易法第十四條之三所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形：無 三、 加強董事會職能之目標：台積公司相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，本公司成立了審計委員會及薪酬委員會，以協助董事會執行其職責。					

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計

政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

至民國一〇一年六月底止，台積公司審計委員會由全體五位獨立董事組成並聘任一位財務專家。審計委員會組織章程請參考本公司網站。

審計委員會運作情形資訊

審計委員會主席邦菲爵士於民國一百年度共召開四次常會，審計委員會委員出席情形如下表。除上述常會外，審計委員會委員、顧問與管理階層另經由五次電話討論，審閱有關本公司依中華民國及美國法令規定編製之年報及法人說明會資料。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	彼得·邦菲爵士	4	0	100%	無
委員	施振榮	4	0	100%	無
委員	湯馬斯·延吉布斯	4	0	100%	無
委員	鄒至莊	2	0	100%	新任(註)
委員	陳國慈	2	0	100%	新任(註)
財務專家	羅貝茲	4	0	100%	無

其他應記載事項：

一、證券交易法第十四條之五所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）

說明：（一）本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國一百年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

（二）本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國一百年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

註：鄒至莊先生及陳國慈女士於民國一百零六年六月九日股東常會當選本公司增選之獨立董事，並成為審計委員會委員。

（三）薪酬委員會運作情形

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及

經理人之報酬。

至民國一〇一年六月底止，薪酬委員會由全體五位獨立董事組成，董事長張忠謀博士應被邀請列席參加所有會議，並於討論其薪酬時予以迴避。薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

薪酬委員會主席施振榮先生於民國一百年度共召開四次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	施振榮	4	100%	(註)
委員	彼得·邦菲爵士	4	100%	(註)
委員	湯馬斯·延吉布斯	4	100%	(註)
委員	鄒至莊	2	100%	新任(註)
委員	陳國慈	2	100%	新任(註)

註：台積公司於民國一百年八月九日的董事會中核准任命施振榮先生、彼得·邦菲爵士、湯馬斯·延吉布斯先生、鄒至莊先生及陳國慈女士五位獨立董事為薪酬委員會委員。其中鄒至莊先生及陳國慈女士為薪酬委員會之新任委員。

(四) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司責成包括企業訊息處、股務、法務等相關部門處理股東建議或糾紛等事宜。 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。 本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦法」中建立相關控管。	無
二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形	彼得・邦菲爵士、施振榮先生、湯馬斯・延吉布 斯先生、鄒至莊先生以及陳國慈女士等五位為本 公司獨立董事。 本公司由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立 性。	無
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司視不同狀況，責成包括企業訊息處、股務 等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有 發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。	無
四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司透過公司網站 (http://www.tsmc.com , 中 英文版) 隨時揭露相關資訊。 本公司美國存託憑證 (ADR) 在美國紐約證券交 易所 (NYSE) 掛牌交易，為外國發行人，須遵守 NYSE相關規定。其中，本公司須依據NYSE上市 準則，揭露本公司公司治理執行情形與美國國內	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	公司執行情形之重大差異，有關上述資訊之揭露請參考以下網址： http://www.tsmc.com/download/english/eo3_governance/NYSE_Section_303A.pdf 本公司責成企業訊息處、股務等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊。 本公司依規定設有發言人。 本公司法人說明會提供網路現場直播。	
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司設有審計委員會及薪酬委員會，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第49至65頁)。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，台積公司於民國九十年及民國九十二年先後於董事會下成立審計委員會及薪酬委員會。有關本公司公司治理運作情形，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第49至65頁)。	本公司設有審計委員會及薪酬委員會，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第49至65頁)。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應者關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）：	（一）員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「員工」說明（第61-64頁） （二）投資者關係、供應者關係、利害關係人之權利之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「企業社會責任」說明（第76-87頁） （三）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「風險管理」說明（第71-75頁）。 （四）客戶政策之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「客戶信任」說明（第59-60頁）。 （五）本公司已為董事及經理人購買責任保險。	七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應者關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）： （一）員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「員工」說明（第61-64頁） （二）投資者關係、供應者關係、利害關係人之權利之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「企業社會責任」說明（第76-87頁） （三）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「風險管理」說明（第71-75頁）。 （四）客戶政策之執行情形：請參閱本公司民國一百一十年年報「客戶信任」說明（第59-60頁）。 （五）本公司已為董事及經理人購買責任保險。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無	八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無 民國一百年，台積公司榮獲Corporate Governance Asia雜誌頒發「第一屆2011年亞洲卓越表揚大獎」及「2011年亞洲公司治理獎」，IR Global Rankings 頒發「大中華區公司治理大獎最佳獎」及「亞太區公司治理大獎最佳獎」，以及榮獲天下雜誌頒發「天下企業公民獎」及「台灣最佳聲望標竿企業」。	八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無 民國一百年，台積公司榮獲Corporate Governance Asia雜誌頒發「第一屆2011年亞洲卓越表揚大獎」及「2011年亞洲公司治理獎」，IR Global Rankings 頒發「大中華區公司治理大獎最佳獎」及「亞太區公司治理大獎最佳獎」，以及榮獲天下雜誌頒發「天下企業公民獎」及「台灣最佳聲望標竿企業」。

（五） 履行社會責任情形

台積公司認為，「企業社會責任」包含許多面向，在「道德、商業水準、經濟、法治、平衡生活、關懷地球與下一代、公益」這幾方面的實踐和進步，都是身為一個企業公民應負的重要責任與使命。若能在這些方面，落實一己之力，樹立安定社會的力量，促使更多人起而效尤，社會就能更加美好。

我們堅信，所謂「企業社會責任」就是成為促使社會向上提升的力量，以實現「共創永續發展、公平正義、安居樂業的社會」的社會願景。以下台積公司實踐企業社會責任的十項原則，是我們持續為社會帶來正向發展的重要圭臬：

1. 堅持誠信正直，對股東、員工、及社會大眾皆同。
2. 遵守法律、依法行事、絕不違法。
3. 反對貪腐，拒絕裙帶關係；不賄賂、也不追求政商關係。
4. 重視公司治理，力求在股東、員工及所有利益關係人之間，達到利益均衡。
5. 不參與政治。
6. 提供優質工作機會，包括良好的待遇、具有高度挑戰的工作內容，及舒適安全的工作環境，以照顧員工的身心需求。
7. 因應氣候變遷，重視並持續落實環境保護措施。
8. 強調並積極獎勵創新，並充分管控創新改革的可能風險。
9. 積極投資固態照明以及太陽能等綠能產業，為環保節能盡一份心力。
10. 長期關懷社區，並持續贊助教育及文化活動。

在企業的「道德」方面，台積公司堅持誠信正直，反對貪腐，不賄賂、不追求政商關係。在企業的「商業水準」方面，除堅守上述倫理的要件之外，台積公司堅持良好的公司治理，營運透明，信守對所有利益關係人的承諾；同時積極鼓勵創新，帶動產業的發展，促進產業的繁榮。

在企業的「經濟」責任方面，由於台積公司對公司治理的堅持，加上良好的公司營運，積極鼓勵創新，提供待遇優良的優質工作機會，並予以股東優質的投資回饋，為社會創造價值。在「法治」責任方面，我們除了遵守法律、反對貪腐之外，更以最高的倫理和商業道德標準自我檢視和要求。

在「平衡生活」方面，台積公司提供員工優質的待遇與優良的工作環境，重視員工工作與生活的平衡；我們倡導減少不必要的會議、改善作業流程，主管以身作則，員工工作效率提高、工時減少，提供員工一個平衡健康的工作環境。

在「關懷地球與下一代」方面，為提供下一代良好健康的生活環境，做好環境保護、珍惜地球資源，產業界的努力尤其重要，台積公司更是責無旁貸。台積公司新建的廠房及辦公大樓均符合綠建築標準，為綠色的社會著想，使用符合環保要求的設備，室內亦有許多節能措施。

在關懷下一代的同時，台積公司亦善盡「公益」方面的努力，由員工自發性的組成台積電志工社，從事多樣公益活動，包括為大眾導覽、為學子導讀，並有節能志工將公司節能的專長分享給其他學校機構，除了有利社會，此志願性的

服務亦能帶給員工生活的快樂與平衡；此外，公司亦成立有台積電文教基金會，積極投入公益，獎勵莘莘學子，贊助社區及文化活動。

台積電公司持續在以上各個面向的企業社會責任上加倍努力，以成為促使社會向上提升的力量之一。在為所有利益關係人創造價值的同時，我們堅守對環境永續發展的承諾，矢志成為全球產業界的模範，樹立標竿。過去，經由全體同仁兢兢業業的奮鬥，台積電公司在公司治理、營運、投資人關係、員工福利、環保績效等各方面，獲得多項肯定；展望未來，台積電公司將更加深耕並落實上述企業社會責任的原則，為公司所有關係人開創多贏，為社會創造更美好的將來。

履行社會責任情形

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。	請參考以上所述。	無
(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。	本公司遵循董事長訂定之企業社會責任十大原則，各單位將企業社會責任的觀念融入各自負責之日常運作中，與利害關係人之溝通藉由個別管道定期或不定期收集其關切議題，各單位再將此些議題評估分析後，將重要議題納入執行計畫及日常運作中。	
(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	台積公司從業道德規範要求台積公司所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉本規範為核心價值。公司之經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範；公司之經理人特別是執行長、財務長及法務長，在董事會之監督下，負責在向主管機關及投資大眾揭露之財務報表中，完整、公允、準確、及時且清楚地表達揭露公司財務會計資訊。公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範及相關辦法之規定。 同仁當發現或合理懷疑有任何違反本規範之情形時，必須立即根據違反情形向以下之人員或管道提出報告：直屬主管、人力資源最高主管、員工申訴直通車、或審計委員會之主席。台積公司針對任何違反本規範之同仁，將根據公司獎懲辦法予以處分，包括解僱處分。	

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。	台積公司新廠區的製程用水回收率皆達85%以上，符合或優於科學工業園區管理局所訂定的標準，亦優於國際間半導體廠製程用水回收率。此外，台積公司對於削減非製程用水也不遺餘力，例如減少空調用水、衛生設施使用回收水、管控外牆清洗與景觀澆灌用水與節約廚房用水等。我們亦使用公司內部網站系統，量測與收集全公司之水回收與重複使用量（如製程水回收）。 台積公司成立專責單位統籌管理廢棄物。為了達到資源永續利用，台積公司對於廢棄物的管理，首重製程減廢，其次考量委外再利用或處理。為確實掌握廢棄物的流向，台積公司慎選廢棄物清除處理及再利用廠商，並且訂有年度稽核計劃，確認其證照文件、現場操作情形與行車路徑動向，確保所有廢棄物均經合法妥善處理或再利用，避免造成二次環境污染。民國一百零一年度，台積公司之廢棄物回收率為 91.85%，已達成 90%的目標，同時，衛生掩埋的比例亦降低至 1%以下。 台積公司各晶圓廠均設置空氣及水污染防治設備，並符合法排放標準。此外，各種污染防治設備亦擁有緊急電源在內的備援設計，以確保萬一運轉中發生部分設備故障時，仍可由備援系統作為替代，降低污染物異常排放的風險。台積公司也將所有水污染防治、空氣污染防治設備的運轉狀況，納入中央監控系統，由每日二十四小時的輪值人員監控，並將系統效率檢知資訊列入重點追蹤項目，以確保空氣及廢水的排放品質。 台積公司與台灣半導體產業協會、行政院環境保護署與世界半導體協會已共同簽署備忘錄，主動制訂企業全氟化物排放減量政策及執行計劃，並於民國九十九年時，達到將全氟化物排放總量降至民國八十六年及八十八年平均值之 90%以下之目標。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	請見以上說明。 台積公司為減少氣候變遷所致之風險，除了持續積極進行節約能源措施、進行自願性溫室氣體全氟化物排放減量計劃，以及每年進行溫室氣體盤查與驗證。自民國九十四年起參與非營利組織碳揭露計劃(Carbon Disclosure Project, CDP)的評比，每年揭露氣候變遷相關訊息，包含全公司之溫室氣體排放與減量資訊。 對於新建廠房及辦公室建築物設計，台積公司採用台灣「綠建築標準」及美國「節能環保設計標準」(LEED)，較傳統之設計將更為節省能源資源。同時，台積公司自民國九十七年開始逐年改善現有之辦公室建築物，以符合美國 LEED 標準。	
三、維護社會公益		無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(一) 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。	台積公司除遵守相關勞動法規與保障員工合法權益之外，為維持順暢的雙向溝通管理與交流，台積公司定期舉辦跨階層會議、各層級主管溝通會、員工滿意度調查，以及雙週發行工作與生活資訊兼具的電子晶圓雜誌。亦提供公司內部公正並暢通之員工申訴機制與員工意見反映管道，以傾聽與解決員工的各項意見與想法，包含： ■ 針對重大管理、財務、稽核等各項問題之機密申訴管道如下： (1) 由董事會下所設之具獨立性之審計委員會。 (2) 由一名副總經理親自負責之「員工申訴直通車」。 ■ 針對工作與環境一般性意見：員工關係部負責之員工意見反映管道。 ■ 針對個人工作與生活上之相關議題：電話服務中心與廠區關懷小組。	
(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。	台積公司依據作業現場特性，進行工作環境之改善，以提供安全舒適的工作環境。針對危害作業場所，教導並要求員工必須使用個人防護具，以期將暴露的危害減低至可接受的範圍。我們透過持續改善安全衛生管理系统與教育訓練，達成預防意外事故、促進員工安全、衛生及保護公司資產的目標。 同仁的身心健康是台積公司生產力的基石，我們持續透過多元的健康照護方案、舉辦健康促進相關活動以及推展員工協助方案，打造健康的職場環境。台積公司每年針對特殊及一般作業在職同仁舉辦到廠健檢服務，健檢項目與頻率皆優於法規要求。此外，也透過心理衛生講座、員工協助方案、心理諮商等各種健康促進活動與方案，整合多元管道與專業資源，積極強化同仁心理素質並提供相關協助。	

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三) 公司制定並公開其消費政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (四) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。	台積公司定期舉辦年度客戶滿意度調查，以確保客戶的需求得到了解與妥善照應，並達成高滿意度的服務。此滿意度調查係由中立第三者顧問公司透過網路或訪談來進行，台積公司針對客戶的意見提出改善計劃，並制訂有效的回報系統。 台積公司集合晶圓廠、資材管理、風險管理，以及品質系統管理等單位組成內部的委員會，致力於供應鏈管理。而委員會的主要任務為降低供應鏈風險及改善供應鏈。委員會包含一位資深副總及多位主管，訂定年度計劃及每季查核執行進度，並設置工作小組，與供應商分享風險管理的案例，協助供應商改善和提升品質系統、綠色採購、環境保護和工廠安全，同時，我們定期與供應商溝通，或經由公開的資訊，持續不斷地監控主要供應商的財務狀況及整體供應鏈的庫存變化，並備妥應變方案以降低風險。工作小組每個月定期開會追蹤各專案的進度，並積極解決供應商的問題。其他詳細內容請參考本公司網站企業社會責任相關資訊。	
(五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	台積電文教基金會持續投入資源，開啟「高中物理實驗學程」、更新國立自然科學博物館「半導體的世界」展館，及開創「台積科學之旅」等多項專案，以推動科普知識，鞏固科學教育基礎。除教育文化紮根的耕耘不輟，台積電文教基金會亦持續支持「台積志工社」，號召台積同仁以實際行動關懷社區弱勢，擴大企業對社會的關懷。	
四、加強資訊揭露 (一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	台積公司自民國九十七年起每年均發行「企業社會責任報告」，同時亦取得第三者驗證，符合 GRI G3.1 A+ 及 AA1000AS:2008 標準要求。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司未訂定企業社會責任守則，有關本公司企業社會責任運作情形，請參閱本公司年報及網站企業社會責任相關資訊，網址： http://www.tsmc.com/chinese/csr/index.htm		
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：請參考本公司網站企業社會責任相關資訊，網址： http://www.tsmc.com/chinese/csr/index.htm		
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： (一) 台積公司取得積體電路產品碳足跡驗證以及第三類環保產品標章，符合 PAS2050 與 ISO14025 標準。 (二) 台積公司「企業社會責任報告」符合 GRI G3.1 A+及 AA1000AS:2008 標準要求。		

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施

1. 道德價值

誠信正直一直是台積電公司文化最重要之核心價值。台積電公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，並隨時自我警惕，以誠信、正直、準確且透明的精神，實踐我們所說及所從事之作為。

維護台積電公司之道德價值及名譽，並遵守法令規定，是台積電公司每一份子的重要責任。因此，台積電公司從業道德規範（以下稱「本規範」）要求台積電公司及其子公司每一個員工必須做到：避免造成因個人利益而犧牲公司利益或與公司利益有所衝突；迴避任何賄賂、不公平競爭、舞弊、浪費及任何濫用公司資源情形；不得從事任何不利於公司、環境及社會的行為；遵守所有法令之立法精神及規範；避免任何不當影響任何人決定之行為，任何人包括政府官員、機構、法院、客戶、供應商及承包商。

為了持續建立一個創新環境、技術領先以及維持獲利成長，本規範要求我們應致力於倡導在一個絕對尊重台積電公司及客戶等之智慧財產權、機密資訊以及營業秘密的基礎上，建立業務關係，並適當使用公司資產，不移作個人用途，以達成公司未來幾年的願景。

台積電公司所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉及實踐本規範，公司之經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範。在董事會之監督下，公司之經理人特別是執行長、財務長及法務長，應負責本公司向證券主管機關申報及所有公開對外溝通及揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、及時且可了解的。

2. 從業行為管理及懲處

公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範及相關辦法之規定。台積電公司期待我們的客戶、供應商、承包商、顧問及其他與本公司有契約關係者了解並尊重台積電的道德標準及文化。

台積電公司從業道德規範的遵循計劃，除了要求所有員工必須自行申報有利益衝突等從業道德疑慮之事項，重要同仁及資深主管必須定期申報是否遵守本規範。另外，為鼓勵公開透明之從業道德文化，我們同時訂定有「台積電公司從業道德規範的遵循計劃」，除了要求所有員工必須自行申報有利益衝突等從業道德疑慮之事項，重要同仁及資深主管必須定期申報是否遵守本規範。另外，為鼓勵以及「台積電公司從業道德規範的遵循計劃」，除了要求所有員工必須自行申報有利益衝突，提供員工及告發者檢具相關證據舉報任何財務、法律、不正當的從業行為之管道。當同仁發現或合理懷疑有任何違反本規範之情形時，必須立即根據違反情形向以下之人員報告：直屬主管、人力資源最高主管、負責員工申訴直通車之副總、或審計委員會之主席。

為提倡並宣導從業道德行為，台積電公司除將相關規範公佈在公司內部網站供同仁隨時查詢，同時對每位同仁均進行公司核心價值及遵循制度之宣導。為防止貪瀆、保護智慧財產權及其他有關從業道德行為之重要主題，公司亦視需求定期提供所有同仁現場及線上相關教育訓練課程。公司內部網站刊登與誠信和從業道德行為等相關之指導原則和文章。台積電公司亦要求利害關係人，如供應商、承包商或其他合作者遵守與台積電經理人及同仁相同之道德標準，例如要求供應商、承包商或其他合作者提供其不會從事任何

違法之商業行為，及不會向台積同仁提供不當利益或賄賂等之書面承諾；同時在公司網站上設置違反從業道德舉報系統，任何相關人員可以利用此系統舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理。

公司之內部稽核部門亦隨時稽核公司、承包商、供應商、客戶是否遵守相關法令及規定。

台積公司決不允許任何違反從業道德相關規範之行為，簡而言之，任何員工經理人或員工，不論其年資，任何違反我們的從業道德標準的行為，將根據公司獎懲辦法受到嚴厲懲處，包括解僱處分，若有違反法律情形，亦會採取法律行動。例如去年公司針對不當使用公司之智慧財產及貪瀆等違反從業行為，對已離職員工提出二件法律訴訟。此外，台積公司亦因違反機密資訊保護 (Proprietary Information Protection, PIP) 政策及其他從業道德相關規範，於民國一百年解僱員工九位。

(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式

本公司未訂定公司治理實務守則，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本說明書「公司治理」說明（第 49 至 65 頁）。

(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總

無。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊

無。

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 二 月 十 四 日

		民國一〇〇年一月三十一日												單位：新台幣千元，除 特別註明外	
		一〇〇	九九	九八	九七	九六	九五	九四	九三	九二	九一	九〇	八九		
項次	會計科目	金額												項次	會計科目
		一〇〇	九九	九八	九七	九六	九五	九四	九三	九二	九一	九〇	八九		
1100	流动资产	8,201,407,423	7,111,130	15										1100	流动资产
1110	现金及现金等价物	14,025	3,016,274											1110	现金及现金等价物
1120	短期证券投资	2,417,134												1120	短期证券投资
1130	应收票据	793,136	4,296,269											1130	应收票据
1140	应收账款	28,777,534	25,753,974											1140	应收账款
1150	其他应收款	19,000,000	22,500,000											1150	其他应收款
1160	预付账款	405,120	400,000											1160	预付账款
1170	其他流动资产	4,007,679	2,341,444											1170	其他流动资产
1180	流动资产合计	1,061,026	1,302,201											1180	流动资产合计
1200	非流动资产	22,453,507	20,686,348											1200	非流动资产
1210	长期股权投资	3,779,544	3,133,275											1210	长期股权投资
1220	固定资产	1,292,226	1,253,444											1220	固定资产
1230	无形资产	139,553,000	137,214,202											1230	无形资产
1240	其他非流动资产	128,200,718	114,977,474											1240	其他非流动资产
1250	非流动资产合计	702,291	1,433,697											1250	非流动资产合计
1300	资产总计	128,803,644	117,213,726											1300	资产总计
1400	负债	184,495,478	182,713,902											1400	负债
1410	短期借款	1,149,564,528	1,149,564,528											1410	短期借款
1420	应付账款	1,064,762,797	796,655,443											1420	应付账款
1430	其他应付款	1,020,000,000	800,000,000											1430	其他应付款
1440	长期借款	1,000,000,000	1,000,000,000											1440	长期借款
1450	其他非流动负债	1,000,000,000	1,000,000,000											1450	其他非流动负债
1460	负债合计	1,000,000,000	1,000,000,000											1460	负债合计
1500	所有者权益	128,803,644	117,213,726											1500	所有者权益
1510	股本	128,803,644	117,213,726											1510	股本
1520	资本公积	128,803,644	117,213,726											1520	资本公积
1530	盈余公积	128,803,644	117,213,726											1530	盈余公积
1540	未分配利润	128,803,644	117,213,726											1540	未分配利润
1550	所有者权益合计	128,803,644	117,213,726											1550	所有者权益合计

董事長：張為雄



經理人：何麗梅



後附之附註係本財務報表之一部分。

會計主管：周淑芬



台灣積體電路股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年度	九十九年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入總額（附註二及二五）	\$ 421,472,087	\$ 418,666,448
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）	<u>3,226,594</u>	<u>11,703,136</u>
4100 銷貨收入淨額	418,245,493 100	406,963,312 100
5110 銷貨成本（附註九、十九及二五）	<u>233,083,068</u> 56	<u>209,921,268</u> 52
5910 銷貨毛利	185,162,425 44	197,042,044 48
5930 聯屬公司間已（未）實現銷貨毛利（附註二）	<u>398,440</u> -	(<u>52,742</u>) -
已實現銷貨毛利	<u>185,560,865</u> 44	<u>196,989,302</u> 48
營業費用（附註十九及二五）		
6300 研究發展費用	31,594,034 7	27,623,299 7
6200 管理費用	12,715,339 3	11,681,756 3
6100 行銷費用	<u>2,345,729</u> 1	<u>2,837,739</u> -
6000 合計	<u>46,655,102</u> 11	<u>42,142,794</u> 10
6900 營業利益	<u>138,905,763</u> 33	<u>154,846,508</u> 38
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及十）	3,778,083 1	7,111,443 2
7480 和解賠償收入（附註二八）	947,340 1	6,939,764 2

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一 〇 〇 年 度		九 十 九 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7310	金融商品評價淨益(附註二、五及二四)	\$ 801,195	-	\$ 312,862	-
7110	利息收入	697,196	-	764,027	-
7480	技術服務收入(附註二五)	408,153	-	446,746	-
7480	其他收入(附註二及二五)	655,079	-	333,126	-
7100	合 計	<u>7,287,046</u>	<u>2</u>	<u>15,907,968</u>	<u>4</u>
營業外費用及損失					
7560	兌換淨損(附註二)	673,085	-	58,737	-
7510	利息費用(附註二五)	445,887	-	214,641	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	202,901	-	838,750	-
7880	災害損失(附註九)	-	-	190,992	-
7880	其他損失	163,092	-	161,152	-
7500	合 計	<u>1,484,965</u>	<u>-</u>	<u>1,464,272</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	144,707,844	35	169,290,204	42
8110	所得稅費用(附註二及十八)	<u>10,506,565</u>	<u>3</u>	<u>7,685,195</u>	<u>2</u>
9600	本年度淨利	<u>\$ 134,201,279</u>	<u>32</u>	<u>\$ 161,605,009</u>	<u>40</u>
每股盈餘(附註二三)					
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.58</u>	<u>\$ 5.18</u>	<u>\$ 6.53</u>	<u>\$ 6.24</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.58</u>	<u>\$ 5.18</u>	<u>\$ 6.53</u>	<u>\$ 6.23</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



台灣積體電路製造股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

	普 通 股	發 行 股 本		保	留	盈	餘	股 東 權	益	其 他	項 目	
	股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計	
九十九年一月一日餘額	25,902,706	\$259,027,066	\$ 55,486,010	\$ 77,317,710	\$ -	\$104,564,972	\$181,882,682	(\$ 1,766,667)	\$ 453,621	\$ -	\$495,082,712	
盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-	-	-	-	
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	-	-	-	(77,708,120)	
九十九年度淨利	-	-	-	-	-	161,605,009	161,605,009	-	-	-	161,605,009	
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	(17,885)	-	-	-	-	-	-	-	(17,885)	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(4,776,496)	-	-	(4,776,496)	
員工行使認股權發行新股	7,372	73,721	171,103	-	-	-	-	-	-	-	244,824	
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(441,978)	-	(441,978)	
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	59,206	-	-	-	-	-	97,646	-	156,852	
九十九年十二月三十一日餘額	25,910,078	259,100,787	55,698,434	86,239,494	1,313,047	178,227,030	265,779,571	(6,543,163)	109,289	-	574,144,918	
盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-	-	-	-	
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	-	-	-	(77,730,236)	
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	134,201,279	134,201,279	-	-	-	134,201,279	
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	59,898	-	-	-	-	-	-	-	59,898	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(112,326)	-	-	(112,326)	
員工行使認股權發行新股	7,144	71,439	146,258	-	-	-	-	-	-	-	217,697	
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,112,995)	-	(1,112,995)	
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(165,851)	-	(165,851)	
庫藏股票買回—股東執行股份收買請求權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,598)	(71,598)	
庫藏股票註銷	(1,000)	(10,000)	(2,139)	-	-	(59,459)	(59,459)	-	-	71,598	-	
分割事業影響數	-	-	(56,094)	-	-	-	-	222,120	(3,298)	-	162,728	
一〇〇年十二月三十一日餘額	25,916,222	\$259,162,226	\$ 55,846,357	\$102,399,995	\$ 6,433,874	\$213,357,286	\$322,191,155	(\$ 6,433,369)	(\$ 1,172,855)	\$ -	\$629,593,514	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$134,201,279	\$161,605,009
調整項目		
折舊及攤銷	102,925,423	83,366,121
聯屬公司間未（已）實現銷貨毛利	(398,440)	52,742
金融資產折溢價攤銷數	9,860	18,611
處分備供出售金融資產淨益	(35,151)	-
處分以成本衡量之金融資產損失	-	1,263
採權益法認列之投資淨益	(3,778,083)	(7,111,443)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,941,548	422,490
處分固定資產及其他資產淨損	99,884	761,298
獲配股票作價賠償收入	-	(4,434,364)
遞延所得稅	(493,026)	(373,253)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(22,759)	189,577
應收關係人款項	956,440	(3,192,201)
應收票據及帳款	2,356,519	(2,366,385)
備抵呆帳	(2,880)	57,000
備抵退貨及折讓	(2,453,565)	(1,242,188)
其他應收關係人款項	(38,049)	85,830
其他金融資產	138,196	904,157
存貨	2,775,646	(6,816,132)
預付費用及其他流動資產	(382,852)	(445,797)
應付帳款	(1,805,422)	624,608
應付關係人款項	418,132	535,108
應付所得稅	3,538,928	(1,652,251)
應付員工紅利及董事酬勞	(1,903,765)	4,188,131
應付費用及其他流動負債	(410,047)	(3,124,307)
應計退休金負債	96,880	17,425
遞延貨項	-	(47,873)
營業活動之淨現金流入	<u>238,734,696</u>	<u>222,023,176</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
投資活動之現金流量：		
分割事業現金支付數	(\$ 1,270,340)	\$ -
購置固定資產	(202,757,541)	(182,335,032)
採權益法之長期股權投資增加	(7,390,883)	(8,262,519)
購買以成本衡量之金融資產	-	(480)
處分備供出售金融資產價款	1,035,151	-
持有至到期日金融資產領回	4,789,000	15,943,000
處分以成本衡量之金融資產價款	-	3,370
被投資公司減資退回股款	320,013	-
處分固定資產及其他資產價款	4,650,078	387,735
遞延借項增加	(1,658,296)	(1,538,301)
存出保證金減少(增加)	4,147,014	(5,940,633)
其他資產減少(增加)	27,600	(1,004,581)
投資活動之淨現金流出	(198,108,204)	(182,747,441)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(4,982,109)	30,908,637
發行公司債	18,000,000	-
存入保證金減少	(308,855)	(253,489)
員工行使認股權發行新股	217,697	244,824
買回庫藏股票	(71,598)	-
發放現金股利	(77,730,236)	(77,708,120)
融資活動之淨現金流出	(64,875,101)	(46,808,148)
現金及約當現金淨減少數	(24,248,609)	(7,532,413)
年初現金及約當現金餘額	109,511,130	117,043,543
年底現金及約當現金餘額	\$ 85,262,521	\$109,511,130
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 369,085	\$ 200,892
支付所得稅	\$ 7,454,386	\$ 9,640,396
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$195,932,728	\$195,950,918
應付工程及設備款減少(增加)	6,827,106	(13,491,140)
換出資產抵減價款	(2,293)	(124,746)
支付現金金額	\$202,757,541	\$182,335,032

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
處分固定資產及其他資產價款	\$ 3,370,165	\$ 1,872,880
其他應收關係人款項減少(增加)	1,124,206	(1,142,108)
其他金融資產款項減少(增加)	158,000	(218,291)
換出資產抵減價款	(2,293)	(124,746)
取得現金金額	<u>\$ 4,650,078</u>	<u>\$ 387,735</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ 4,500,000	\$ -
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	\$ -	\$ 718,637

分割事業之補充揭露資訊

本公司於一〇〇年八月將固態照明事業及太陽能事業之相關營業分別分割轉讓與新設且持股 100%之台積固態照明股份有限公司(台積固態照明公司)及台積太陽能股份有限公司(台積太陽能公司)，分割之相關資訊如下：

	台積固態照明公司	台積太陽能公司	合計
取得對該公司長期股權投資	<u>\$ 2,270,000</u>	<u>\$ 11,180,000</u>	<u>\$ 13,450,000</u>
分割轉讓之非現金項目			
流動資產	36,050	18,807	54,857
長期投資	2,872	7,912,710	7,915,582
固定資產	1,929,563	2,372,214	4,301,777
其他資產	234,696	201,677	436,373
流動負債	(292,728)	(337,439)	(630,167)
其他負債	(36,272)	(25,218)	(61,490)
資本公積	-	(56,094)	(56,094)
金融商品未實現損益	-	(3,298)	(3,298)
累積換算調整數	256	221,864	222,120
	<u>(1,874,437)</u>	<u>(10,305,223)</u>	<u>(12,179,660)</u>
支付分割事業現金數	<u>\$ 395,563</u>	<u>\$ 874,777</u>	<u>\$ 1,270,340</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則，商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣積體電路製造股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師分別出具標準式無保留意見之查核報告及附說明段說明採用新修訂存貨會計處理準則之修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



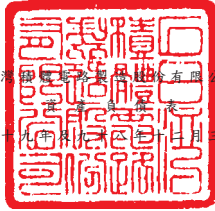
黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 二 十 四 日



台灣聯合會計師事務所

董事長 林文郎

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1310	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 109,511,130	15	\$ 117,043,543	20	2180	短期借款（附註十四）	\$ 30,908,637	4	\$ -	-
	公平價值變動列入損益之金融資產（附註二、五及二三）	-	-	181,743	-		公平價值變動列入損益之金融負債（附註二、五及二三）	7,834	-	-	-
1320	備供出售金融資產（附註二、六及二三）	3,918,274	-	-	-	2140	應付帳款	10,559,283	2	9,678,849	2
1330	持有至到期日金融資產（附註二、七及二三）	4,796,589	1	9,944,843	2	2150	應付關係人款項（附註二四）	2,574,450	-	2,039,342	-
1150	應收關係人款項（附註二四）	25,733,974	4	22,541,773	4	2160	應付所得稅（附註二及十八）	7,108,869	1	8,761,120	2
1143	應收票據及帳款	22,250,905	3	19,884,520	3	2171	應付薪資及獎金	5,287,751	1	8,677,299	1
1149	備抵呆帳（附註二及八）	(488,000)	-	(431,000)	-	2219	應付員工紅利及董事酬勞（附註二及二十）	10,959,469	2	6,771,338	1
1148	備抵退貨及折讓（附註二及八）	(7,341,444)	(1)	(8,583,632)	(1)	2224	應付工程及設備款	41,992,198	6	28,756,884	5
1180	其他應收關係人款項（附註二四）	1,302,281	-	246,003	-	2170	應付費用及其他流動負債（附註十六及二三）	8,623,769	1	7,886,263	1
1190	其他金融資產（附註二五）	418,206	-	1,104,072	-	21XX	流動負債合計	118,022,260	17	72,571,095	12
1210	存貨（附註二、三及九）	25,646,348	4	18,830,216	3		長期負債				
1286	遞延所得稅資產（附註二及十八）	5,133,775	1	4,063,410	1	2410	應付公司債（附註十五及二三）	4,500,000	-	4,500,000	1
1298	預付費用及其他流動資產	1,352,244	-	1,006,046	-	2440	其他長期應付款（附註十六及二三）	-	-	416,390	-
11XX	流動資產合計	192,234,282	27	185,831,537	32	24XX	長期負債合計	4,500,000	-	4,916,390	1
	長期投資（附註二、六、七、十、十一及二三）						其他負債				
1421	採權益法之長期股權投資	114,977,174	17	104,660,098	18	2810	應計退休金負債（附註二及十七）	3,824,601	1	3,807,176	1
1450	備供出售金融資產	1,033,049	-	1,046,672	1	2820	存入保證金（附註二七）	747,887	-	1,001,376	-
1460	持有至到期日金融資產	1,405,698	-	12,219,055	2	2881	遞延費項（附註二及二四）	-	-	47,873	-
1480	以成本衡量之金融資產	497,835	-	501,988	-	28XX	其他負債合計	4,572,488	1	4,856,425	1
14XX	長期投資合計	117,913,756	17	118,427,813	21	2XXX	負債合計	127,094,748	18	82,343,910	14
	固定資產（附註二、十二及二四）						股本（附註二十）				
	成 本					3110	普通股股本—每股面額10元				
1521	建築物	128,646,942	18	124,522,047	22		額定—28,050,000 仟股				
1531	機器設備	852,733,592	122	713,426,126	123		發行—一九九九年 25,910,078 仟股				
1561	辦公設備	11,730,537	2	10,781,099	2		九十八年 25,902,706 仟股	259,100,787	37	259,027,066	45
15X1		993,111,071	142	848,729,272	147	32XX	資本公積（附註二及二十）	55,698,434	8	55,486,010	10
15X9	累積折舊	(706,605,445)	(101)	(627,764,323)	(109)		保留盈餘（附註二十）				
1670	預付款項及未完工程	80,348,673	11	33,786,577	6	3310	法定盈餘公積	86,239,494	12	77,317,710	13
15XX	固定資產合計	366,854,299	52	254,751,526	44	3320	特別盈餘公積	1,313,047	-	-	-
	無形資產					3350	未分配盈餘	178,227,030	26	104,564,972	18
1760	商譽（附註二）	1,567,756	-	1,567,756	-	33XX	保留盈餘合計	265,779,571	38	181,882,682	31
1780	遞延借項—淨額（附註二及十三）	5,456,427	1	5,891,685	1		股東權益其他項目（附註二及二三）				
17XX	無形資產合計	7,024,183	1	7,459,441	1	3420	累積換算調整數	(6,543,163)	(1)	(1,766,667)	-
	其他資產					3450	金融商品未實現利益	109,289	-	453,621	-
1860	遞延所得稅資產（附註二及十八）	7,154,266	1	7,763,643	1	34XX	股東權益其他項目合計	(6,433,874)	(1)	(1,313,046)	-
1820	存出保證金	8,638,749	2	2,698,116	1	3XXX	股東權益合計	574,144,918	82	495,082,712	86
1880	其他（附註二及二四）	1,420,131	-	494,546	-		負債及股東權益總計	\$ 701,239,666	100	\$ 577,426,622	100
18XX	其他資產合計	17,213,146	3	10,956,305	2						
1XXX	資 產 總 計	\$ 701,239,666	100	\$ 577,426,622	100						

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告）

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣精體股份有限公司

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
	金 額 %	金 額 %
4110 銷貨收入總額（附註二及二四）	\$ 418,666,448	\$ 299,471,214
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）	11,703,136	13,728,346
4100 銷貨收入淨額	406,963,312 100	285,742,868 100
5110 銷貨成本（附註三、九、十九及二四）	209,921,268 52	159,106,619 56
5910 銷貨毛利	197,042,044 48	126,636,249 44
5920 聯屬公司間未實現銷貨毛利（附註二）	52,742 -	160,279 -
已實現銷貨毛利	196,989,302 48	126,475,970 44
營業費用（附註十九及二四）		
6300 研究發展費用	27,623,299 7	19,688,032 7
6200 管理費用	11,681,756 3	10,238,131 3
6100 行銷費用	2,837,739 -	2,027,454 1
6000 合 計	42,142,794 10	31,953,617 11
6900 營業利益	154,846,508 38	94,522,353 33
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及十）	7,111,443 2	- -
7480 和解賠償收入（附註二七）	6,939,764 2	1,464,915 1
7110 利息收入	764,027 -	1,117,374 -
7480 技術服務收入（附註二四及二七）	446,746 -	375,118 -

（接次頁）

(承前頁)

		九	十	九	年	度	九	十	八	年	度	
代 碼		金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額
7310	金融商品評價淨益（附註二、五及二三）	\$	312,862	-	\$	587,151	-					
7480	其他收入（附註二及二四）		333,126	-		576,951	-					
7100	合 計		15,907,968	4		4,121,509	1					
營業外費用及損失												
7530	處分固定資產損失（附註二）		838,750	-		58,242	-					
7510	利息費用		214,641	-		142,026	-					
7880	災害損失（附註九）		190,992	-		-	-					
7560	兌換淨損（附註二）		58,737	-		630,455	-					
7521	採權益法認列之投資淨損（附註二及十）		-	-		2,695,720	1					
7880	其他損失（附註二）		161,152	-		136,397	-					
7500	合 計		1,464,272	-		3,662,840	1					
7900	稅前利益		169,290,204	42		94,981,022	33					
8110	所得稅費用（附註二及十八）		7,685,195	2		5,763,186	2					
9600	本年度淨利		161,605,009	40		89,217,836	31					
每股盈餘（附註二二）												
9750	基本每股盈餘	\$	6.53	\$	6.24	\$	3.68	\$	3.45			
9850	稀釋每股盈餘	\$	6.53	\$	6.23	\$	3.67	\$	3.44			

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣群英證券股份有限公司

股票權益變動表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

	普 通 股 發 行 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘		未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	股 東 權 益		其 他 項 目	
	股 數 (仟 股)	金 額		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積			累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 未 實 現 損 益	股 東 權 益 合 計	
九十八年一月一日餘額	25,625,437	\$ 256,254,373	\$ 49,875,255	\$ 67,324,393	\$ 391,857	\$ 102,337,417	\$ 170,053,667	\$ 481,158	(\$ 287,342)	\$ 476,377,111	
盈餘分配											
法定盈餘公積	-	-	-	9,993,317	-	(9,993,317)	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(391,857)	391,857	-	-	-	-	
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(76,876,312)	(76,876,312)	-	-	(76,876,312)	
股票股利—每股 0.02 元	51,251	512,509	-	-	-	(512,509)	(512,509)	-	-	-	
員工股票紅利	141,870	1,418,699	6,076,289	-	-	-	-	-	-	7,494,988	
資本公積撥充資本	76,876	768,763	(768,763)	-	-	-	-	-	-	-	
九十八年度淨利	-	-	-	-	-	89,217,836	89,217,836	-	-	89,217,836	
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	115,418	-	-	-	-	-	-	115,418	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(2,247,825)	-	(2,247,825)	
員工行使認股權發行新股	7,272	72,722	187,811	-	-	-	-	-	-	260,533	
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	14,014	14,014	
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	726,949	726,949	
九十八年十二月三十一日餘額	25,902,706	259,027,066	55,486,010	77,317,710	-	104,564,972	181,882,682	(1,766,667)	453,621	495,082,712	
盈餘分配											
法定盈餘公積	-	-	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-	-	-	
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	-	-	(77,708,120)	
九十九年度淨利	-	-	-	-	-	161,605,009	161,605,009	-	-	161,605,009	
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	(17,885)	-	-	-	-	-	-	(17,885)	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(4,776,496)	-	(4,776,496)	
員工行使認股權發行新股	7,372	73,721	171,103	-	-	-	-	-	-	244,824	
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(441,978)	(441,978)	
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	59,206	-	-	-	-	-	97,646	156,852	
九十九年十二月三十一日餘額	25,910,078	\$ 259,100,787	\$ 55,698,434	\$ 86,239,494	\$ 1,313,047	\$ 178,227,030	\$ 265,779,571	(\$ 6,543,163)	\$ 109,289	\$ 574,144,918	

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣精體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$ 161,605,009	\$ 89,217,836
調整項目		
折舊及攤銷	83,366,121	74,327,868
聯屬公司間未實現銷售毛利	52,742	160,279
金融資產折溢價攤銷數	18,611	6,322
處分備供出售金融資產淨益	-	(37,370)
持有至到期日金融資產被贖回利益	-	(16,091)
處分以成本衡量之金融資產損失	1,263	97
採權益法認列之投資淨損（益）	(7,111,443)	2,695,720
獲配採權益法被投資公司之現金股利	422,490	1,402,592
處分固定資產及其他資產淨損（益）	761,298	(138,613)
獲配股票作價賠償收入	(4,434,364)	-
遞延所得稅	(373,253)	(1,678,381)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資		
產及負債	189,577	(222,901)
應收關係人款項	(3,192,201)	(10,813,569)
應收票據及帳款	(2,366,385)	(8,443,344)
備抵呆帳	57,000	(5,746)
備抵退貨及折讓	(1,242,188)	2,715,050
其他應收關係人款項	85,830	235,470
其他金融資產	904,157	(392,317)
存 貨	(6,816,132)	(6,022,280)
預付費用及其他流動資產	(445,797)	290,470
應付帳款	624,608	4,925,758
應付關係人款項	535,108	836,992
應付所得稅	(1,652,251)	(461,691)
應付薪資及獎金	(3,389,548)	7,075,402
應付員工紅利及董事酬勞	4,188,131	(881,731)
應付費用及其他流動負債	265,241	1,259,544
應計退休金負債	17,425	97,167
遞延貨項	(47,873)	(230,487)
營業活動之淨現金流入	<u>222,023,176</u>	<u>155,902,046</u>

（接次頁）

(承前頁)

	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 182,335,032)	(\$ 86,970,843)
購買持有至到期日金融資產	-	(10,803,805)
採權益法之長期股權投資增加	(8,262,519)	(320,443)
購買以成本衡量之金融資產	(480)	(1,411)
處分備供出售金融資產價款	-	1,037,370
持有至到期日金融資產領回	15,943,000	6,293,000
處分以成本衡量之金融資產價款	3,370	18,828
被投資公司減資退回股款	-	27,753
處分固定資產及其他資產價款	387,735	71,850
遞延借項增加	(1,538,301)	(1,347,228)
存出保證金減少(增加)	(5,940,633)	21,621
其他資產增加	(1,004,581)	-
投資活動之淨現金流出	(182,747,441)	(91,973,308)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	30,908,637	-
償還公司債	-	(8,000,000)
存入保證金減少	(253,489)	(477,776)
員工行使認股權發行新股	244,824	260,533
現金股利	(77,708,120)	(76,876,312)
融資活動之淨現金流出	(46,808,148)	(85,093,555)
現金及約當現金淨減少數	(7,532,413)	(21,164,817)
年初現金及約當現金餘額	117,043,543	138,208,360
年底現金及約當現金餘額	\$109,511,130	\$117,043,543
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 200,892	\$ 351,803
支付所得稅	\$ 9,640,396	\$ 7,791,196
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$195,950,918	\$108,592,471
應付工程及設備款增加	(13,491,140)	(21,620,819)
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)
支付現金金額	\$182,335,032	\$ 86,970,843

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
處分固定資產及其他資產償款	\$ 1,872,880	\$ 64,390
其他應收關係人款項減少(增加)	(1,142,108)	8,269
其他金融資產款項增加	(218,291)	-
換出資產抵減償款	(124,746)	(809)
取得現金金額	<u>\$ 387,735</u>	<u>\$ 71,850</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	<u>\$ 718,637</u>	<u>\$ 769,144</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年六月三十日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年六月三十日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇一年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 樹 傑

黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 八 月 十 四 日



台灣積體電路股份有限公司

民國一〇一一年六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	一〇一一年六月三十日		一〇〇年六月三十日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一一年六月三十日		一〇〇年六月三十日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1310	現金及約當現金 (附註二及四)	\$ 116,989,019	14	\$ 95,297,486	13	2180	短期借款 (附註十四)	\$ 30,772,585	4	\$ 33,140,881	4
1320	公平價值變動列入損益之金融資產 (附註二、五及二二)	18,950	-	17,455	-	2140	公平價值變動列入損益之金融負債 (附註二、五及二二)	26,718	-	-	-
1330	備供出售金融資產 (附註二、六及二二)	1,756,835	-	4,171,309	1	2150	應付帳款	12,803,106	1	10,138,171	1
1150	持有至到期日金融資產 (附註二、七及二二)	700,562	-	2,114,955	-	2160	應付關係人款項 (附註二二)	3,658,125	-	3,386,091	-
1143	應收關係人款項 (附註三及二三)	38,476,727	5	27,402,025	4	2216	應付所得稅 (附註二及十七)	6,779,393	1	6,076,318	1
1149	應收票據及帳款 (附註三)	21,578,627	3	23,797,744	3	2219	應付現金股利 (附註十九)	77,748,668	9	77,730,236	10
1180	備抵呆帳 (附註二、三及八)	(485,120)	-	(488,000)	-	2224	應付員工紅利及董事酬勞 (附註二及十九)	14,132,524	2	15,859,637	2
1188	備抵退貨及折讓 (附註二及八)	(6,262,194)	(1)	(5,641,777)	(1)	2170	應付工程及設備款	43,949,310	5	34,942,119	5
1190	其他應收關係人款項 (附註三及二三)	652,396	-	3,231,557	-	2271	應付費用及其他流動負債 (附註二二)	16,838,182	2	11,786,554	2
1210	其他金融資產	155,754	-	423,794	-	21XX	一年內到期之應付公司債 (附註十五及二二)	-	-	4,500,000	1
1286	存貨 (附註二及九)	28,428,847	3	28,404,692	4		流動負債合計	206,708,611	24	197,560,007	26
1298	遞延所得稅資產 (附註二及十七)	2,540,243	-	1,053,036	-	2410	長期負債				
11XX	流動資產合計	206,362,984	24	180,852,277	24	2440	應付公司債 (附註十五及二二)	35,000,000	4	-	-
1421	長期投資 (附註二、七、十、十一及二二)					24XX	其他長期應付款 (附註二二)	54,000	-	-	-
1460	按權益法之長期股權投資	132,250,792	15	110,458,979	15		長期負債合計	35,054,000	4	-	-
1480	持有至到期日金融資產	701,723	-	1,404,575	-	2810	其他負債				
14XX	以成本衡量之金融資產	497,835	-	497,835	-	2820	應計退休金負債 (附註二及十六)	3,883,230	-	3,860,459	-
	長期投資合計	133,450,350	15	112,361,389	15	28XX	存入保證金 (附註二五)	250,129	-	502,883	-
							其他負債合計	4,133,359	-	4,363,342	-
	固定資產 (附註二、十二及二三)					2XXX	負債合計	245,895,970	28	201,923,349	26
1521	成 本						股本 (附註十九)				
1531	建築物	165,491,613	19	146,790,740	19	3110	普通股股本—每股面額 10 元				
1561	機器設備	1,113,874,688	127	950,275,417	124		額定—28,050,000 仟股				
15X1	辦公設備	15,395,864	2	12,915,965	2		發行—一〇一一年 25,920,709 仟股				
15X9	累積折舊	(859,587,011)	(98)	(754,185,331)	(99)		一〇〇年 25,914,283 仟股	259,207,094	30	259,142,831	34
1670	預付款項及未完工程	79,017,436	9	93,045,607	12	32XX	資本公積 (附註二及十九)	56,025,149	6	55,802,387	7
15XX	固定資產淨額	514,192,590	59	448,842,398	58		保留盈餘 (附註十九)				
1760	無形資產					3310	法定盈餘公積	115,820,123	13	102,399,995	13
1780	商譽 (附註二)	1,567,756	-	1,567,756	-	3320	特別盈餘公積	7,606,224	1	6,433,874	1
17XX	遞延借項—淨額 (附註二及十三)	4,505,501	1	5,216,575	1	3350	未分配盈餘	196,302,944	23	151,443,573	20
	無形資產合計	6,073,257	1	6,784,331	1	33XX	保留盈餘合計	319,729,291	37	260,277,442	34
1860	其他資產					3420	股東權益其他項目				
1820	遞延所得稅負債 (附註二及十七)	8,056,117	1	10,855,491	1	3450	累積換算調整數 (附註二)	(7,830,895)	(1)	(11,461,047)	(1)
1880	存出保證金	4,263,506	-	4,796,851	1	34XX	金融商品未實現利益 (附註二及二二)	334,651	-	187,908	-
18XX	其他 (附註二及二三)	962,456	-	1,380,133	-		股東權益其他項目合計	(7,496,244)	(1)	(11,273,139)	(1)
	其他資產合計	13,282,079	1	17,032,475	2	3XXX	股東權益合計	627,465,290	72	563,949,521	74
1XXX	資 產 總 計	\$ 873,361,260	100	\$ 765,872,870	100		負債及股東權益總計	\$ 873,361,260	100	\$ 765,872,870	100

董事長：



經理人：



會計主管：



後附之附註係本財務報表之一部分。

台灣積體電路製造股份有限公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	一〇一年上半年度		一〇〇年上半年度	
	金 額	%	金 額	%
4110 銷貨收入總額(附註二及二三)	\$ 234,483,507		\$ 212,301,752	
4170 銷貨退回及折讓(附註二及八)	<u>3,734,225</u>		<u>1,907,979</u>	
4100 銷貨收入淨額	230,749,282	100	210,393,773	100
5110 銷貨成本(附註九、十八及二三)	<u>121,938,291</u>	<u>53</u>	<u>113,265,613</u>	<u>54</u>
5910 調整前銷貨毛利	108,810,991	47	97,128,160	46
5930 關聯企業間已(未)實現銷貨毛利(附註二)	(<u>139,950</u>)	-	<u>249,480</u>	-
銷貨毛利	<u>108,671,041</u>	<u>47</u>	<u>97,377,640</u>	<u>46</u>
營業費用(附註十八及二三)				
6300 研究發展費用	18,351,671	8	15,283,607	7
6200 管理費用	8,402,018	4	6,029,204	3
6100 行銷費用	<u>1,155,674</u>	-	<u>1,211,366</u>	<u>1</u>
6000 合 計	<u>27,909,363</u>	<u>12</u>	<u>22,524,177</u>	<u>11</u>
6900 營業利益	<u>80,761,678</u>	<u>35</u>	<u>74,853,463</u>	<u>35</u>
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資淨益(附註二及十)	5,083,116	3	2,914,860	2
7110 利息收入	464,380	-	402,293	-
7480 和解賠償收入(附註二五)	448,275	-	433,425	-
7480 技術服務收入(附註二三)	232,904	-	224,238	-
7160 兌換淨益(附註二)	213,731	-	322,334	-
7480 其他收入(附註二及二三)	<u>305,738</u>	-	<u>461,096</u>	-
7100 合 計	<u>6,748,144</u>	<u>3</u>	<u>4,758,246</u>	<u>2</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一 〇 一 年 上 半 年 度		一 〇 〇 年 上 半 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7630	金融資產減損損失(附註二、六及二二)	\$ 2,677,529	1	\$ -	-
7630	閒置資產減損損失(附註二)	418,330	-	-	-
7510	利息費用	370,798	-	146,374	-
7640	金融商品評價淨損(附註二、五及二二)	150,310	-	197,255	-
7530	處分固定資產損失(附註二及二三)	66,620	-	153,131	-
7880	其他損失(附註二)	7,869	-	122,232	-
7500	合 計	<u>3,691,456</u>	<u>1</u>	<u>618,992</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	83,818,366	37	78,992,717	37
8110	所得稅費用(附註二及十七)	<u>8,531,562</u>	<u>4</u>	<u>6,764,610</u>	<u>3</u>
9600	本期淨利	<u>\$ 75,286,804</u>	<u>33</u>	<u>\$ 72,228,107</u>	<u>34</u>
代 碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.23</u>	<u>\$ 2.90</u>	<u>\$ 3.05</u>	<u>\$ 2.79</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.23</u>	<u>\$ 2.90</u>	<u>\$ 3.05</u>	<u>\$ 2.79</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣新豐實業股份有限公司

民國一〇一年六月三十日

單位：新台幣千元，除
每股股利為元

	普通股發行股本		資本公積		盈餘		其他項目		合計	
	股數(千股)	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
一〇一年一月一日餘額	25,916,222	\$ 259,162,226	\$ 55,846,357	\$ 102,399,995	\$ 6,433,874	\$ 213,357,286	\$ 322,191,135	(\$ 6,433,369)	(\$ 1,172,855)	\$ 629,593,514
盈餘分配										
法定盈餘公積	-	-	-	13,420,128	-	(13,420,128)	-	-	-	-
股利特別盈餘公積	-	-	-	-	1,172,350	(1,172,350)	-	-	-	-
現金股利-每股3.00元	-	-	-	-	-	(77,748,668)	(77,748,668)	-	-	(77,748,668)
一〇一年上半年度淨利	-	-	-	-	-	75,286,804	75,286,804	-	-	75,286,804
採權益法認列被投資公司之調整	-	-	83,954	-	-	-	-	-	-	83,954
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(1,397,526)	-	-	(1,397,526)
員工行使認股權發行新股	4,487	44,868	94,838	-	-	-	-	-	-	139,706
提供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,301	1,508,301
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(795)	(795)
一〇一年六月三十日餘額	25,920,709	\$ 259,207,094	\$ 56,025,149	\$ 115,820,123	\$ 7,606,224	\$ 196,302,944	\$ 319,729,291	(\$ 7,830,895)	\$ 334,651	\$ 627,465,290
一〇〇年一月一日餘額	25,910,078	\$ 259,100,787	\$ 55,698,434	\$ 86,239,494	\$ 1,313,047	\$ 178,227,030	\$ 265,779,571	(\$ 6,543,163)	\$ 109,289	\$ 574,144,918
盈餘分配										
法定盈餘公積	-	-	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-	-	-
股利特別盈餘公積	-	-	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-	-	-
現金股利-每股3.00元	-	-	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	-	-	(77,730,236)
一〇〇年上半年度淨利	-	-	-	-	-	72,228,107	72,228,107	-	-	72,228,107
採權益法認列被投資公司之調整	-	-	14,643	-	-	-	-	-	-	14,643
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(4,917,884)	-	-	(4,917,884)
員工行使認股權發行新股	4,205	42,044	89,310	-	-	-	-	-	-	131,354
提供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	176,970	176,970
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(98,351)	(98,351)
一〇〇年六月三十日餘額	25,914,283	\$ 259,142,831	\$ 55,802,387	\$ 102,399,995	\$ 6,433,874	\$ 151,443,573	\$ 260,277,442	(\$ 11,461,047)	\$ 187,908	\$ 563,949,521

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元

	一〇一年 上半年度	一〇〇年 上半年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 75,286,804	\$ 72,228,107
調整項目		
折舊及攤銷	57,167,176	49,954,937
關聯企業間未(已)實現銷貨毛利	139,950	(249,480)
金融資產折溢價攤銷數	1,142	7,757
處分備供出售金融資產淨益	-	(35,151)
採權益法認列之投資淨益	(5,083,116)	(2,914,860)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	1,285,480	1,914,392
處分固定資產及其他資產淨損	56,220	10,251
金融資產減損損失	2,677,529	-
閒置資產減損損失	418,330	-
遞延所得稅	2,096,079	336,498
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資 產及負債	22,693	(25,289)
應收關係人款項	(13,699,193)	(1,668,051)
應收票據及帳款	(1,684,241)	(1,546,839)
備抵退貨及折讓	1,374,315	(1,699,667)
其他應收關係人款項	(65,063)	(64,293)
其他金融資產	(33,744)	(5,588)
存 貨	(5,575,450)	(2,758,344)
預付費用及其他流動資產	(86,602)	284,243
應付帳款	2,787,642	(2,091,732)
應付關係人款項	615,433	811,641
應付所得稅	(3,868,404)	(1,032,551)
應付員工紅利及董事酬勞	5,076,820	4,900,168
應付費用及其他流動負債	3,582,071	(1,875,486)
應計退休金負債	22,332	35,858
營業活動之淨現金流入	<u>122,514,203</u>	<u>114,516,521</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一一年 上半年度	一〇〇年 上半年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$105,768,037)	(\$139,147,091)
採權益法之長期股權投資增加	(2,170,738)	(511,390)
被投資公司減資退回股款	186,726	-
處分備供出售金融資產價款	-	1,035,151
持有至到期日金融資產領回	-	2,675,000
處分固定資產及其他資產價款	83,226	2,068,298
遞延借項增加	(674,769)	(788,025)
存出保證金減少	228,229	3,841,898
其他資產減少(增加)	30,798	(22,600)
投資活動之淨現金流出	(108,084,565)	(130,848,759)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,846,057	2,232,244
發行公司債	17,000,000	-
償還公司債	(4,500,000)	-
存入保證金減少	(188,903)	(245,004)
員工行使認股權發行新股	139,706	131,354
融資活動之淨現金流入	17,296,860	2,118,594
現金及約當現金淨增加(減少)數	31,726,498	(14,213,644)
期初現金及約當現金餘額	85,262,521	109,511,130
期末現金及約當現金餘額	\$116,989,019	\$ 95,297,486
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 266,881	\$ 221,853
支付所得稅	\$ 10,270,194	\$ 7,417,035
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$116,448,332	\$133,768,114
應付工程及設備款減少(增加)	(10,630,116)	5,379,459
應付關係人款項增加	(50,110)	-
換出資產抵減價款	(69)	(482)
支付現金金額	\$105,768,037	\$139,147,091
處分固定資產及其他資產價款	\$ 65,393	\$ 2,905,302
其他應收關係人款項減少(增加)	17,902	(836,522)
換出資產抵減價款	(69)	(482)
取得現金金額	\$ 83,226	\$ 2,068,298

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一一年 上半年度	一〇〇年 上半年度
購置遞延借項償款	\$ 787,769	\$ 788,025
其他長期應付款(含一年內到期部分)增加	(113,000)	-
支付現金金額	<u>\$ 674,769</u>	<u>\$ 788,025</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產轉列閒置資產	<u>\$ 418,330</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費 用及其他流動負債)	<u>\$ 59,000</u>	<u>\$ 897,298</u>
一年內到期之應付公司債	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,500,000</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 二 月 十 四 日

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日			九十九年十二月三十一日			代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日			九十九年十二月三十一日		
		金額	%		金額	%				金額	%		金額	%	
1100	流動資產							2100	流動負債						
1310	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 143,472,277	19		\$ 147,886,955	20		2180	短期借款（附註十五）	\$ 25,926,528	3		\$ 31,213,944	4	
	公平價值變動列入損益之金融資產（附註二、五及二六）	15,360	-	6,886	-				公平價值變動列入損益之金融負債（附註二、五及二六）	13,742	-	19,002	-		
1320	備供出售金融資產（附註二、六及二六）	3,308,770	-	28,883,728	4			2200	避險之衍生性金融負債（附註二、十一及二六）	232	-	814	-		
1330	持有至到期日金融資產（附註二、七及二六）	3,825,680	1	4,796,589	1			2140	應付帳款	10,530,487	1	12,104,173	2		
1150	應收關係人款項（附註三及二七）	185,764	-	2,722	-			2150	應付關係人款項（附註二七）	1,328,521	-	867,085	-		
1143	應收票據及帳款（附註三）	46,321,240	6	51,029,885	7			2160	應付所得稅（附註二及二十）	10,656,124	1	7,184,697	1		
1149	備抵呆帳（附註二、三及八）	(490,952)	-	(504,029)	-			2171	應付薪資及獎金	6,148,499	1	6,424,064	1		
1148	備抵退貨及折讓（附註二及八）	(5,068,263)	(1)	(7,546,264)	(1)			2219	應付員工紅利及董監酬勞（附註二及二二）	9,081,293	1	11,096,147	2		
1180	其他應收關係人款項（附註三及二七）	122,292	-	124,586	-			2224	應付工程及設備款	35,540,526	5	43,259,857	6		
1190	其他金融資產（附註二八）	617,142	-	1,021,552	-			2170	應付費用及其他流動負債（附註二八、二六及三十）	13,218,235	2	10,779,923	1		
1210	存貨（附註二及九）	24,840,582	3	28,405,984	4			2271	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款（附註十六、十七、二六及二八）	4,562,500	1	241,407	-		
1286	遞延所得稅資產—淨額（附註二及二十）	5,936,490	1	5,373,076	1			21XX	流動負債合計	117,006,687	15	123,191,113	17		
1298	預付費用及其他流動資產	2,174,014	-	2,037,647	-				長期負債						
11XX	流動資產合計	225,260,396	29	261,519,317	36			2410	應付公司債（附註十六及二六）	18,000,000	3	4,500,000	1		
	長期投資（附註二、六、七、十、十二及二六）							2421	長期銀行借款（附註十七、二六及二八）	1,587,900	-	301,561	-		
1421	採權益法之長期股權投資	24,900,332	3	25,815,385	4			2443	其他長期應付款（附註十八、二六及三十）	-	-	6,554,208	1		
1450	備供出售金融資產	-	-	1,033,049	-			2446	應付租賃款（附註二、十三及二六）	870,993	-	694,986	-		
1460	持有至到期日金融資產	5,243,167	1	8,502,887	1			24XX	長期負債合計	20,458,493	3	12,050,755	2		
1480	以成本衡量之金融資產	4,315,005	1	4,424,207	1				其他負債						
14XX	長期投資合計	34,458,504	5	39,775,528	6			2810	應計退休金負債（附註二及十九）	3,908,508	-	3,812,351	1		
	固定資產（附註二、十三、二七及二八）							2820	存入保證金（附註三十）	443,983	-	789,098	-		
1501	成 本	1,541,128	-	891,197	-			2881	遞延貨項	26,533	-	126,539	-		
1521	土地及土地改良	172,872,550	22	145,966,024	20			2888	其 他	377,187	-	254,643	-		
1531	建 築 物	1,057,588,736	137	913,155,252	127			28XX	其他負債合計	4,756,211	-	4,982,631	1		
1561	機器設備	16,969,266	2	14,856,582	2				負債合計	142,221,391	18	140,224,499	20		
1561	辦公設備	791,480	-	701,552	-				股本（附註二二）						
1611	租賃資產	1,249,763,160	161	1,075,570,607	149			3110	普通股股本—每股面額 10 元						
15X1	累積折舊	(876,252,220)	(113)	(773,278,157)	(107)				額定—28,050,000 仟股						
1670	預付款項及未完工程	116,863,976	15	86,151,573	12				發行—一〇〇年 25,916,222 仟股						
15XX	固定資產淨額	490,374,916	63	388,444,023	54				九十九年 25,910,078 仟股	259,162,226	33	259,100,787	36		
	無形資產								資本公積（附註二及二二）	55,846,357	7	55,698,434	8		
1760	商譽（附註二）	5,693,999	1	5,704,897	1				保留盈餘（附註二二）						
1780	遞延借項—淨額（附註二及十四）	5,167,564	-	6,027,085	1			3310	法定盈餘公積	102,399,995	13	86,239,494	12		
17XX	無形資產合計	10,861,563	1	11,731,982	2			3320	特別盈餘公積	6,433,874	1	1,313,047	-		
	其他資產							3350	未分配盈餘	213,357,286	28	178,227,030	24		
1860	遞延所得稅資產（附註二及二十）	7,436,717	1	7,362,784	1			33XX	保留盈餘合計	322,191,155	42	265,779,571	36		
1820	存出保證金	4,518,863	1	8,677,970	1				股東權益其他項目（附註二、十一、二四及二六）						
1880	其他（附註二及二八）	1,353,983	-	1,417,300	-			3420	累積換算調整數	(6,433,369)	(1)	(6,543,163)	(1)		
18XX	其他資產合計	13,309,563	2	17,458,054	2			3450	金融商品未實現（損）益	(1,172,855)	-	(109,289)	-		
								34XX	股東權益其他項目合計	(7,606,224)	(1)	(6,433,874)	(1)		
									母公司股東權益合計	629,593,514	81	574,144,918	79		
									少數股權（附註二）	2,450,037	1	4,559,487	1		
									股東權益合計	632,043,551	82	578,704,405	80		
1XXX	資 產 總 計	\$ 774,264,942	100	\$ 718,928,904	100				負債及股東權益總計	\$ 774,264,942	100	\$ 718,928,904	100		

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路股份有限公司及子公司



民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	一 金	〇 額	〇 年 度	%	九 金	十 額	九 年 度	%
4110 銷貨收入總額(附註二及二七)	\$	430,490,500			\$	431,630,858		
4170 銷貨退回及折讓(附註二及八)		3,409,855				12,092,947		
4100 銷貨收入淨額		427,080,645		100		419,537,911		100
5110 銷貨成本(附註九、二一及二七)		232,937,388		55		212,484,320		51
5910 銷貨毛利		194,143,257		45		207,053,591		49
5920 關聯企業間未實現銷貨毛利 (附註二)	(	74,029		-		-		-
已實現銷貨毛利		194,069,228		45		207,053,591		49
營業費用(附註二一及二七)								
6300 研究發展費用		33,829,880		8		29,706,662		7
6200 管理費用		14,164,114		3		12,803,997		3
6100 行銷費用		4,517,816		1		5,367,597		1
6000 合 計		52,511,810		12		47,878,256		11
6900 營業利益		141,557,418		33		159,175,335		38
營業外收入及利益								
7110 利息收入		1,479,514		1		1,665,193		-
7480 和解賠償收入(附註三十)		947,340		-		6,939,764		2
7121 採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)		897,611		-		2,298,159		1
7310 金融商品評價淨益(附註 二、五及二六)		507,432		-		320,730		-
7480 技術服務收入(附註二七 及三十)		407,089		-		450,503		-
7140 處分金融資產淨益(附註 二及二六)		233,214		-		736,843		-
7480 其他收入(附註二及二七)		886,327		-		724,880		-
7100 合 計		5,358,527		1		13,136,072		3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一 〇 〇 年 度		九 十 九 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	\$ 626,725	-	\$ 425,356	-
7630	金融資產減損損失(附註二、十二及二六)	265,515	-	159,798	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	200,673	-	849,254	-
7560	兌換淨損(附註二)	185,555	-	99,130	-
7630	閒置資產減損損失(附註二)	98,009	-	319	-
7880	災害損失(附註九)	-	-	190,992	-
7880	其他損失(附註二)	391,791	-	316,163	-
7500	合 計	<u>1,768,268</u>	<u>-</u>	<u>2,041,012</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	145,147,677	34	170,270,395	41
8110	所得稅費用(附註二及二十)	<u>10,694,417</u>	<u>3</u>	<u>7,988,465</u>	<u>2</u>
9600	合併總淨利	<u>\$ 134,453,260</u>	<u>31</u>	<u>\$ 162,281,930</u>	<u>39</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 134,201,279	31	\$ 161,605,009	39
9602	少數股權	<u>251,981</u>	<u>-</u>	<u>676,921</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 134,453,260</u>	<u>31</u>	<u>\$ 162,281,930</u>	<u>39</u>
代 碼		稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
	每股盈餘(附註二五)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.59</u>	<u>\$ 5.18</u>	<u>\$ 6.54</u>	<u>\$ 6.24</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.59</u>	<u>\$ 5.18</u>	<u>\$ 6.54</u>	<u>\$ 6.23</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月十一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

	母 公 司			股 份			庫 存 股			其 他 項 目			母 公 司 股 東			少 數 股 權			股 東 權 益 合 計		
	普 通 股 發 行 股 本	金 額	資 本 公 積	保 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品	庫 藏 股 票	母 公 司 股 東	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計
九十九年一月一日餘額	25,902,706	\$ 259,027,066	\$ 55,486,010	\$ 77,317,710	\$ -	\$ 104,564,972	\$ 181,882,682	(\$ 1,766,667)	\$ 453,621	\$ -	\$ 495,082,712	\$ 3,965,836	\$ 499,048,548								
盈餘分配																					
法定盈餘公積	-	-	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	-	-	-	(77,708,120)	-	(77,708,120)	-	(77,708,120)	-	(77,708,120)	-	(77,708,120)	-	(77,708,120)
九十九年度合併總淨利	-	-	-	-	-	161,605,009	161,605,009	-	-	-	161,605,009	676,921	162,281,930	-	162,281,930	676,921	162,281,930	-	162,281,930	676,921	162,281,930
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	(17,885)	-	-	-	-	-	-	-	(17,885)	4,387	(13,498)	-	(13,498)	4,387	(13,498)	-	(13,498)	4,387	(13,498)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(4,776,496)	-	-	(4,776,496)	7,258	(4,769,238)	-	(4,769,238)	7,258	(4,769,238)	-	(4,769,238)	7,258	(4,769,238)
員工行使認股權發行新股	7,372	73,721	171,103	-	-	-	-	-	-	-	244,824	-	244,824	-	244,824	-	244,824	-	244,824	-	244,824
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(337,970)	-	(337,970)	3,949	(334,021)	-	(334,021)	3,949	(334,021)	-	(334,021)	3,949	(334,021)
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	59,206	-	-	-	-	-	(6,031)	-	53,175	31,702	84,877	-	84,877	31,702	84,877	-	84,877	31,702	84,877
現金流量迴除未實現損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(331)	-	(331)	(483)	(814)	-	(814)	(483)	(814)	-	(814)	(483)	(814)
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130,083)	(130,083)	-	(130,083)	(130,083)	(130,083)	-	(130,083)	(130,083)	(130,083)
九十九年十二月三十一日餘額	25,910,078	259,100,787	55,698,434	86,239,494	1,313,047	178,227,030	265,779,571	(6,543,163)	109,289	-	574,144,918	4,559,487	578,704,405								
盈餘分配																					
法定盈餘公積	-	-	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	-	-	-	(77,730,236)	-	(77,730,236)	-	(77,730,236)	-	(77,730,236)	-	(77,730,236)	-	(77,730,236)
一〇〇年度合併總淨利	-	-	-	-	-	134,201,279	134,201,279	-	-	-	134,201,279	251,981	134,453,260	-	134,453,260	251,981	134,453,260	-	134,453,260	251,981	134,453,260
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	59,898	-	-	-	-	-	-	-	59,898	1,152	61,050	-	61,050	1,152	61,050	-	61,050	1,152	61,050
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	109,794	-	-	109,794	7,587	117,381	-	117,381	7,587	117,381	-	117,381	7,587	117,381
員工行使認股權發行新股	7,144	71,439	146,258	-	-	-	-	-	-	-	217,697	-	217,697	-	217,697	-	217,697	-	217,697	-	217,697
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,241,249)	-	(1,241,249)	(3,325)	(1,244,574)	-	(1,244,574)	(3,325)	(1,244,574)	-	(1,244,574)	(3,325)	(1,244,574)
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	(56,094)	-	-	-	-	-	(41,133)	-	(97,227)	-	(97,227)	-	(97,227)	-	(97,227)	-	(97,227)	-	(97,227)
現金流量迴除未實現損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	238	344	582	-	582	344	582	-	582	344	582
庫藏股票交易－股東執行股份收買請求權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,598)	(71,598)	-	(71,598)	-	(71,598)	-	(71,598)	-	(71,598)	-	(71,598)
庫藏股票註銷	(1,000)	(10,000)	(2,139)	-	-	(59,459)	(59,459)	-	-	71,598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(379,334)	(379,334)	-	(379,334)	(379,334)	(379,334)	-	(379,334)	(379,334)	(379,334)
合併個體變動影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,987,855)	(1,987,855)	-	(1,987,855)	(1,987,855)	(1,987,855)	-	(1,987,855)	(1,987,855)	(1,987,855)
一〇〇年十二月三十一日餘額	25,916,222	\$ 259,162,226	\$ 55,846,357	\$ 102,399,995	\$ 6,433,874	\$ 213,357,286	\$ 322,191,155	(\$ 6,433,369)	(\$ 1,172,855)	\$ -	\$ 629,593,514	\$ 2,450,037	\$ 632,043,551								

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：何麗梅

會計主管：周露露

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之淨利	\$ 134,201,279	\$ 161,605,009
歸屬予少數股權之淨利	251,981	676,921
調整項目		
折舊及攤銷	107,681,521	87,810,103
關聯企業間未實現銷貨毛利	74,029	-
金融資產折溢價攤銷數	24,711	34,142
金融資產減損損失	265,515	159,798
處分備供出售金融資產淨益	(212,442)	(603,368)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(20,772)	(133,475)
採權益法認列之投資淨益	(897,611)	(2,298,159)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,848,141	320,002
處分固定資產及其他資產淨損（益）	(3,286)	633,230
獲配股票作價賠償收入	(158,779)	(4,434,364)
提列閒置資產減損損失	98,009	319
遞延所得稅	(491,122)	(377,248)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產		
及負債	(13,734)	198,172
應收關係人款項	123,265	9,802
應收票據及帳款	3,627,110	(6,392,243)
備抵呆帳	(12,844)	(39,296)
備抵退貨及折讓	(2,478,001)	(1,178,217)
其他應收關係人款項	2,294	(3,294)
其他金融資產	376,342	740,959
存 貨	2,611,297	(7,492,233)
預付費用及其他流動資產	(403,762)	(752,408)
應付帳款	(1,968,820)	933,894
應付關係人款項	462,578	84,078
應付所得稅	3,490,268	(1,615,552)
應付薪資及獎金	(275,565)	(2,892,971)
應付員工紅利及董監酬勞	(1,925,594)	4,277,804
應付費用及其他流動負債	304,582	248,192
應計退休金負債	98,915	15,319
遞延貸項	(92,454)	(59,150)
營業活動之淨現金流入	<u>247,587,051</u>	<u>229,475,766</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 213,962,521)	(\$ 186,944,203)
購買備供出售金融資產	(35,088,394)	(48,340,334)
購買持有至到期日金融資產	(584,280)	(4,101,501)
採權益法之長期股權投資增加	-	(6,242,350)
購買以成本衡量之金融資產	(403,908)	(1,812,928)
處分備供出售金融資產價款	59,305,023	37,816,288
持有至到期日金融資產領回	4,789,000	15,943,000
處分以成本衡量之金融資產價款	226,226	242,335
處分固定資產及其他資產價款	698,055	115,524
遞延借項增加	(1,715,892)	(1,801,728)
存出保證金減少(增加)	4,149,543	(5,944,827)
其他資產減少(增加)	<u>63,723</u>	<u>(1,015,458)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(182,523,425)</u>	<u>(202,086,182)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(5,287,416)	31,213,944
舉借長期借款	2,250,000	-
償還長期借款	(1,142,968)	(967,034)
發行公司債	18,000,000	-
其他長期應付款減少	(3,633,052)	(1,107,333)
存入保證金減少	(342,242)	(232,925)
受領贈與	-	49,021
員工行使認股權發行新股	217,697	244,824
買回庫藏股票	(71,598)	-
發放現金股利	(77,730,236)	(77,708,120)
少數股權減少	<u>(118,226)</u>	<u>(130,083)</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(67,858,041)</u>	<u>(48,637,706)</u>
現金及約當現金淨減少數	(2,794,415)	(21,248,122)
匯率影響數	(147,682)	(2,141,264)
合併個體變動影響數	(1,472,581)	-
年初現金及約當現金餘額	<u>147,886,955</u>	<u>171,276,341</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 143,472,277</u>	<u>\$ 147,886,955</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 531,518	\$ 392,805
支付所得稅	\$ 7,677,085	\$ 9,818,418
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產償款	\$ 207,175,565	\$ 201,696,476
應付工程及設備款減少(增加)	6,846,682	(14,599,987)
換出資產抵減償款	(3,164)	(124,746)
其他負債增加	(56,562)	(27,540)
支付現金金額	\$ 213,962,521	\$ 186,944,203
處分固定資產及其他資產償款	\$ 543,219	\$ 458,561
其他金融資產減少(增加)	158,000	(218,291)
換出資產抵減償款	(3,164)	(124,746)
取得現金金額	\$ 698,055	\$ 115,524
購買備供出售金融資產償款	\$ 35,024,974	\$ 48,405,875
應付費用及其他流動負債減少(增加)	63,420	(65,541)
支付現金金額	\$ 35,088,394	\$ 48,340,334
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ 4,500,000	\$ -
一年內到期之長期銀行借款	\$ 62,500	\$ 241,407
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	\$ 3,399,855	\$ 1,406,601

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張忠謀



經理人：何麗梅



會計主管：周露露



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年六月三十日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年六月三十日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林鴻鵬

林鴻鵬



會計師 黃樹傑

黃樹傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 八 月 十 四 日

台灣積體電路製造股份有限公司

民國一〇〇一年六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	一〇〇一年六月三十日	一〇〇〇年六月三十日	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇一年六月三十日	一〇〇〇年六月三十日					
	金 額 %	金 額 %	金 額 %		金 額 %	金 額 %					
1100	流動資產			2100	流動負債						
1310	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 178,440,559	20	\$ 150,978,778	19	2180	短期借款(附註十五)	\$ 30,772,585	3	\$ 33,140,881	4
	公平價值變動列入損益之金融資產(附註二、五及二五)	23,734	-	19,781	-		公平價值變動列入損益之金融負債(附註二、五及二五)	35,166	-	15,052	-
1320	備供出售金融資產(附註二、六及二五)	2,477,046	-	5,208,149	1	2200	避險之衍生性金融負債(附註二、十一及二五)	69	-	448	-
1330	持有至到期日金融資產(附註二、七及二五)	7,424,976	1	2,924,804	1	2140	應付帳款	14,126,994	2	11,710,578	1
1150	應收關係人款項(附註三及二六)	837,245	-	2,367	-	2150	應付關係人款項(附註二六)	1,309,966	-	1,542,011	-
1143	應收票據及帳款(附註三)	61,101,346	7	52,491,604	7	2160	應付所得稅(附註二及二〇)	6,787,548	1	6,104,840	1
1149	保款單據(附註二、三及八)	(490,914)	-	(494,000)	-	2216	應付現金股利(附註二二)	77,762,637	9	78,127,227	10
1148	保款退還及折讓(附註二及八)	(6,508,185)	(1)	(5,811,952)	(1)	2219	應付員工紅利及董監酬勞(附註二及二二)	14,152,148	2	15,999,671	2
1180	其他應收關係人款項(附註三及二六)	981,263	-	999,772	-	2224	應付工程及設備款	45,039,813	5	36,805,112	5
1190	其他金融資產(附註二七)	603,940	-	1,054,744	-	2170	應付費用及其他流動負債(附註十三、十八、二五及二九)	21,734,989	2	17,542,781	2
1210	存貨(附註二及九)	30,780,466	4	31,523,206	4	2271	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款(附註十六、十七、二五及二七)	125,000	-	4,500,000	1
1286	遞延所得稅資產(附註二及二〇)	2,805,069	1	1,173,482	-		流動負債合計	211,846,915	24	205,488,601	26
1298	預付費用及其他流動資產	2,404,358	-	2,481,073	-	21XX					
11XX	流動資產合計	280,880,903	32	242,551,808	31		長期負債				
	長期投資(附註二、七、十、十二及二五)					2410	應付公司債(附註十六及二五)	35,000,000	4	-	-
1421	採權益法之長期股權投資	23,372,224	3	23,357,209	3	2421	長期銀行借款(附註十七、二五及二七)	1,525,000	-	1,500,000	-
1460	持有至到期日金融資產	701,723	-	7,311,037	1	2443	其他長期應付款(附註十八、二五及二九)	113,770	-	3,040,747	1
1480	以成本衡量之金融資產	4,084,014	-	4,176,134	1	2446	應付租賃款(附註二、十三及二五)	749,794	-	670,865	-
14XX	長期投資合計	28,157,961	3	34,844,380	5	24XX	長期負債合計	37,388,564	4	5,211,612	1
	固定資產(附註二、十三及二六)						其他負債				
1501	成本					2810	應計退休金負債(附註二及十九)	3,930,438	1	3,847,450	-
1521	土地及土地改良	1,549,149	-	1,501,628	-	2820	存入保證金(附註二九)	253,346	-	521,598	-
1531	建築物	189,706,742	22	166,481,044	22	2888	其他(附註二六)	429,142	-	383,887	-
1561	機器設備	1,189,804,584	135	1,012,617,056	129	28XX	其他負債合計	4,612,926	1	4,752,935	-
1611	辦公設備	18,609,347	2	15,976,394	2		負債合計	253,848,405	29	215,453,148	27
15X1	租賃資產	778,338	-	677,086	-	2XXX	股本(附註二二)				
15X9	累積折舊	(933,213,748)	(106)	(819,490,993)	(105)		普通股股本—每股面額10元				
1670	預付款項及未完工程	80,854,453	9	100,125,197	13	3110	額定—28,050,000 仟股				
15XX	固定資產淨額	548,148,865	62	477,887,412	61		發行—一〇〇一年 25,920,709 仟股	259,207,094	29	259,142,831	33
	無形資產						一〇〇一年 25,914,283 仟股	56,025,149	7	55,802,387	7
1760	商譽(附註二)	5,639,097	1	5,487,060	-	32XX	資本公積(附註二及二二)				
1780	遞延借項—淨額(附註二及十四)	5,221,454	-	5,690,862	1		保留盈餘(附註二二)				
17XX	無形資產合計	10,860,551	1	11,177,922	1	3310	法定盈餘公積	115,820,123	13	102,399,995	13
	其他資產					3320	特別盈餘公積	7,606,224	1	6,433,874	1
1860	遞延所得稅資產—淨額(附註二及二〇)	10,344,401	1	11,092,048	1	3350	未分配盈餘	196,302,944	22	151,443,573	19
1820	存出保證金(附註二六)	4,296,083	1	4,834,381	1	33XX	保留盈餘合計	319,729,291	36	260,277,442	33
1880	其他(附註二及二七)	1,217,289	-	1,427,662	-		股東權益其他項目				
18XX	其他資產合計	15,857,773	2	17,354,091	2	3420	累積換算調整數(附註二)	(7,830,895)	(1)	(11,461,047)	(1)
						3450	金融商品未實現利益(附註二、十一及二五)	334,651	-	187,908	-
						34XX	股東權益其他項目合計	(7,496,244)	(1)	(11,273,139)	(1)
							母公司股東權益合計	627,465,290	71	563,949,521	72
						3610	少數股權(附註二)	2,592,358	-	4,412,944	1
						3XXX	股東權益合計	630,057,648	71	568,362,465	73
1XXX	資 產 總 計	\$ 883,906,053	100	\$ 783,815,613	100		負債及股東權益總計	\$ 883,906,053	100	\$ 783,815,613	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		一〇一年上半年度		一〇〇年上半年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入總額(附註二及二六)	\$ 237,427,920		\$ 217,895,876	
4170	銷貨退回及折讓(附註二及八)	<u>3,859,417</u>		<u>2,010,014</u>	
4100	銷貨收入淨額(附註三四)	233,568,503	100	215,885,862	100
5110	銷貨成本(附註九、二一及二六)	<u>120,811,731</u>	<u>52</u>	<u>113,359,191</u>	<u>52</u>
5910	調整前銷貨毛利	112,756,772	48	102,526,671	48
5920	關聯企業間未實現銷貨毛利 (附註二)	<u>(139,950)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	銷貨毛利	<u>112,616,822</u>	<u>48</u>	<u>102,526,671</u>	<u>48</u>
	營業費用(附註二一及二六)				
6300	研究發展費用	19,235,781	8	16,456,677	8
6200	管理費用	9,025,466	4	6,781,342	3
6100	行銷費用	<u>2,205,936</u>	<u>1</u>	<u>2,259,365</u>	<u>1</u>
6000	合 計	<u>30,467,183</u>	<u>13</u>	<u>25,497,384</u>	<u>12</u>
6900	營業利益(附註三四)	<u>82,149,639</u>	<u>35</u>	<u>77,029,287</u>	<u>36</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	941,732	1	780,503	1
7121	採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)	610,296	1	765,485	-
7480	和解賠償收入(附註二九)	448,275	-	433,425	-
7140	處分金融資產淨益(附註 二及二五)	365,731	-	145,908	-
7160	兌換淨益(附註二)	365,310	-	419,535	-
7480	技術服務收入(附註二六)	232,659	-	224,372	-
7130	處分固定資產及其他資產 利益(附註二及二六)	21,176	-	189,020	-
7480	其他收入	<u>393,319</u>	<u>-</u>	<u>383,128</u>	<u>1</u>
7100	合 計	<u>3,378,498</u>	<u>2</u>	<u>3,341,376</u>	<u>2</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一 〇 一 年 上 半 年 度		一 〇 〇 年 上 半 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7630	金融資產減損損失(附註二、六、十二及二五)	\$ 2,748,456	1	\$ 58,096	-
7630	閒置資產減損損失(附註二)	422,323	1	58,478	-
7510	利息費用	415,039	-	243,261	-
7640	金融商品評價淨損(附註二、五及二五)	189,737	-	280,630	1
7530	處分固定資產損失(附註二)	25,302	-	156,761	-
7880	其他損失(附註二)	149,270	-	206,318	-
7500	合 計	<u>3,950,127</u>	<u>2</u>	<u>1,003,544</u>	<u>1</u>
7900	稅前利益	81,578,010	35	79,367,119	37
8110	所得稅費用(附註二及二十)	<u>6,443,942</u>	<u>3</u>	<u>6,911,828</u>	<u>3</u>
9600	合併總淨利	<u>\$ 75,134,068</u>	<u>32</u>	<u>\$ 72,455,291</u>	<u>34</u>
	歸屬於：				
9601	母公司股東	\$ 75,286,804	32	\$ 72,228,107	34
9602	少數股權	(152,736)	-	227,184	-
		<u>\$ 75,134,068</u>	<u>32</u>	<u>\$ 72,455,291</u>	<u>34</u>
代 碼		稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.15</u>	<u>\$ 2.90</u>	<u>\$ 3.05</u>	<u>\$ 2.79</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.15</u>	<u>\$ 2.90</u>	<u>\$ 3.05</u>	<u>\$ 2.79</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元

	一〇一年 上半年度	一〇〇年 上半年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之淨利	\$ 75,286,804	\$ 72,228,107
歸屬予少數股權之淨利（損）	(152,736)	227,184
調整項目		
折舊及攤銷	60,466,238	51,974,504
關聯企業間未實現銷貨毛利	139,950	-
金融資產折溢價攤銷數	3,359	15,015
金融資產減損損失	2,748,456	58,096
處分備供出售金融資產淨益	(231,622)	(126,488)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(134,109)	(19,420)
採權益法認列之投資淨益	(610,296)	(765,485)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	1,285,480	1,914,392
處分固定資產及其他資產淨損（益）	4,126	(32,259)
獲配股票作價之收入	(642)	-
閒置資產減損損失	422,323	58,478
遞延所得稅	(85,192)	427,314
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	13,050	(16,845)
應收關係人款項	(651,481)	355
應收票據及帳款	(14,780,106)	(1,461,719)
備抵呆帳	(3)	(10,029)
備抵退貨及折讓	1,441,672	(1,734,312)
其他應收關係人款項	(43,115)	(79,870)
其他金融資產	33,113	57,357
存貨	(5,939,884)	(3,117,222)
預付費用及其他流動資產	(230,344)	(443,426)
應付帳款	3,042,084	(2,075,757)
應付關係人款項	(18,555)	674,926
應付所得稅	(3,868,576)	(1,079,857)
應付員工紅利及董監酬勞	5,070,855	4,903,524
應付費用及其他流動負債	3,788,688	(2,070,228)
應計退休金負債	21,930	35,099
營業活動之淨現金流入	<u>127,021,467</u>	<u>119,541,434</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇一年 上半年度	一〇〇年 上半年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$108,038,091)	(\$146,142,855)
購買備供出售金融資產	(2,950)	(34,726,013)
購買以成本衡量之金融資產	(21,557)	(123,159)
處分備供出售金融資產價款	241,531	58,501,445
持有至到期日金融資產領回	830,368	2,675,000
處分以成本衡量之金融資產價款	205,100	207,333
處分固定資產及其他資產價款	113,668	551,208
遞延借項增加	(806,248)	(823,351)
存出保證金減少	222,780	3,843,589
其他資產減少(增加)	(22,442)	13,094
投資活動之淨現金流出	(107,277,841)	(116,023,709)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,846,057	1,926,937
舉借長期借款	-	2,100,000
償還長期借款	-	(1,142,968)
發行公司債	17,000,000	-
償還公司債	(4,500,000)	-
應付租賃款減少	(86,328)	-
其他長期應付款減少	(1,434,277)	(890,000)
存入保證金減少	(190,637)	(267,500)
員工行使認股權發行新股	139,706	131,354
少數股權增加	302,427	18,601
融資活動之淨現金流入	16,076,948	1,876,424
現金及約當現金淨增加數	35,820,574	5,394,149
匯率影響數	(852,292)	(2,302,326)
期初現金及約當現金餘額	143,472,277	147,886,955
期末現金及約當現金餘額	\$178,440,559	\$150,978,778
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 292,797	\$ 307,448
支付所得稅	\$ 10,325,668	\$ 7,605,291

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年 上半年度	一〇〇年 上半年度
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產償款	\$ 118,091,870	\$ 141,371,625
應付工程及設備款減少(增加)	(10,053,710)	4,772,583
換出資產抵減償款	(69)	(1,353)
支付現金金額	<u>\$ 108,038,091</u>	<u>\$ 146,142,855</u>
處分固定資產及其他資產償款	\$ 113,737	\$ 552,561
換出資產抵減償款	(69)	(1,353)
取得現金金額	<u>\$ 113,668</u>	<u>\$ 551,208</u>
購置遞延借項償款	\$ 954,073	\$ 823,351
其他長期應付款(含一年內到期部分)		
增加	(147,825)	-
支付現金金額	<u>\$ 806,248</u>	<u>\$ 823,351</u>
購買備供出售金融資產償款	\$ 2,950	\$ 34,662,414
應付費用及其他流動負債減少	-	63,599
支付現金金額	<u>\$ 2,950</u>	<u>\$ 34,726,013</u>
處分備供出售金融資產償款	\$ 263,687	\$ 58,591,994
其他金融資產增加	(22,156)	(90,549)
取得現金金額	<u>\$ 241,531</u>	<u>\$ 58,501,445</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產轉列閒置資產	\$ 422,323	\$ -
一年內到期之應付公司債	-	\$ 4,500,000
一年內到期之長期銀行借款	\$ 125,000	\$ -
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付 費用及其他流動負債)	<u>\$ 1,926,049</u>	<u>\$ 3,916,796</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



中華信用評等股份有限公司

台北市11049信義路五段7號49樓

2012年9月4日

發文字號：(一〇一)信評字第 280 號

台灣積體電路製造股份有限公司

主旨：台灣積體電路製造股份有限公司 101 年度第 3 期無擔保普通公司債信用評等結果如說明

債券種類	無擔保普通公司債
年期	10 年期
金額	新台幣 44 億元
評等	twAAA

中華信用評等公司（以下簡稱「中華信評」）依據貴公司之要求對以上所提之台灣積體電路製造股份有限公司 101 年度第 3 期無擔保普通公司債授予「twAAA」長期債務發行信用評等。

本封信函代表中華信評同意貴公司可依適用之法律與規定，向相關機構與個人傳達以上評等結果。惟關於此傳達評等結果之許可（不包括對受到適當保密協議約束之專業顧問的傳達），僅在中華信評已將評等結果公布於 www.taiwanratings.com/tw 網站上後始正式生效。任何由貴公司或貴公司委任機構於任何網站上的評等結果傳達必須包括該評等結果的完整評等報告，並包括所有的評等結果更新（如適用）。

為維持此評等，中華信評必須收到中華信評等服務評等條款和條件中所指的所有資訊。貴公司瞭解，中華信評的信用評等監視過程，有賴貴公司、貴公司委任機構，或貴公司顧問所提供與評等有相關資訊的正確性、及時性與完整性，以及持續提供重要資訊。請將所有資訊以電子檔案型式傳送至：
raymond_hsu@taiwanratings.com.tw。任何無法以電子檔案型式或未被張貼於適當網站之資訊，請將紙本寄送至：台北市 110 信義區信義路五段 7 號台北 101 大樓 49 樓 A 室，中華信用評等公司，轉：企業評等部。

本評等結果受以下所附之中華信評等服務評等條款和條件之規範。

中華信評很高興有機會為貴公司提供評等意見。欲取得更多訊息，請參考中華信評網站 www.taiwanratings.com/tw。若貴公司有任何問題，請與中華信評聯絡。感謝貴公司選擇中華信評。

順頌商祺

中華信用評等公司
評等分析聯絡人
姓名：許智清



Taiwan Ratings

A Standard & Poor's Ratings Partner
www.taiwanratings.com

中華信評評等服務
評等條款和條件

貴公司了解並同意：

總則。中華信評評等服務（下稱“本評等服務”）的評等和其他觀點是意見的表達，而非對事實的陳述。評等並非推薦任何人購買、持有或出售任何證券的建議，亦非對任何證券的市場價格、適銷性、投資者偏好或適用性的評論。本評等服務的評等和其他觀點是根據發行體及其代理人及顧問提供的資料，以及本評等服務從其認為可靠的管道而得的其他資料所作出，但本評等服務並不會對所獲得之任何資料進行審查，也未負有必須對其進行盡職調查或獨立核證的責任。這類資料和本評等服務的觀點不應作為作出任何投資決策的依據。本評等服務並未扮演“受託人”或投資顧問的角色。本評等服務現在或是將來都不會就某一發行體如何能夠或應當達到某一特定評等結果提出意見，且不論現在或將來，也都不會提供諮詢、顧問、財務和結構化方面的建議。

所有評等行動係依本評等服務之獨立判斷所為。在任何時候，本評等服務可獨立判斷決定授予、調升、調降、擱置或撤銷評等，或把評等列入信用觀察名單，以及授予或調整評等展望。儘管發行體可以要求進行保密或非公開評等或撤銷評等或終止本協議，但本評等服務仍可以採取上述行動。本評等服務不會將某一公開評等轉換為保密或非公開評等，亦不會將非公開評等轉換為保密評等。

發佈。除非貴公司在首次評等時明確要求以保密或非公開的形式授予和維持評等，否則本評等服務將保留使用、公佈、散播或授予其他方使用、公佈或散播評等和任何分析報告（包括評等理由）的權利。但是，假若保密或非公開評等或是既存之保密或非公開評等經由本評等服務或其聯屬企業以外之第三者的披露而公開，則本評等服務保留將該評等視為公開評等的權利，包括但不限於發佈該評等及任何相關分析報告。本評等服務發佈的任何分析報告並非是由貴公司、或代表貴公司、或應貴公司要求而發佈的。即使本文有任何與此相反的條款，但本評等服務將保留使用、公佈、散播，或授權其他方使用、公佈或散播已經撤銷的公開評等有關於分析報告的權利，不論撤銷的原因為何。本評等服務隨時都有可能公佈評等準則的釋義，且本協議對本評等服務日後認為有需要時必須修改或修訂其評等準則的能力，並不構成任何限制。

貴公司提供的資料。在本協議有效期內，貴公司保證將向本評等服務提供、或即刻促請他人提供，所有本評等服務根據適用的公開評等準則要求提供的所有資料。本評等服務對從貴公司或貴公司代理人或顧問獲得之資料的判斷，可能會影響評等和評等的維護。除了下文定義的“除外資訊”，貴公司進一步保證由貴公司或貴公司代理人或顧問向本評等服務提供之與評等或評等監視（如適用）相關的所有資料，為截至提供當日的最新資訊，且該所有資料沒有對重要事實的錯誤陳述，亦未遺漏任何必要之關鍵事實，從而保證此類資料不具誤導性。“除外資訊”是指貴公司根據本項第一句促請其代理人或顧問提供的資訊，該代理人或顧問在向本評等服務提

供的書面資料中，同意依本項做出保證，以及在違反此類保證時對本評等服務承擔的責任，與貴公司直接向本評等服務提供資訊的責任一致。實質違反本項的擔保保證將構成本協議的一種實質性違約情況。根據適用法律允許的範圍，貴公司應對本評等服務及其聯屬企業就下列情況導致之所有虧損、賠償、債務、審判結果、成本、支出和費用（包括合理的律師費）（總稱“損失”）負責，這些損失情況包括：

（1）在貴公司作為一方參與的訴訟程序中，由管轄法院最終裁判係直接肇因於實質違反本項之保證而實際發生的損失，或（2）在貴公司作為一方參與的訴訟程序中，由管轄法院最終裁判係直接肇因於貴公司或貴公司代理人或顧問向本評等服務提供之資訊侵犯或違反第三方智慧財產權而實際發生的損失；但若在貴公司作為一方參與的訴訟中，管轄法院最終裁判該損失係源於本評等服務之疏忽、故意的不法行為或有意之不當行為，則為例外情況。為了避免產生疑義，損失可以包括本評等服務在相關訴訟之前實際發生的損失，但以第三方針對本評等服務提出的索賠要求，且經管轄法院最終裁判其係直接源自於實質違反本項之保證規定者（如上述（1）條款）為範圍。

保密資料。就本協議而言，“保密資料”指貴公司或貴公司代理人或顧問向本評等服務提供，標示為“保密”或（在此類資料披露之前或之後即刻）以書面形式知會本評等服務為“保密”的書面或口頭資料。儘管有此規定，如屬以下情況，貴公司或貴公司代理人或顧問所披露的資料將不被視為“保密資料”，本評等服務也無責任把該等資料以“保密資料”處理：（1）在資料披露當時，本評等服務或其聯屬企業已實質上知悉該等資料，且本評等服務並不知道該資料不得對外披露；（2）在資料披露當時，公眾已知悉該等資料；（3）在資料披露之後，公眾經由第三者（並非因為中華信評或其聯屬企業的緣故）知悉該等資料；（4）第三方在此類資料披露後向本評等服務或其聯屬企業披露，且本評等服務或其聯屬企業合理相信該第三方向本評等服務或其聯屬企業的此類披露行為並未受到禁止；（5）該資料係由本評等服務或其聯屬企業獨立產生，事前並未參考“保密資料”；（6）獲貴公司書面確認可向大眾披露該等資料，或（7）法律或監管規定該等資料必須由本評等服務或其聯屬企業予以披露。本評等服務瞭解中華民國證券法規可能規定在掌握實質性和非公開信息時禁止證券交易，且已採取了相應的證券交易和溝通政策。

本評等服務對資料的使用。除非另有規定，本評等服務不得向第三方披露保密資料。本評等服務可以（1）使用保密資料授予、調升、調降、擱置或撤銷評等、把評等列入信用觀察名單，以及授予或調整評等展望；以及（2）與參與評等業務但遵守適當保密義務的聯屬企業分享保密資料；在上述情況下，根據此限制性條款，本評等服務及此類聯屬企業可以發佈由保密資料得出的資訊。本評等服務也可以根據其政策和適用法律和監管規定，或取得發行體或其代理人的同意，與參與評等或其他金融服務業務，且遵守適當保密義務的聯屬企業或代理人（下稱“相關聯屬企業和代理人”），基於建模、基準化和研究等目的而使用與分享保密資料；在上述情況下，根據此限制性條款，本評等服務及此類聯屬企業可以發佈由保密資料得出的資訊。關於並未以保密或非公開形式維護的資產證券化評等，本評等服務可以發佈以保密資料彙總得出的資料（下稱“相關資料”），但不包括特定及確定個別債務人之資料，且可與任何相關聯屬企業和代理人分享此類保密資料以向市場發佈相關資料。貴公司確認，盡貴公司所知，此類發佈不會違反貴公司對第三方的任何保密義務。本評等服務同意，貴公司有權尋求特定行為和禁令或其他平衡法的救濟。

Taiwan Ratings

A Standard & Poor's Ratings Partner
www.taiwanratings.com

作為本評等服務違反本協議披露保密資料的補償。本評等服務及其聯屬企業保留使用、公佈、散播，或授予其他方使用、公佈或散播貴公司、貴公司代理人或顧問提供的任何非保密資料的權利。

本評等服務並非證券法所稱之專家、承銷商或賣方。本評等服務不同意且將來亦不會同意是任何適用證券法律或其他監管指導意見、規定或建議中所定義的“專家”或任何類似名稱，也不接受承擔與任何證券有關的任何募股說明書或上市說明之任何部分的責任或內容授權。本評等服務不是任何適用證券法律或其他監管指導意見、規定或建議中所定義的“承銷商”或“賣方”。本評等服務並不擔任與本協議有關的任何適用證券法律或其他監管指導意見、規定或建議中所定義的“承銷商”或“賣方”的相關角色或任務。

本評等服務對保密和非公開評等的使用。本評等服務可以在分析抵押債務債券（CDO）和其他投資工具發行的債務中使用保密和非公開評等。本評等服務可以用保密信用預期或評估的方式，將保密和非公開評等向 CDO 和類似投資工具的經理人披露。本評等服務可以允許 CDO 經理人在有限之範圍與多種限制條件下，使用和散播信用預期或評估；但本評等服務不得控制此類使用或散播。

整體協議。本協議不應阻止貴公司、發行體（若貴公司不是發行體）或本評等服務根據適用法律和監管規定採取行動。在前述基礎上，本協議（包括根據條款進行的任何修訂）構成訂約雙方就此提供之評等事宜達成之完整與全部協議。本協議之條款取代與貴公司或貴公司代理人和顧問向本評等服務提供之資料有關的任何其他條款和條件，該些條款和條件包括但不限於貴公司或貴公司代理人和顧問向本評等服務提供此類資料的網站或其他管道中（或適用於此）的條款和條件，而且不論此類條款和條件是否在本協議生效日之前或之後被加入。此類條款和條件對本評等服務應為無效。

賠償責任的限制。本評等服務不會也不能保證評等所依據之資料的準確性、完備性或及時性，以及因使用這些資料而獲致的結果。本評等服務不作出明示或默示的保證，包括但不限於對特定目的或用途的適銷性或適用性的任何保證。本評等服務、其聯屬企業或第三方供應商或它們的任何管理人士、董事、股東、雇員或代理人，不須對貴公司、貴公司聯屬企業或任何個人，因任何不準確性、錯誤或遺漏而代表各自直接或間接利益而提出的索賠負責，且不論所提供評等或相關分析服務產生或相關的原因、訴訟、賠償（結果性的、特別的、間接的、附帶的、懲罰性的、補充性的、懲戒性的或其他）、索賠、債務、成本、費用、法律費用或損失（包括但不限於所損失的收入或所損失的利潤和機會成本），甚至在被告知此類損失或其他數額的可能性時皆然；但若在貴公司和本評等服務作為各方參與的訴訟程序中，管轄法院最終裁判的此類損失或其他數額係源於本評等服務疏忽、故意的不法行為或有意之不當行為，則為例外情況。此外，在不對前文構成限制的前提下，對於貴公司、貴公司聯屬企業或任何個人因依據任何看來是顧問或推薦意見而做出的任何決定而代表各自利益提出的索賠，本評等服務均不須負法律責任。儘管如此，如果本評等服務必須對貴公司、貴公司聯屬企業或任何個人根據本協議代表各自利益提出的損失索賠負責時，則賠償總額不得超過中華信評就本評等服務在該訴訟之前獲得之服務費用的總額。無論有關訴訟、賠償、索賠、責任、成本、支出或損失的形式如何，

是屬於契約、法規或侵權（包括但不限於過失）或其他性質，本項的條文均將適用。各方不會放棄根據法律所獲賦予的保障、特權或辯護權利。

協議終止。任何一方均可在任何時間在向對方發出書面通知後終止本協議。除非明確規定僅在本協議有效期內有效，否則所有條款和條件在本協議終止後均繼續有效。

無第三方受益人。本協議或發佈之評等均不擬也不應被詮釋為代表任何第三者（包括但不限於任何接受評等的一方）設定任何權利。本協議或發出之評等不擬以任何人作其第三受益人。

約束力。本協議對本協議訂約雙方及其繼承人和受讓人均有約束力並利益及之。

可分割性。倘若本協議中有任何條款或條文被視為失效、無效或不能強制執行，則本協議其餘的條款或條文將不會因而受影響、減少效力或失效，且將各自具有法律所容許的最大效力和強制執行性。

修訂。本協議不得進行修訂或取代，除非以特別提及本協議的書面並且由雙方授權代表簽署或以雙方同意的電子簽署方式執行。

管轄法律。本協議及依其提供之各項評等均受中華民國法律所管轄。訂約雙方不能撤銷地同意，對於因本協議引起或有關的任何爭議，必須以台北地方法院作為管轄法院。如果本協議存在中英文二個版本，訂約雙方同意以中文本為準。

www.taiwanratings.com

台灣積體電路製造股份有限公司

董事會會議記錄

(中華民國一百零一年度第二次董事常會)

(節錄本)



時 間： 壹、中華民國一百零一年六月十二日

- 上午議程 (股東會後)

- 下午議程 (下午四點十五分)

貳、中華民國一百零一年六月十三日上午八點三十分

地 點： 新竹科學工業園區新竹市力行六路八號

親自出席董事共九人： 張忠謀、曾繁城、Peter L. Bonfield、施振榮、
Thomas J. Engibous、鄒至莊、陳國慈、李鍾熙、
蔡力行

主 席： 張忠謀 博士

記 錄： 方淑華

列席人員： (略)

(前略)

一、決議事項

(前略)

第六項：提請本會核准於不高於新台幣 45,000,000,000 元之額度內(按美金對新台幣匯率 1:29.2 計算，折合美金約 1,541,000,000 元)於國內市場分次募集無擔保普通公司債以支應產能擴充之資金需求，並核准就本公司債向主管機關申請發行，並於台灣證券櫃檯買賣中心上櫃交易；另請授權董事長決定上述公司債之主要條款及發行時間。

經提案表決全體出席董事一致通過決議如下：

決議：照案通過。

台灣積體電路製造股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

台灣積體電路製造股份有限公司本次為募集發行一〇一年度第三期無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣肆拾肆億元整，票面金額均為新臺幣壹仟萬元整，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以覆核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，台灣積體電路製造股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 聰



中 華 民 國 一 〇 一 年 九 月 十 四 日

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長：張忠謀

